

# 競天公誠律師事務所

JINGTIAN & GONGCHENG

中国北京市朝阳区建国路77号华贸中心3号写字楼34层 邮政编码100025

电话：（86-10）5809 1000 传真：（86-10）5809 1100

## 北京市竞天公诚律师事务所

### 关于合肥颀中科技股份有限公司

### 首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市的

### 补充法律意见书（一）

致：合肥颀中科技股份有限公司

北京市竞天公诚律师事务所（以下称“本所”）作为在中国取得律师执业资格的律师事务所，根据《中华人民共和国证券法》（以下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（以下称“《科创板首发办法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下称“《科创板上市规则》”）等法律、法规和主管部门的有关规定（以下称“法律、法规和规范性文件”），以及合肥颀中科技股份有限公司（以下称“发行人”、“颀中科技”、“股份公司”或“公司”）与本所签订的《专项法律顾问协议》，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，已于2022年5月12日就发行人拟首次公开发行不超过20,000万股人民币普通股（以下称“A股”）股票并于上海证券交易所科创板上市事宜（以下称“本次发行”或“本次发行上市”）出具了《北京市竞天公诚律师事务所关于合肥颀中科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市的法律意见书》（以下称“首份法律意见书”）及《北京市竞天公诚律师事务所关于合肥颀中科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市的律师工作报告》（以下称“律师工作报告”）。

根据上海证券交易所科创板上市审核中心于2022年6月9日核发的《关于合

肥硕中科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》（上证科审（审核）〔2022〕231号）（以下称“《审核问询函》”）的要求，本所现谨出具本补充法律意见书之一。除本补充法律意见书之一所作的修改或补充外，首份法律意见书及律师工作报告的内容仍然有效。

本补充法律意见书之一出具的前提、假设均同于首份法律意见书及律师工作报告。除本补充法律意见书之一另有说明外，本补充法律意见书之一使用的简称均同于首份法律意见书、律师工作报告及《招股说明书》。

本所同意将本补充法律意见书之一作为发行人申请本次发行上市所必备的法律文件，随同其他材料一并上报，并愿意依法对发表的法律意见承担相应的法律责任。

本补充法律意见书之一仅供向上海证券交易所申请本次发行上市之目的使用，不得用作其他任何目的。

基于上述，本所出具补充法律意见如下：

## 问题 1. 关于公司控制权

### 1.1 关于控制权变动

根据申报材料：（1）2018 年，顾中控股（香港）以其所持苏州顾中的全部股权作价出资设立发行人前身封测有限。同年，合肥顾中控股于成立后不久即通过受让顾中控股（香港）股份入股发行人，并通过增资成为发行人第一大股东，芯屏基金、芯动能基金、CTC 等股东入股发行人。有关股份转让及增资参考评估值约为 17.52 亿元，与同时期苏州顾中可辨认净资产公允价值约 9.15 亿元存在较大差异；（2）目前，合肥顾中控股、顾中控股（香港）和芯屏基金分别持有公司 40.15%、30.57%和 12.50%的股份，认定发行人无控股股东、实际控制人。

请发行人说明：（1）2018 年封测有限设立、后续股份转让及增资的背景、演变过程，顾中控股（香港）放弃公司控制权的原因，前述事项是否为一揽子安排，有关股东之间是否存在其他约定或利益安排；（2）前述股权转让、增资的作价依据及公允性，是否需履行国有资产审批程序，是否可能损害国资背景股东的利益；（3）发行人各股东之间是否存在一致行动安排、表决权委托、控制关系或其它特殊关系，是否均已认可公司的控制权状态；（4）无控股股东、实际控制人对公司生产经营稳定性的影响，各股东之间是否存在意见分歧时的解决机制，是否可能出现“公司僵局”及应对措施，公司主要股东未来的持股安排及计划，是否均已出具不谋求控制权的承诺，能否保持公司控制权结构、公司治理和生产经营的清晰、稳定。

请保荐机构、发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见，同时提供 2018 年发行人设立、股份转让及增资的相关协议。

回复：

#### 【发行人说明】

一、2018 年封测有限设立、后续股份转让及增资的背景、演变过程，顾中控股（香港）放弃公司控制权的原因，前述事项是否为一揽子安排，有关股东之间是否存在其他约定或利益安排

## **（一）2018 年封测有限设立、后续股份转让及增资的背景、演变过程**

### **1、背景**

21 世纪以来，随着中国经济总量和综合国力的不断增强，作为保障国家安全和支撑经济发展的战略性新兴产业，中国大陆集成电路产业实现了快速发展，并已成为全球集成电路产业的重要市场。在市场需求、政策扶持以及技术创新的共同推动下，在显示驱动芯片领域，集创北方、格科微、豪威科技、奕斯伟计算、云英谷等芯片设计公司近年来取得了较大的技术突破，加之以京东方、华星光电、维信诺为代表的中国大陆显示面板企业在全产业链中的市场地位不断增强，以及晶合集成等芯片制造厂商持续扩充显示驱动芯片产能，半导体显示产业链连接更加紧密，中国大陆集成电路行业聚集效应和产业协同效应日趋明显。正是在这样的行业大背景下，硕中科技主要股东于 2018 年实施了以产业投资为目的的股权转让及投资。具体情况如下：

#### **（1）奕斯伟集团从完善产业链投资和保障自身产品供应链安全出发，自 2017 年初便与硕邦科技洽谈股权转让事宜**

2016 年，随着半导体显示产业快速向中国大陆转移，中国境内无论是终端消费市场需求还是面板产能规模均已位居世界前列。同年，奕斯伟集团正式成立，并筹划以显示驱动芯片设计业务（Fabless 经营模式）为起点，围绕移动终端、智慧家居、智慧交通等应用场景，为客户提供多媒体系统、显示交互等芯片及解决方案。由于显示驱动芯片封测涉及金凸块制造、覆晶封装等先进工艺，具有较高的技术难度和研发壁垒，因此是显示驱动芯片产业链下游的核心环节。为完善产业链投资尤其是保障自身产品的供应链安全，奕斯伟集团于 2017 年年初便开始密集对中国台湾地区的显示驱动芯片封测领先企业进行调研，并重点对硕邦科技和另外一家台资企业进行股权转让的相关洽谈。经评估，从投资标的股权结构、市场地位、合作愿景、转让价格等方面因素综合考虑，奕斯伟集团最终选择与硕邦科技进行深入洽谈，并同步在中国大陆寻找联合投资方。

#### **（2）基于主客观等因素综合权衡，奕斯伟集团于 2017 年第四季度就苏州硕中股权转让事宜与硕邦科技达成共识**

一方面，苏州硕中作为 2004 年硕邦科技在中国大陆设立的全资子公司，拥

有先进的技术水平、稳定的经营业绩和领先的行业地位，不仅业务成熟度较高，而且在经营管理上也相对独立。特别从保障自身供应链安全和未来目标市场的因素考量，奕斯伟集团认为苏州硕中无论从所处地理位置、产品服务半径和管理运营模式上都是更适合的投资标的；另一方面，受制于当时中国台湾商务等相关部门对中国大陆企业投资台湾当地半导体企业股权的从严审查，奕斯伟集团投资硕邦科技的可行性相对更低，而且硕邦科技从自身管理半径、苏州硕中独立性以及回笼资金加大自身投入等因素考量，出售苏州硕中股权并引入中国大陆具有一定产业影响力的战略投资人，也更具可行性且符合硕邦科技与苏州硕中的利益。因此，基于主客观等因素综合权衡，奕斯伟集团于 2017 年第四季度就苏州硕中股权转让事宜与硕邦科技达成共识。

### **(3) 以因地制宜发展“芯屏”产业为目的，芯屏基金联合奕斯伟集团共同投资并于 2018 年在合肥设立封测有限**

安徽省和合肥市紧跟国家集成电路产业发展的政策和浪潮，因地制宜并结合自身特色，以“芯屏器合”产业发展为聚焦方向，着力打造集成电路产业集群。在产业集群的协同作用下，合肥市集成电路产业规模得以迅速壮大，特别是在半导体显示产业链上已布局有晶合集成、京东方、维信诺等公司业务上下游相关龙头企业，合肥建投牵头组建芯屏基金，聚焦“芯屏”领域投资，发挥产业基金和国有资本的引领作用。2016 年 1 月，芯屏基金发起设立，并于 2017 年 9 月增资至 244.3125 亿元。

在上述背景下，经奕斯伟集团推荐，合肥市国资委下属合肥建投和芯屏基金基于带动当地“芯、屏”相关产业发展的目的，提出了将先进封测项目在合肥落地的要求。为满足各方的利益诉求，经奕斯伟集团、合肥建投和硕邦科技协商一致，最终确定由硕中控股（香港）以苏州硕中股权出资在合肥设立封测有限，并通过股权转让和增资方式引入奕斯伟集团、芯屏基金、芯动能基金等战略投资者。

2018 年 1 月，合肥建投和北京奕斯伟科技有限公司（以下简称“北京奕斯伟”）签署《投资框架协议》。相关安排参见本题回复之“（二）硕中控股（香港）放弃公司控制权的原因，前述事项是否为一揽子安排，有关股东之间是否存在其他约定或利益安排”相关内容。

#### **(4) 顾邦科技转让控制权后的股权结构安排和保持管理团队对公司日常经营的主导，符合各相关方的交易初衷和利益**

如前文所述，在集成电路产业转移及大陆半导体显示行业兴起的产业背景下，上述交易实现了相关产业投资方奕斯伟集团、芯屏基金以及转让方顾邦科技的“合作共赢”。首先，奕斯伟集团通过 2018 年入股发行人完善了产业链投资，并为此后奕斯伟计算显示驱动芯片的大规模量产提供了下游的供应链保障；其次，芯屏基金则在 2018 年通过入股发行人等一批“芯、屏”产业优质企业，为推动合肥集成电路高端研发、核心制造等领域的集聚发展，打造具有影响力的中国“IC 之都”发挥了产业引导的积极作用；再次，面对着中国大陆半导体显示产业链的蓬勃发展，顾邦科技转让控制权有利于充分发挥中国大陆国有及产业资本的股东资源优势，在加快发行人发展的同时，获取更高的投资收益和股东回报；最后，苏州顾中经过十余年的发展和成长，自身管理团队已日益成熟和健全，顾邦科技自 2011 年以来便未实际参与苏州顾中的日常经营管理。苏州顾中在经营管理团队的带领下，技术实力和经营业绩均在中国大陆保持领先地位。因此，在奕斯伟集团和芯屏基金投资均不以控制为目的，而作为无实际控制人的顾邦科技也有意放弃对发行人控制权的前提下，在通过相关股权架构设置完善公司治理结构的同时，继续保持管理团队对公司日常经营的主导，不仅有利于推动公司持续稳健发展，也符合上述各相关方的交易初衷和利益。

2018 年顾邦科技放弃对发行人的控制权后，公司业绩继续持续增长，并保持了中国大陆显示驱动芯片封装测试行业第一的市场地位。关于“公司形成无实控人状态且主要股东一致认可并共同推动无实际控制人状态的原因”之相关背景请参见本题回复之“1.1 关于控制权变动之（三）”相关内容。

## **2、演变过程**

### **(1) 2018 年 1 月设立**

2018 年 1 月 3 日，顾中控股（香港）签署《章程》，决定封测有限的投资总额为 32,363.10 万美元，注册资本为 10,787.70 万美元，出资方式为股权。2018 年 1 月 18 日，封测有限设立。

2018 年 1 月 23 日，顾中控股（香港）与封测有限签署《股权转让协议》，

约定顾中控股（香港）将其所持苏州顾中全部股权转让给封测有限，股权转让价格为 10,787.70 万美元。

截至 2018 年 1 月 31 日，封测有限股权结构如下表所示：

序号	股东名称	认缴出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	出资比例 (%)	出资方式
1	顾中控股（香港）	10,787.70	10,787.70	100.00	股权
合计		<b>10,787.70</b>	<b>10,787.70</b>	<b>100.00</b>	—

2018 年 5 月 31 日，顾中控股（香港）与封测有限签署《股权转让协议之补充协议》，约定股权转让实质为顾中控股（香港）以苏州顾中 100% 股权对封测有限进行股权出资，封测有限无需向顾中控股（香港）支付价款；双方一致确认，原《股权转让协议》中约定的股权转让价格 10,787.70 万美元系初步意向约定，本次股权出资价格以苏州顾中截至 2018 年 1 月 31 日的评估值为参考依据，经双方协商一致确定为人民币 175,231.87 万元，其中 70,343.35 万元计入封测有限的实缴注册资本，104,888.52 万元计入封测有限的资本公积。

## (2) 2018 年 7 月股权转让

2018 年 6 月 29 日，顾中控股（香港）作出股东决定，同意将所持封测有限 30.34% 股权（对应出资额 3,272.99 万美元）转让给封测控股（现为“合肥顾中控股”），将所持封测有限 9.45% 股权（对应出资额 1,019.44 万美元）转让给芯屏基金，将所持封测有限 12.92% 股权（对应出资额 1,393.77 万美元）转让给芯动能基金，将所持封测有限 4.83% 股权（对应出资额 521.05 万美元）转让给 CTC。

2018 年 6 月 30 日，顾中控股（香港）与封测控股、芯屏基金、芯动能基金、CTC 分别签署《股权转让协议》，并于 2018 年 7 月完成了封测有限的工商变更登记手续。本次股权转让完成后，封测有限变更为中外合资企业，封测有限的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	认缴出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	出资比例 (%)	出资方式
1	顾中控股（香港）	4,580.46	4,580.46	42.46	股权
2	封测控股	3,272.99	3,272.99	30.34	货币
3	芯动能基金	1,393.77	1,393.77	12.92	货币
4	芯屏基金	1,019.44	1,019.44	9.45	货币

序号	股东名称	认缴出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	出资比例 (%)	出资方式
5	CTC	521.05	521.05	4.83	货币
合计		<b>10,787.70</b>	<b>10,787.70</b>	<b>100.00</b>	—

### (3) 2018年8月增资

2018年8月9日，封测控股、芯屏基金与公司及其他股东签署《增资协议》，约定封测控股以43,900.00万元向封测有限增资，认购新增注册资本2,742.51万美元，余额计入资本公积金；约定芯屏基金以13,700.00万元向封测有限增资，认购新增注册资本853.39万美元，余额计入资本公积金。

2018年8月10日，封测有限召开董事会并作出决议，同意上述增资事项。

本次增资完成后，封测有限的股权结构如下表所示：

序号	股东名称	认缴出资额 (万美元)	实缴出资额 (万美元)	出资比例 (%)	出资方式
1	封测控股	6,015.50	6,015.50	41.82	货币
2	顾中控股（香港）	4,580.46	4,580.46	31.85	股权
3	芯屏基金	1,872.83	1,872.83	13.02	货币
4	芯动能基金	1,393.77	1,393.77	9.69	货币
5	CTC	521.05	521.05	3.62	货币
合计		<b>14,383.60</b>	<b>14,383.60</b>	<b>100.00</b>	—

(二) 顾中控股（香港）放弃公司控制权的原因，前述事项是否为一揽子安排，有关股东之间是否存在其他约定或利益安排

#### 1、顾中控股（香港）放弃公司控制权的原因

顾中控股（香港）于2018年对外转让封测有限股权后即不再控制发行人，并已出具《关于不谋求控制权的承诺函》。顾中控股（香港）放弃公司控制权的主要原因如下：

(1) 从产业及市场趋势看，顾中科技引入中国大陆的战略投资者，有利于推动其持续发展，也符合顾中控股（香港）的股东利益

随着中国大陆集成电路产业的不断发展，特别是半导体显示产业链向中国大陆转移的趋势日益明显，顾中控股（香港）及其股东顾邦科技看好合肥当地在半导体显示产业链及集成电路领域的产业聚集效应，认为通过引入合肥国资

投资平台芯屏基金、产业投资人奕斯伟以及半导体行业具有影响力的投资基金芯动能基金等中国大陆的战略投资者，将有助于发挥相关股东的资源优势，推动封测有限相关业务的持续发展。而作为封测有限的股东，推动发行人业务实现更好发展，也符合顾中控股（香港）的自身利益。

### **（2）从业务扩张需求看，顾中科技通过新增股东增资，有助于满足其发展的资金需求并巩固市场地位**

从发行人自身业务发展需求看，一方面，2018年以前，公司封测制程主要以8吋为主，而当时显示驱动芯片产业链正处于向12吋转移的关键阶段，公司亟需投入资金引进12吋封测设备，以巩固其在显示驱动先进封测领域的领先地位；另一方面，公司于2015年开始布局非显示类封测业务，也需要投入较多资金，以完成各类凸块制造、晶圆测试及后段封装环节的产线建置。此外，境内竞争对手汇成股份、厦门通富等纷纷在2018年前后加大产能扩张力度，对公司的市场份额产生了一定威胁。而当时顾中控股（香港）并无更多资金能够用于支持并满足发行人对于业务发展所需的资金需求，通过引入新增股东的方式加快融资从2017年开始便已成为封测有限管理团队和股东的共识。

2018年8月，封测控股和芯屏基金合计向封测有限增资57,600.00万元。2018年9月，封测有限将上述资金用于向苏州顾中增资。上述投入极大地补充了公司的资金需求，帮助公司完成了Fab2的建设以及相关设备的引进，使公司成为境内最早具备12吋显示驱动芯片封测全制程量产能力的企业之一，同时也为2019年建置DPS产线以及报告期内业绩持续扩张奠定了坚实基础。

### **（3）从投资回报的角度看，顾中控股（香港）转让控制权有助于回收部分投资成本，补充其自身所需的营运资金**

通过转让顾中控股（香港）持有的封测有限部分股权，顾邦科技收回了部分投资成本，取得了约19亿新台币的处置收益。2018年1月，顾中控股（香港）还通过股东分红的方式取得了苏州顾中的分红款。因此，通过本次控制权转让，顾中控股（香港）取得了较好的投资回报并有效补充了其营运资金。

### **（4）从公司治理的角度看，顾中控股（香港）认可苏州顾中的管理团队，也认可放弃控制权后的无实控人状态对发行人业务发展不会造成不利影响**

经过苏州硕中自设立以来十余年的发展和成长，公司的知名度和规模逐步提升。特别是随着苏州硕中管理团队日益成熟和健全，从公司管理半径、资源及资金投入以及苏州硕中与硕邦科技处于我国海峡两岸的地理位置等因素考量，硕中控股（香港）及其股东硕邦科技在 2018 年股份转让前就已有较长时间未实际参与苏州硕中的日常经营管理，并认可杨宗铭先生等管理团队对苏州硕中日常经营的主导和公司管理的能力，苏州硕中在资产、人员、财务、业务和机构设置上也更加独立。因此，硕中控股（香港）认为，即使控制权转让也不会对公司经营产生负面影响。

同时，在硕中控股（香港）转让控制权之后，封测有限逐步形成了“国有基金+产业投资人+高管及员工持股平台+市场知名投资人”等不同类型的投资人与硕中控股（香港）共同持股的股权结构。由于硕中控股（香港）及其股东硕邦科技也系无实际控制人的企业，因此，硕中控股（香港）不仅确认了封测有限该等股权结构下的无控股股东和无实际控制人状态，也认为无实控人状态不会对发行人业务发展造成不利影响。

## **2、前述事项是否为一揽子安排，有关股东之间是否存在其他约定或利益安排**

合肥建投和北京奕斯伟于 2018 年 1 月 11 日签署《投资框架协议》，就共同投资发行人事项作出的主要约定如下：

（1）北京奕斯伟拟联合其他投资人设立合肥奕斯伟投资有限公司，由合肥奕斯伟投资有限公司作为普通合伙人，联合合肥建投作为有限合伙人共同设立专项产业基金，即合肥奕斯伟封测投资中心合伙企业（有限合伙）（以下称“封测合伙”），并由封测合伙出资设立合肥奕斯伟封测控股有限公司（以下称“封测控股”）作为产业发展平台。

（2）硕中控股（香港）先以所持苏州硕中的股权出资设立合肥奕斯伟封测技术有限公司（以下称“封测有限”，即发行人前身），封测控股出资 5.27 亿元人民币、合肥建投投资平台芯屏基金出资 1.63 亿元人民币分别认购封测有限约 30.4%、约 9.4% 的股权（以经合肥建投主管机关备案的评估结果实施股权转让，同时各交易主体届时或以不同币种交割，实际股权比例以最终交易为准）。

(3) 封测有限通过增资扩股用于扩产建设，分别由封测控股和芯屏基金对封测有限现金增资 4.39 亿元人民币和 1.37 亿元人民币，增资后持股比例分别约为 41.8%和 13%（实际股权比例以评估结果及最终交易为准）。封测有限设董事会，成员共 7 人，其中由封测控股委派 3 人（其中 1 人为合肥建投委派），芯屏基金委派 1 人，芯动能基金委派 1 人，颀中控股（香港）委派 2 人。

因此，根据上述《投资框架协议》约定，发行人 2018 年设立、后续股权转让及增资事项系一揽子安排。历经 2018 年 7 月的股权转让及 2018 年 8 月的增资之后，颀中控股（香港）不再拥有发行人的控制权。同时，根据《投资框架协议》关于封测有限董事会成员委派的相关约定，无任一股东能够委派超过半数以上的董事会席位。

综上，关于 2018 年封测有限设立、后续股份转让及增资事项，除上述安排外，有关股东之间不存在其他约定或利益安排。

### **（三）公司形成无实控人状态且主要股东一致认可并共同推动无实际控制人状态的原因**

在 2018 年封测有限设立、后续股份转让及增资（以下简称“本次交易”或“一揽子交易”）完成后，封测有限无论从股权架构还是董事会席位委派上看，均呈现出新的无实际控制人的状态<sup>1</sup>。该等控制权状态既符合发行人主要股东 2018 年股权合作的初衷，是发行人主要股东一致认可并共同推动的客观结果；又符合发行人完善公司治理并实现可持续发展的利益，是 2018 年控制权变更后推动发行人未来经营行稳致远的有利因素。因此，结合《科创板股票发行上市审核问答（二）》第 5 项中“在确定公司控制权归属时，应当本着实事求是的原则，尊重企业的实际情况，以发行人自身的认定为主，由发行人股东予以确认”的原则和要求，颀中科技无控股股东和实际控制人的控制权状态也得到了发行人全体股东的一致书面确认。

综合“2018 年转让前后的历史背景、政策因素、主要股东的核心利益以及发行人的真实意愿”等实际情况，形成该等“主要股东一致认可并共同推动无实际控制人状态”是兼顾主要股东核心利益与公司发展利益的最优方案，具体

---

<sup>1</sup> 由于颀邦科技股权结构分散，因此 2018 年交易前发行人即为无实际控制人的状态。故本回复描述为“本次交易完成后，封测有限……呈现出新的无实际控制人的状态”。

原因如下：

**1、从产业角度看，受让境内领先的先进封测企业股权补齐了当时内地显示驱动封测领域的短板，为我国半导体显示产业繁荣发挥了积极作用**

根据公开信息报道，2018 年前后，我国半导体显示行业呈现蓬勃向上的发展势头。据工业和信息化部电子信息司副司长介绍，2017 年中国大陆地区显示面板企业为全球显示产业贡献了 35%的出货面积和 24%的营收及营业利润。以量产及投资为例，维信诺固安 6 代 AMOLED 面板线、中电熊猫 8.6 代 TFT-LCD 面板线、华星光电 11 代 TFT-LCD 面板线、和辉 6 代 AMOLED 面板线于 2018 年投入生产；京东方绵阳 6 代 AMOLED 面板线、京东方武汉 10.5 代 TFT-LCD 面板线、滁州惠科 8.6 代 TFT-LCD 面板线、华星光电第二条 11 代 TFT-LCD 面板线、惠科绵阳 8.6 代 TFT-LCD 面板线、维信诺合肥 6 代 AMOLED 面板线于 2018 年进入建设期。在全球制造业向中国大陆转移的大趋势下，中国成为了全球电视电脑手机生产最大基地，随着以平板为代表之一的中国新型显示产业整体实力不断增强，中国大陆平板显示产业总产能已于 2019 年占据了全球产能的一半以上。

然而，作为显示产业链条上的重要环节之一，显示驱动芯片封测涉及金凸块制造、覆晶封装等先进封装工艺，具有较高的技术难度和研发壁垒，需要长时间的积累才能实现高稳定性、高可靠性的量产。2018 年之前，显示驱动芯片封测产能主要集中在少数中国台湾企业。2018 年，发行人前身封测有限的成立并随之注入该行业龙头硕邦科技在中国大陆的全部资产，并通过后续一揽子交易，不仅让封测有限作为中国境内本土企业实现了显示驱动封测领域全球前三名榜单的“榜上有名”，更深层次地推动了中国境内半导体显示产业全链的自主可控，为我国半导体显示产业繁荣发挥了积极作用。

**2、从国资角度看，本次交易是“芯”与“屏”契合下合肥显示产业全链布局的又一投资力作，体现了以促进产业集聚为目的的“合肥模式”**

发行人主要股东之一的芯屏基金是合肥建投结合合肥当地产业特色和基础，因地制宜组建的以“芯”和“屏”产业为投资方向的产业基金。从建设京东方 6 代线、8.5 代线和 10.5 代线等项目，到引进维信诺、康宁、彩虹、视涯科技等一

批龙头企业，合肥市形成了涵盖上游装备、材料、器件，中游面板、模组以及下游智能终端的完整半导体显示产业链，并打造了一个世界级的新型显示产业集群。

在解决“少屏”之痛后，合肥建投及其芯屏基金以半导体显示产业为土壤，通过规模和协同效应，筑巢引蝶，探索出了一条“引进团队—国资引投—项目落地—股权退出—循环发展”的产业基金运作模式，也被媒体称为“以投带引”招商引资新模式，即“合肥模式”。

“合肥模式”下的投资理念并非以控制为目的，而是以“强链补链延链”为目标，以资本纽带、股权纽带作为突破口和切入点，推动国资平台探索从“管企业”向“管资本”的改革，通过直接投资或组建参与各类投资基金，带动社会资本服务于地方招商引资，形成产业培育合力。根据京东方 A（000725.SZ）的公告，在 2018 年投资封测有限的同一年，芯屏基金还参与投资了合肥京东方显示技术有限公司（以下简称“合肥京东方”），并至今直接持有了合肥京东方 63.33% 的股权（对应认缴出资 152 亿元）。但芯屏基金却通过与京东方签署书面一致行动人协议的方式，明确放弃了对合肥京东方的控制权，再次验证了“不以控制为目的”的产业投资理念。

正是基于上述类似的投资理念，芯屏基金于 2018 年投资了处于“芯”产业链上的封测有限，并通过“以投带引”的合肥模式引导并支持发行人在合肥当地建设“颀中先进封装测试生产基地项目”和“颀中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目”。同时，出于对半导体产业规律和封测领域管理及技术人才的尊重，芯屏基金虽然作为发行人主要股东，但自始未委派高管或员工参与公司经营和管理，并已确认本次投资不以控制为目的，认可颀中科技无实际控制人的控制权状态，且承诺不主动谋求颀中科技控制权，信任并支持颀中科技经营管理团队按照市场规则和产业发展规律主导公司的日常经营。以上现状和目的符合芯屏基金作为颀中科技国资产业股东的核心利益。

综上，本次交易是“芯”与“屏”契合下合肥显示产业全链布局的又一投资力作，体现了以促进产业集聚为目的的“合肥模式”。

### 3、从公司及奕斯伟角度看，无实际控制人的状态既有利于公司利用股东资源优势做大主业，又有利于在市场化的竞争环境下保持业务独立和发展韧劲

奕斯伟集团成立于 2016 年，公司以显示驱动芯片设计业务（Fabless 经营模式）为起点，围绕移动终端、智慧家居、智慧交通等应用场景，为客户提供多媒体系统、显示交互等芯片及解决方案，从产业供应链关系看，发行人是奕斯伟集团的供应商。2018 年，奕斯伟的显示驱动芯片产品尚未形成规模化量产，资金实力相对有限，而苏州硕中已在中国境内显示驱动封测领域具有较高的市场知名度，奕斯伟集团希望通过引荐并联合其他产业投资人一起投资发行人，以推动与发行人建立更为紧密的战略合作关系，从而保障自身产品供应链安全。

从发行人的利益看，奕斯伟虽然是硕中科技在中国境内重要的客户之一，但无论从 2018 年当时时点还是着眼长远看，将发行人控制权转让给奕斯伟集团并定位于以服务奕斯伟为主的下游配套或供应链企业，都不利于发行人拓展中国境内的其他客户，也不符合其他主要股东的交易初衷和诉求。同样的，对于奕斯伟集团而言，虽然也从事半导体产业，但 2018 年奕斯伟集团刚刚成立不久，对下游封测业务并无经营经验和管理人才，不仅无意作为发行人的实际控制人，而且如果将硕中科技收购为子公司，也不利于奕斯伟集团与同行业其他优质封测企业的业务合作。相反，无实际控制人的状态既有利于发行人充分利用各方股东资源优势做大主业，又有利于在市场化的竞争环境下保持业务独立和发展韧劲。

基于上述三方面因素，从合理性角度看，本次交易完成后发行人的无实际控制人状态是兼顾主要股东核心利益与公司发展利益的最优方案。

综上所述，基于 2018 年封测有限设立、后续股份转让及增资等“一揽子交易”的背景和演变过程，以及公司形成无实控人状态且主要股东一致认可并共同推动无实际控制人状态的原因分析，本次交易后发行人无实际控制人状态所形成的原因具有合理性。

## 二、前述股权转让、增资的作价依据及公允性，是否需履行国有资产审批程序，是否可能损害国资背景股东的利益

### （一）前述股权转让、增资的作价依据及公允性

根据中企华评估于 2018 年 5 月 28 日出具的《合肥奕斯伟封测技术有限公司拟股权转让及增资事宜涉及的合肥奕斯伟封测技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字（2018）第 3297 号），截至 2018 年 1 月 31 日，封测有限净资产评估价值约为 17.52 亿元，并以此作为 2018 年 7 月股权转让及 2018 年 8 月增资的作价依据。该等评估值与截至 2018 年 1 月 31 日苏州硕中可辨认净资产公允价值 9.15 亿元存在差异主要是由于两次评估目的不同，因此所采用的评估方法不同，在针对封测有限股权转让及增资的参考评估值中苏州硕中系采用收益法进行估值，而针对同时期苏州硕中可辨认净资产公允价值的评估方法系资产基础法。

因此，2018 年 7 月股权转让及 2018 年 8 月增资的定价依据系参照上述经由国资备案的资产评估报告之评估结果，前述股权转让及增资的作价依据公允。

### （二）前述股权转让、增资是否需履行国有资产审批程序

前述股权转让、增资履行的相关程序如下：

1、2017 年 12 月 13 日，合肥市国资工作领导小组召开 2017 年第 7 次组长会议，会议原则同意合肥建投及其所属芯屏基金参与投资相关项目，并由合肥建投与合作方加强对接，对于投资架构等相关未尽事宜进行充实完善，尽快修改完善投资协议，加快推进项目进展。

2、2017 年 12 月 15 日，合肥市人民政府召开第 105 次常务会议，会议原则同意国资委相关汇报意见，要求抓紧完善投资协议，进一步明确投资架构等具体事宜。

3、2017 年 12 月 19 日，中共合肥市委常委会召开第 40 次会议，会议认为合肥建投参与相关投资对推动合肥市集成电路产业发展，加强与集成电路产业相关企业深度合作，提升合肥集成电路产业综合竞争力，具有重要现实意义。会议强调，要按照市国资工作领导小组 2017 年第 7 次组长会议和市政府第 105 次常务会议的审议意见，由合肥建投与合作方加强对接，对于投资架构等相关

未尽事宜进行充实完善。

4、2017年12月29日，合肥市人民政府批复同意合肥建投与合作方拟签署的《投资框架协议》文本。根据《投资框架协议》，合肥建投参考截至2017年11月30日苏州硕中净资产的预估值，拟由封测控股出资5.27亿元人民币、合肥建投旗下投资平台芯屏基金出资1.63亿元人民币分别认购封测有限约30.4%、约9.4%的股权，并由封测控股和芯屏基金对封测有限现金增资4.39亿元人民币和1.37亿元人民币，增资后持股比例分别约为41.8%和13%（实际股权比例以评估结果及最终交易为准）。

5、2018年5月28日，中企华评估出具《合肥奕斯伟封测技术有限公司拟股权转让及增资事宜涉及的合肥奕斯伟封测技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字（2018）第3297号），截至2018年1月31日，封测有限的净资产评估值为17.52亿元。

6、2018年6月5日，芯屏基金填报《接受非国有资产评估项目备案表》，并完成上述资产评估报告的合肥市国有资产评估项目备案。

7、2018年7月和8月，封测控股和芯屏基金参照上述经由国资备案的资产评估报告估值，参与完成了股权受让及增资。前述股权转让及增资后，封测控股和芯屏基金持股比例分别为41.82%和13.02%，该等比例与经国资委和市政府审批通过的《投资框架协议》相关约定一致。

综上，前述股权转让、增资履行了必要的国有资产审批程序。

### （三）是否可能损害国资背景股东的利益

如前文所述，芯屏基金参与前述股权转让和增资已履行相关国有资产审批及备案程序。另根据合肥市国资委于2022年7月12日出具的《关于确认合肥硕中科技股份有限公司历史沿革中涉及国有股权变动事项合规性的函》，芯屏基金在硕中科技历次相关股权变动中均履行了必要程序，符合国资监管的有关规定，不存在损害国有股东权益及造成国有资产流失的情形。

综上，根据上述已履行的国资内部决策、国有资产评估及备案程序和合肥市国资委出具的确认意见，前述股权转让、增资不存在可能损害国资背景股东的利益的情形。

三、发行人各股东之间是否存在一致行动安排、表决权委托、控制关系或其它特殊关系，是否均已认可公司的控制权状态

**（一）发行人各股东之间是否存在一致行动安排、表决权委托、控制关系或其它特殊关系**

截至本补充法律意见书之一出具之日，发行人持股 5%以上股东分别为合肥顾中控股、顾中控股（香港）和芯屏基金。

首先，根据合肥顾中控股及其股东封测合伙于 2022 年 4 月 8 日出具《承诺函》：“合肥顾中控股、封测合伙承诺与顾中科技其他股东或其他第三方之间不存在任何一致行动、表决权委托、委托持股或信托持股等的协议或约定。”

其次，根据顾中控股（香港）及其股东顾邦科技于 2022 年 3 月 28 日出具《关于不谋求控制权的承诺函》：“本公司承诺与顾中科技其他股东或其他第三方之间不存在任何一致行动、表决权委托、委托持股或信托持股等的协议或约定。”

再次，根据芯屏基金及其股东合肥建投于 2022 年 4 月 7 日出具《承诺函》：“芯屏基金、合肥建投承诺与顾中科技其他股东或其他第三方之间不存在任何一致行动、表决权委托、委托持股或信托持股等的协议或约定。”

最后，截至本补充法律意见书之一出具之日，发行人股东芯屏基金除直接持有发行人股份外，还持有封测合伙 99.49%的合伙份额，并以此通过发行人股东合肥顾中控股间接持有发行人股份。此外，发行人股东珠海华金领翔与珠海华金丰盈的普通合伙人均为珠海华金领创基金管理有限公司。

综上，根据发行人持股 5%以上的主要股东出具的承诺及发行人股东的访谈记录和确认函，除上述已披露的情形外，发行人各股东之间不存在一致行动安排、表决权委托、控制关系或其它特殊关系。

**（二）发行人各股东是否均已认可公司的控制权状态**

截至本补充法律意见书之一出具之日，发行人持股 5%以上的主要股东合肥顾中控股、顾中控股（香港）、芯屏基金合计持有发行人 83.23%的股份。前述主要股东均已认可公司无实际控制人的状态并于顾中科技 IPO 申报材料报送前

即出具了相关承诺。

除上述持股 5% 以上的主要股东外，截至本补充法律意见书之一出具之日，发行人其他 18 名直接股东也均出具书面确认意见，确认硕中科技无控股股东和实际控制人的事实情况，并认可自 2019 年 1 月 1 日至今公司无实际控制人的状态未发生变更，且对此不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷。

综上，发行人各股东均已认可公司的控制权状态。

**四、无控股股东、实际控制人对公司生产经营稳定性的影响，各股东之间是否存在意见分歧时的解决机制，是否可能出现“公司僵局”及应对措施，公司主要股东未来的持股安排及计划，是否均已出具不谋求控制权的承诺，能否保持公司控制权结构、公司治理和生产经营的清晰、稳定。**

**（一）无控股股东、实际控制人对公司生产经营稳定性的影响，各股东之间是否存在意见分歧时的解决机制，是否可能出现“公司僵局”及应对措施**

**1、无控股股东、实际控制人对公司生产经营稳定性的影响**

报告期内，发行人具有规范有效的内部控制制度、稳定的核心管理团队、独立完整的业务体系、清晰稳定的股权结构，无论营业收入还是净利润均保持了较快增长，且公司产品及市场地位稳固，无控股股东、实际控制人的状态对公司经营稳定性不存在不利影响。具体分析如下：

**（1）发行人已建立健全的公司法人治理结构和规范有效的内部控制制度，并得到有效执行**

发行人已根据《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件的规定，设有健全的股东大会、董事会、监事会等内部治理结构，形成了权责明确、运作规范、相互制衡的公司治理机制。同时，发行人建立了独立董事制度、董事会秘书制度，并在董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会等专门委员会，完善的治理结构为发行人规范运作提供了制度保证。发行人根据监管部门对于上市公司治理的要求，制定了《公司章程》，制定和完善了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等法人治理制度文件，并在实际经营中严格遵照执行。

发行人在《公司章程》及其他内部治理制度中规定了公司股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、总经理等机构和人员的职权，明确了对外投资、对外担保、关联交易等各类重大事项的审议标准和决策程序。

报告期内，发行人主要股东通过行使股东权利向发行人委派或提名相应董事参与公司董事会决议，同时根据持有的表决权股份于股东大会行使股东权利，并按照《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》参与公司的经营决策。

在公司无实际控制人的情况下，公司股东大会、董事会和管理层均依照《公司章程》及其他内部治理制度的规定进行决策。一方面，通过股东大会、董事会审议及表决机制对日常经营活动中的重大事项进行决策；另一方面，公司管理层也根据股东大会及董事会的决议履行职权。

### **(2) 发行人已组建稳定的管理团队和核心技术团队**

发行人组建了稳定的管理团队和核心技术团队，相关人员在集成电路封装测试领域拥有丰富的工作经验和对行业的深刻理解。发行人的高级管理人员由董事会聘任，在发行人股东大会及董事会依法履职的情况下，董事会有权决定公司组织架构、高级管理人员的任免。同时，发行人建立了完善的人力资源制度，并一直注重营造良好的企业文化，改善工作环境和工作条件。发行人成立以来一直从事集成电路封装测试业务，主营业务清晰，管理团队和核心技术人员稳定。

为保证公司核心团队的稳定性，发行人设立员工持股平台，部分核心员工及业务骨干通过员工持股平台间接持有公司股份，由此增强了核心团队的凝聚力，有效保证了发行人经营管理的稳定性。

### **(3) 发行人已构建独立完整的业务体系**

发行人在资产、人员、财务、机构、业务方面与主要股东完全分离、相互独立。公司主要股东均已出具确认意见，明确未向发行人派驻管理人员和员工，不直接参与颀中科技的日常经营管理，亦不存在对颀中科技重大事项及日常经营管理的特殊安排。发行人构建了完整的采购、研发和销售系统，具有独立完整的业务体系和直接面向市场独立持续经营的能力。在无实际控制人的情况下，

发行人已从业务体系方面作出有效安排，能够保障经营业务的稳定性。

#### **(4) 发行人持股 5%以上股东均已出具严格的股份锁定承诺**

发行人持股 5% 以上的主要股东合肥硕中控股、硕中控股（香港）和芯屏基金合计持股比例达到 83.23%。三名直接股东均已出具股份锁定的承诺：“自发行人股票上市之日起 36 个月之内，不转让或者委托他人管理本公司/本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，不由发行人回购该部分股份。”通过对持股 5% 以上主要股东较为严格的股份锁定，有效保障了发行人股权结构的稳定，进而保障了发行人经营的稳定和可持续。

#### **(5) 发行人报告期内业绩持续增长并保持市场领先地位**

报告期内发行人实现营业收入 66,925.06 万元、86,866.74 万元和 132,034.14 万元，归属于母公司所有者的净利润分别为 4,128.73 万元、5,487.99 万元和 30,466.57 万元，营收规模持续提高，盈利能力不断提升。根据赛迪顾问的数据，最近连续三年，公司显示驱动芯片封测收入及封装芯片的出货量均位列中国境内第一、全球第三，并且在非显示类封测领域也保持较快增长，在行业内具有较高的知名度和影响力。

综上，发行人及其前身封测有限各权力机构依照适用的公司章程及其他内部治理制度规定的审议程序和决策权限作出重大决策，公司日常经营及重大决策制度运行良好。报告期内，公司业绩持续增长，并持续保持了中国大陆显示驱动芯片封装测试行业第一的市场地位。因此，无控股股东、实际控制人未对公司生产经营稳定性造成不利影响。

## **2、各股东之间是否存在意见分歧时的解决机制**

发行人已按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规及其他规范性文件的规定制定了符合上市公司治理要求的《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，发行人依照公司有关制度、依靠上述公司治理架构保证公司决策的有效性。公司及其股东、董事、高级管理人员不存在通过协议、公司治理制度或其他方式对日常经营活动中重大决策作出具体分工安排或对重大

分歧解决机制做出特殊安排的情况。

报告期内，发行人主要股东通过行使股东权利向发行人提名或委派相应董事参与董事会，同时根据持有的表决权股份于股东大会行使股东权利，并按照《公司章程》《董事会议事规则》《股东大会议事规则》参与公司的经营决策。各股东之间存在意见分歧时，将严格履行股东大会和董事会通过的相关决议。截至本补充法律意见书之一出具之日，发行人不存在股东在股东（大）会表决不一致的情况，未出现不能做出有效的股东（大）会决议的情形。

### **3、公司是否可能出现“公司僵局”及应对措施**

#### **（1）关于“公司僵局”的有关定义**

根据《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（二）》的规定，公司僵局情况包括：“（1）公司持续两年以上无法召开股东会或者股东大会，公司经营管理发生严重困难的；（2）股东表决时无法达到法定或者公司章程规定的比例，持续两年以上不能做出有效的股东会或者股东大会决议，公司经营管理发生严重困难的；（3）公司董事长期冲突，且无法通过股东会或者股东大会解决，公司经营管理发生严重困难的；（4）经营管理发生其他严重困难，公司继续存续会使股东利益受到重大损失的情形。”

#### **（2）发行人是否可能出现“公司僵局”及应对措施**

根据《公司法》和公司章程的规定，董事会、监事会、独立董事以及连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东均可以提议召集股东大会。因此无实际控制人状态不必然会导致无法召开股东大会。自设立至今，发行人股东大会（或股东会）均正常召开并作出有效决议，不存在持续两年以上无法召开股东大会（或股东会）的情形。因此，公司无控股股东、实际控制人的情形未导致公司出现《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（二）》规定的公司僵局的第（1）项情形。

公司股东均合法行使了自己的表决权，发行人报告期内未出现股东在股东（大）会表决不一致的情况、未出现不能做出有效的股东（大）会决议的情形。因此，公司无控股股东、实际控制人情形未导致公司出现《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（二）》规定的公司僵局的第（2）

项情形。

根据公司董事会的设置及提名情况，董事会目前有 9 名董事，其中 3 名为独立董事，其余 6 名经股东大会选举的董事中实际由芯屏基金提名 2 席、奕斯伟投资提名 2 席、硕中控股（香港）提名 1 席，剩余 1 席为合肥硕中控股提名的苏州硕中总经理。根据《公司法》和公司章程的规定，每名董事均享有平等的一票表决权，董事会决议由全部董事过半数通过作出。因此，在满足董事会出席人数的前提下，董事平等行使表决权，可以按照过半数的表决规则作出决议并提交股东大会审议。此外，公司设立至今，董事会均正常召开并作出有效决议，未出现“公司董事长期冲突，且无法通过股东会或者股东大会解决”的情形。因此，公司无控股股东、实际控制人情形未导致公司出现《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（二）》规定的公司僵局的第（3）项情形。

截至本补充法律意见书之一出具之日，公司各项治理机制运行良好，未出现过《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（二）》规定的公司僵局情形。

但是，在公司经营管理出现严重困难、公司股东的意见出现重大分歧等极端情况下，仍存在出现公司僵局的客观可能，假设出现董事会在重大决策方面长期无法形成有效决议的极端情况，根据《公司法》和《公司章程》的规定，可以由《公司法》和《公司章程》规定的其他主体召集股东大会审议相关事项（包括改选董事事项）以避免董事会层面的公司治理僵局，具体如下：（1）独立董事、监事会以及单独或合计持有公司 10% 以上股份的股东均可向董事会提议召开股东大会；（2）董事会不同意监事会召开临时股东大会提议的，或者在收到提案后十日内未作出回馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持；（3）董事会收到单独或合计持有公司 10% 以上股份的股东提出的书面要求后三十日内未发出召集会议通告的，提出该要求的股东可以在董事会收到该要求后四个月内自行召集会议。据此，发行人出现公司僵局的风险较低。

发行人已在招股说明书“重大事项提示”之“一、特别风险提示”之“（六）无实际控制人风险”和“第四节 风险因素”中进行补充披露。

**（二）公司主要股东未来的持股安排及计划，是否均已出具不谋求控制权的承诺，能否保持公司控制权结构、公司治理和生产经营的清晰、稳定**

**1、公司主要股东未来的持股安排及计划，是否均已出具不谋求控制权的承诺**

**（1）股份锁定承诺**

公司主要股东合肥顾中控股、顾中控股（香港）、芯屏基金均已出具《关于股份锁定、持股意向、减持意向及其约束措施的承诺函》，承诺：“自发行人股票上市之日起 36 个月之内，不转让或者委托他人管理本公司/本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，不由发行人回购该部分股份。”

**（2）不谋求控制权承诺**

首先，发行人第二大股东顾中控股（香港）及其股东顾邦科技已于 2022 年 3 月 28 日出具《关于不谋求控制权的承诺函》：

“本公司认可顾中科技无控股股东和实际控制人的事实情况，且该等事实情况自 2019 年 1 月 1 日至今未发生变更。本公司对顾中科技的股权投资系以获取投资收益为目的，本公司未向顾中科技派驻管理人员，亦不直接参与顾中科技的日常经营管理，本公司未曾且不会通过任何形式谋求顾中科技的控制权。本公司将采取所有必要的措施维持本公司所持有顾中科技股份比例与顾中科技第一大股东及其一致行动人（若有）相差 5 个百分点以上，并避免今后主动或被动成为公司的控股股东。

本公司承诺与顾中科技其他股东或其他第三方之间不存在任何一致行动、表决权委托、委托持股或信托持股等的协议或约定，并承诺不以任何方式单独或共同谋求顾中科技的控制权，且未来亦不会采取任何手段谋求顾中科技控股股东的地位，亦不会签署谋求顾中科技实际控制权的任何协议、安排或达成任何谋求顾中科技实际控制权的合意。

如本公司违反本承诺函的任何承诺，则本公司承担因此给其他任何一方造成的损失。若本公司所持有顾中科技股份比例与顾中科技第一大股东及其一致行动人（若有）相差少于 5 个百分点，就超出前述比例限制的股份，本公司承

诺，除通过行使正当股东权利提名且仅提名一名董事外，放弃超出前述比例限制的股份的表决权和提名权。”

其次，发行人第一大股东之间接股东封测合伙之合伙人奕斯伟投资及芯屏基金已于 2022 年 7 月 18 日联合出具《确认函》：

“1、本公司/本企业确认，本公司/本企业未向合肥硕中科技股份有限公司及其子公司（以下简称“硕中科技”）派驻管理人员和员工，不直接参与硕中科技的日常经营管理，亦不存在对硕中科技重大事项及日常经营管理的特殊安排。本公司/本企业确认硕中科技无控股股东和实际控制人的事实情况，并认可自 2019 年 1 月 1 日至今硕中科技无实际控制人的状态未发生变更。

2、2018 年 7 月，合肥硕中控股受让 Chipmore Holding Company Limited 所持合肥奕斯伟封测技术有限公司（硕中科技前身）部分股权。本公司/本企业作为合肥硕中控股及封测合伙的出资人，确认对硕中科技的股权投资不存在任何业绩承诺或类似安排，不以控制为目的，且承诺未来不违反封测合伙的合伙协议以单独或共同谋求硕中科技的控制权。

3、本公司/本企业确认，合肥奕斯伟投资有限公司（以下称“奕斯伟投资”）与合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）（以下称“芯屏基金”）不存在一致行动协议。合肥硕中控股向硕中科技提名（或委派）的董事中，除一致认可其中 1 席董事人选授权由合肥硕中控股提名（或委派）苏州硕中总经理担任外，其余董事均由奕斯伟投资和芯屏基金各自独立提名（或委派），不存在共同推选或联合提名（或委派）的情形。奕斯伟投资与芯屏基金不存在关联关系，不存在表决权委托、控制关系或委托持股、信托持股等其他约定或利益安排。

4、基于封测合伙的投资结构、合伙协议约定和实际情况，本公司/本企业确认，奕斯伟投资或芯屏基金均不能单独控制封测合伙，封测合伙不存在实际控制人，且双方均不谋求改变封测合伙的控制权现状。”

最后，发行人第三大股东芯屏基金已于 2022 年 7 月 18 日出具《确认函》：

“1、本企业未向合肥硕中科技股份有限公司及其子公司（以下简称“硕中科技”）派驻管理人员和员工，不直接参与硕中科技的日常经营管理，亦不存在对硕中科技重大事项及日常经营管理的特殊安排。本企业确认硕中科技无控股股

东和实际控制人的事实情况，并认可自 2019 年 1 月 1 日至今硕中科技无实际控制人的状态未发生变更。

2、本企业对于硕中科技的股权投资不以控制为目的，且承诺未来不违反合肥奕斯伟封测投资中心合伙企业（有限合伙）的合伙协议以单独或共同谋求硕中科技的控制权。本企业作为产业投资基金及硕中科技股东，将依法依规并依据公司章程行使股东权利，重视并支持硕中科技的持续发展。

3、本企业承诺与硕中科技其他股东不存在任何一致行动、表决权委托、委托持股或信托持股等的协议或约定。”

综上，公司主要股东已就其直接或间接持有的公司股份作出上市后 36 个月的锁定承诺，且均已出具不谋求控制权的承诺，发行人已在招股说明书“第十三节 附件”之“附件三 本次发行相关主体作出的重要承诺”之“（九）其他承诺事项”中补充披露不谋求控制权承诺的相关内容。

## **2、能否保持公司控制权结构、公司治理和生产经营的清晰、稳定**

发行人已按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规及其他规范性文件的规定制定了符合上市公司治理要求的《公司章程》，建立健全了内部治理制度和内部控制体系。公司及其股东、董事、高级管理人员不存在通过协议、公司治理制度或其他方式对日常经营活动中重大决策作出具体分工安排或对重大分歧解决机制做出特殊安排的情况。

发行人在《公司章程》及其他内部治理制度中规定了公司股东大会、董事会及其专门委员会、监事会、总经理等机构和人员的职权，明确了对外投资、对外担保、关联交易等各类重大事项的审议标准和决策程序。报告期内，公司董事会、监事会和股东（大）会均正常召开。

在公司无实际控制人的情况下，公司管理层、董事会、股东大会依照《公司章程》及其他内部治理制度的规定进行决策，通过董事会、股东大会审议及表决机制对日常经营活动中的重大事项进行决策并解决可能出现的重大分歧，公司管理层根据股东大会及董事会的决议履行职权。

按照发行人本次拟公开发行股份 20,000 万股计算（不考虑行使超额配售选择权发行的股份），本次公开发行后，合肥硕中控股、硕中控股（香港）及芯屏

基金分别持有发行人 33.40%、25.43%及 10.40%的股份，不会对公司控制权结构、公司治理和生产经营的清晰、稳定造成负面影响。

综上所述，公司控制权结构清晰、稳定，且已建立健全的内部治理制度和内部控制体系等重大事项决策机制能够保持公司治理和生产经营的清晰、稳定。

## 【核查情况】

### 一、核查程序

针对上述事项，本所律师履行了以下核查程序：

1、取得发行人及相关股东出具的相关说明文件、书面确认函或承诺函，并访谈了合肥颀中控股、颀邦科技、合肥建投和芯屏基金主要负责人等；

2、查阅发行人的工商档案材料，历次增资和股权转让所签署的相关协议、股权转让和增资的价款支付凭证、中企华评估出具的《资产评估报告》及相关国有资产评估备案文件；

3、查阅《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《企业国有资产交易监督管理办法》《企业国有资产评估管理暂行办法》等国有资产管理法律法规及相关文件；

4、查阅《投资框架协议》及相关国资审批文件；

5、查阅《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等法律和公司内部治理制度以及三会文件；

6、查阅合肥市国资委出具的《关于确认合肥颀中科技股份有限公司历史沿革中涉及国有股权变动事项合规性的函》等书面确认文件。

### 二、核查意见

经核查，本所认为：

1、在全球集成电路产业转移及大陆半导体显示行业兴起的产业背景下，2018年封测有限设立、后续股份转让及增资事宜实现了投资方奕斯伟集团、芯屏基金以及转让方颀邦科技的合作利益，且支持了发行人业务的持续发展；

2、基于产业及市场趋势、颀中科技业务扩张需求、投资回报和公司治理等原因，颀中控股（香港）放弃公司控制权具有合理性。此外，颀中控股（香港）认可苏州颀中管理团队对公司日常经营的主导权且无实控人状态对发行人业务发展不会造成不利影响；

3、封测有限 2018 年设立、后续股权转让及增资事项系一揽子安排，有关股东之间不存在其他约定或利益安排；

4、2018 年 7 月股权转让及 2018 年 8 月增资的定价依据系参照上述经由国资备案的资产评估报告之评估结果，前述股权转让及增资的作价依据公允并已履行相关国有资产审批程序。合肥市国资委已出具确认意见，该等事宜不存在可能损害国有股东权益及造成国有资产流失的情形；

5、截至本补充法律意见书之一出具之日，除已披露的情形外，发行人各股东之间不存在一致行动安排、表决权委托、控制关系或其它特殊关系；

6、发行人全体股东均已书面认可公司无实际控制人的控制权状态；

7、发行人各权力机构依照适用的公司章程及其他内部治理制度规定的审议程序和决策权限作出重大决策，公司日常经营及重大决策制度运行良好。无控股股东和实际控制人的状态不会对公司经营稳定性产生不利影响；

8、发行人依照公司有关制度和公司治理架构保证公司决策的有效性。截至本补充法律意见书之一出具之日，公司各项治理机制运行良好，不存在《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国公司法〉若干问题的规定（二）》规定的公司僵局情形；

9、公司 5%以上主要股东均已披露未来持股安排及计划且均已出具不谋求控制权的承诺。公司控制权结构清晰、稳定，且已建立内部治理制度和内部控制体系等重大事项决策机制，能够保持公司治理和生产经营的清晰、稳定。

## 1.2 关于控股股东、实控人认定

根据申报材料和公开资料：**（1）合肥颀中控股的控股股东封测合伙（持股比例为 99.9994%）是由奕斯伟投资（北京奕斯伟集团控制的企业）担任 GP（持有 0.5149%的合伙份额）以及芯屏基金担任 LP（持有 99.4851%的合伙份**

额)的合伙企业。根据合伙协议等相关约定,重大投资决策应由双方一致同意;

(2)芯屏基金(合肥国资直属合肥建投控制的基金平台)直接及通过合肥顾中控股间接持有公司超过50%股份,除投资发行人外,还布局了显示产业链其他企业。根据奕斯伟投资控股股东北京奕斯伟集团的官方网站,其核心事业涵盖先进封测领域;(3)公司成立以来,奕斯伟投资和芯屏基金合计可提名半数以上董事,其中2020年9月前后比例为4/7、5/6,股改后比例为7/9。同时,二者共同提名公司总经理为董事人选;(4)顾邦科技为公司第二大股东顾中控股(香港)的控股股东,亦从事半导体封测业务,为发行人同行业可比公司。

请发行人按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书》(以下简称《招股书准则》)第41条的规定,参照控股股东及实际控制人的要求披露对发行人有重大影响的股东情况,相关股东应披露至最终的国有控股主体、集体组织、自然人等。

请发行人说明:(1)合肥顾中控股的股权结构设置、决策机制及主要考虑,合肥市国资委、奕斯伟投资及顾邦科技在公司业务发展、运行管理中发挥的作用及提供的资源情况;(2)根据《公司法》第216条、《科创板股票发行上市审核问答(二)》第5项等有关规定,并结合合肥顾中控股的持股比例及董事会提名情况,分析其是否为发行人控股股东;(3)芯屏基金既直接持有发行人股份又通过合肥顾中控股持股的主要考虑,合肥市国资委合计间接持有公司股份的情况,是否存在对发行人重大事项及日常经营管理的特殊安排,依其所享有的表决权是否足以对公司股东大会的决议产生重大影响,是否实质控制发行人;(4)合肥顾中控股与芯屏基金是否构成《上市公司收购管理办法》第83条规定的一致行动关系,奕斯伟投资和芯屏基金约定均不控制封测合伙的原因,该等约定安排是否具有稳定性,是否符合合伙企业的实际运行情况及《合伙企业法》关于有限合伙企业的有关规定。请结合重大投资决策应由双方一致同意、对发行人董事高管提名及日常经营管理等方面,说明二者是否共同控制发行人;(5)结合前述重要股东自身及关联企业的实际经营业务,分析是否通过无控股股东、无实际控制人认定规避同业竞争监管要求。

请保荐机构、发行人律师对上述事项进行核查并发表明确意见,并提供合肥顾中控股的股东投资协议、封测合伙的合伙协议。

回复：

### 【发行人披露】

发行人已按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 41 号——科创板公司招股说明书》第 41 条的规定在招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“八、持有发行人 5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况”之“（一）持有发行人 5%以上股份的股东”进行补充披露。

### 【发行人说明】

一、合肥顾中控股的股权结构设置、决策机制及主要考虑，合肥市国资委、奕斯伟投资及顾邦科技在公司业务发展、运行管理中发挥的作用及提供的资源情况

#### （一）合肥顾中控股的股权结构设置、决策机制及主要考虑

合肥市国资委下属企业合肥建投及其投资平台芯屏基金因看好发行人及集成电路封测产业的发展，并希望在合肥当地加快形成更加完善的集成电路产业链，故以战略投资人身份成为发行人股东，并非意图控制发行人。

封测合伙成立后，通过设立合肥顾中控股间接持有发行人股份而非直接持股主要考虑未来如引入其他社会资本，可在合肥顾中控股层面持股，并依据《公司法》和《公司章程》参与公司治理，进而有助于保持封测合伙层面相关决策机制的稳定。

此外，根据《公司法》第五十七条：“一人有限责任公司，是指只有一个自然人股东或者一个法人股东的有限责任公司”，即封测合伙无法单独设立有限公司。因此，由封测合伙和奕斯伟投资共同出资设立合肥顾中控股。

截至本补充法律意见书之一出具之日，合肥顾中控股的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	合肥奕斯伟封测投资中心 合伙企业（有限合伙）	170,000.00	99.9994
2	合肥奕斯伟投资有限公司	1.00	0.0006
合计		<b>170,001.00</b>	<b>100.0000</b>

根据合肥顾中控股现行有效的《公司章程》的规定：“股东会会议作出修改

公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散或者变更公司形式的决议，必须经代表三分之二以上表决权的股东通过；其余决议必须经代表二分之一以上表决权的股东通过。”“董事会议实行一人一票和按出席会议的董事人数少数服从多数记名表决制度。当赞成和反对票数相等时，董事长有权作最后决定。”“公司召开董事会议，须由半数以上董事出席方可举行。董事会议作出决议，须经全体董事过半数通过方为有效。”截至本补充法律意见书之一出具之日，合肥顾中控股的董事会、股东会按照《公司章程》的规定分别行使其作为发行人股东的决策权。根据《公司法》和合肥顾中控股《公司章程》的规定，其控股股东为封测合伙，关于封测合伙的出资结构和决策机制详见本题回复之第四部分相关内容。

## **（二）合肥市国资委、奕斯伟投资及顾邦科技在公司业务发展、运行管理中发挥的作用及提供的资源情况**

顾中科技的前身封测有限于 2018 年初设立，随后顾邦科技通过转让公司的控制权并引进其他投资者，使发行人股东结构实现了多元化。合肥市国资委、奕斯伟集团在入股发行人之前后，均未参与发行人及子公司苏州顾中的日常运营管理。

根据发行人间接股东奕斯伟投资、顾邦科技以及直接股东芯屏基金确认，公司主要股东均未向顾中科技及其子公司派驻管理人员和员工，不直接参与顾中科技的日常经营管理，亦不存在对顾中科技重大事项及日常经营管理的特殊安排。虽然合肥国资委下属芯屏基金、顾邦科技和奕斯伟投资对顾中科技的股权投资均不以控制为目的，但作为公司股东均重视、关心并支持顾中科技的发展。具体如下：

首先，从资金支持看，为落实国家发展集成电路产业的号召，并契合当地政府集成电路的产业布局，充分发挥产业集群协同作用，奕斯伟投资与合肥市国资委筹划共同投资发展集成电路封测产业，并通过 2018 年对发行人的投资和增资，为发行人的业务发展和产能扩张提供了宝贵的资金支持。

其次，从产业支持看，顾中科技所从事的先进封装产业是合肥市集成电路产业发展的重要组成部分，而芯屏基金作为合肥“芯、屏”产业引导基金，其上

级主管单位和当地政府部门为发行人在合肥当地投资建厂，并充分发挥产业链上下游协同和产业集聚效应创造了有利条件。根据芯屏基金出具的《承诺函》，“本企业作为产业投资基金及硕中科技股东，将依法依规并依据公司章程行使股东权利，重视并支持硕中科技的持续发展。”

再次，从决策参与看，报告期内，发行人主要股东芯屏基金、奕斯伟投资和硕邦科技除依据公司章程行使股东权利外，还通过委派或提名董事的方式参与公司重大事项的决策，相关委派或提名的董事在完善公司治理、市场前景分析和上下游产业理解等方面，也从自身的视角向发行人管理团队提出了很多宝贵的建议和意见，为公司发展出谋划策。

最后，从规范治理和独立经营看，截至报告期末，发行人已按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规及其他规范性文件的规定制定了符合上市公司治理要求的《公司章程》，建立健全了内部治理制度和内部控制体系。公司主要股东依照《公司章程》及其他内部治理制度的规定进行独立决策；且发行人与其主要股东在资产、人员、业务、财务和机构等方面均保持了相互独立，具有完全独立的业务运作体系和独立面向市场自主经营的能力。

**二、根据《公司法》第 216 条、《科创板股票发行上市审核问答（二）》第 5 项等有关规定，并结合合肥硕中控股的持股比例及董事会提名情况，分析其是否为发行人控股股东**

根据《公司法》第 216 条的规定：“控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。”又根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答（二）》（以下简称“《审核问答（二）》”）第 5 条的规定：“发行人股权较为分散但存在单一股东控制比例达到 30% 的情形的，若无相反的证据，原则上应将该股东认定为控股股东或实际控制人。”

综合上述法规及规则，虽然合肥硕中控股持股比例超过了 30%，但发行人不属于“股权较为分散但存在单一股东控制比例达到 30% 的情形”，且结合发行

人的股权结构、董事会选举机制及提名情况以及发行人日常经营管理等实际情况，合肥顾中控股持有的股份比例并不足以对发行人股东大会的决议产生重大且决定性影响，因此合肥顾中控股不是发行人的控股股东。具体分析如下：

**（一）发行人不存在股权较为分散但单一股东控制比例达到 30% 的情形**

2018 年 8 月以来，发行人主要股东所持发行人的股权结构变动情况如下：

序号	股东名称	出资/持股比例（%）	
		2018年8月增资后	2021年5月增资后至今
1	合肥顾中控股	41.82	40.15
2	顾中控股（香港）	31.85	30.57
3	芯屏基金	13.02	12.50

根据上述股权结构变动情况，发行人自 2018 年 8 月增资后，前三大主要股东始终合计持有发行人超过 83% 的股份，发行人股权结构较为集中。本次发行前，除合肥顾中控股外，顾中控股（香港）的持股比例也超过了 30%，且合肥顾中控股与顾中控股（香港）、芯屏基金之间不存在任何一致行动、表决权委托、委托持股或信托持股等的协议或约定。因此，发行人既不存在《公司法》第 216 条所称“出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东”，也不属于《审核问答（二）》第 5 项“股权较为分散但存在单一股东控制比例达到 30% 的情形”。

**（二）虽然合肥顾中控股持股比例超过了 30%，但依其持有的股份所享有的表决权不足以对股东大会决议产生决定性影响**

虽然合肥顾中控股持股比例超过了 30%，但由于第二大股东顾中控股（香港）和第三大股东芯屏基金合计持股比例自 2018 年 8 月起始终超过合肥顾中控股，且在合肥顾中控股与发行人其他股东之间均不存在任何一致行动、表决权委托、委托持股或信托持股等的协议或约定的情况下，公司前三大股东在发行人股东（大）会层面均有权独立进行表决，因此合肥顾中控股持有股份所享有的表决权不足以对股东大会决议产生决定性影响。

结合《公司法》第 216 条“控股股东，是指……；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东”的规定，在“股东出资额或者

持有股份的比例不足百分之五十的情况下是否能够对股东大会的决议产生重大影响”需要根据实际情况确认，持股比例超过 30% 并不必然属于“足以对股东大会的决议产生重大影响的股东”，即并不必然将其认定为“控股股东”。经查询 A 股上市公司可比案例的情况，也存在“股东持股比例超过 30%（且不足 50%），但不认定为控股股东”的情形。具体情况如下：

公司名称	IPO 发行前股权结构及相关论述	控制权状态
上声电子 (688533.SH)	上声投资持有发行人 35.00% 的股权，同泰投资持有发行人 25.00% 的股权，元和资产持有发行人 24.16% 的股权，元件一厂持有发行人 15.84% 的股权。除元件一厂系元和资产全资子公司外（合计表决权比例为 40%），发行人各股东间不存在其他关联关系或一致行动关系。公司不存在控制 50.00% 以上股东。	无控股股东、无实际控制人
安路科技 (688107.SH)	第一大股东华大半导体持股 33.34%，并承诺自公司上市之日起五年内且作为第一大股东期间不谋求控制权；第二大股东上海安芯及一致行动人（为创始人及核心管理层等持股平台）合计持股 26.10%，并承诺不谋取控制权，公司不存在持股 50% 以上的股东。	无控股股东、无实际控制人
南微医学 (688029.SH)	隆晓辉先生及其控制的第一大股东微创咨询合计持有发行人 32.15% 的股份，第二大股东中科招商持有发行人 30.18% 的股份，第三大股东 Huakang 持有发行人 20.52% 的股份，发行人任何单一股东均无法控制股东大会从而实际控制发行人。	无控股股东、无实际控制人
神工股份 (688233.SH)	合并计算一致行动人持有的公司股份，前三大股东及一致行动人分别持有发行人 33.04%、30.84%、29.28% 的股份。不存在单一投资者及其一致行动人通过实际支配公司股份表决权能够足以对股东大会的决议产生重大影响。	无控股股东、无实际控制人
瑞华泰 (688323.SH)	前四大股东持股分别为 31.17%、15.16%、13.05%、11.37%。无单一股东及其关联方或一致行动人控制公司 50% 以上表决权股份，无单一股东及其关联方或一致行动人可以基于其所持表决权股份对公司决策形成实质性控制。	无控股股东、无实际控制人

如上表所示，虽然上述五家上市公司都存在持股比例超过 30% 的第一大股东，但由于依其持有的股份所享有的表决权不足以对股东大会决议产生决定性影响，因此均认定为无控股股东。

此外，虽然根据《公司法》第 216 条、《科创板股票发行上市审核问答（二）》第 5 项等有关规定，未明确提及控股股东的认定与能否决定董事会席位过半数席位有关。但根据发行人现行有效的《公司章程》，公司董事会由 9 名董

事组成（其中独立董事 3 名），经股东大会选举产生。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。即使合肥硕中控股提名的董事，也应当通过股东大会选举。虽然合肥硕中控股持股比例超过了 30%，但发行人现行及上市后的董事选举制度均不足以确保其提名的董事必然通过股东大会选举，因此其无法决定董事会全体董事的过半数席位。

综上所述，结合《公司法》及《审核问答（二）》的相关规定，并结合发行人实际情况、股东自身认定以及 A 股上市公司可参考的案例，合肥硕中控股并非硕中科技的控股股东。同时，公司全体股东均已书面确认硕中科技无控股股东和实际控制人的事实状态，体现了《审核问答（二）》第 5 项中“在确定公司控制权归属时，应当本着实事求是的原则，尊重企业的实际情况，以发行人自身的认定为主，由发行人股东予以确认”的原则和要求。

**三、芯屏基金既直接持有发行人股份又通过合肥硕中控股持股的主要考虑，合肥市国资委合计间接持有公司股份的情况，是否存在对发行人重大事项及日常经营管理的特殊安排，依其所享有的表决权是否足以对公司股东大会的决议产生重大影响，是否实质控制发行人**

**（一）芯屏基金既直接持有发行人股份又通过合肥硕中控股持股的主要考虑**

芯屏基金系合肥建投为响应国家发展集成电路产业的号召，特别是为布局、带动和加快合肥市“芯”“屏”产业全面发展而设立的产业投资基金。2017 年至 2018 年期间，经奕斯伟集团、合肥建投及其下属芯屏基金与硕邦科技协商一致，芯屏基金同意以战略投资人的身份投资入股硕中科技，以推动合肥当地集成电路先进封装产业的发展，进一步打造半导体显示产业集群。2018 年 7 月后，芯屏基金既直接持有发行人股份又通过合肥硕中控股持股的主要原因如下：

一方面，从主观投资目的看，结合问题 1 中针对本次交易背景的回复，合肥建投及其下属芯屏基金虽然作为最大的出资方，但其本次投资以因地制宜发展“芯、屏”产业为目的，体现了以促进产业集聚为目的的“合肥模式”特色。同时，为延续管理团队对公司经营的主导权，并不以取得硕中科技的控制权为目的。因此，合肥建投一方面通过和奕斯伟投资共同成立封测合伙，并约定封测

合伙对被投资项目的投资和处置决定需得到投资决策委员会全体成员一致同意方为有效，在保障了国资必要权利的同时，使得任何一方均无法单独决策封测合伙对项目的投资和处置决议，从而无法控制合肥顾中控股；另一方面又通过其下属芯屏基金作为战略投资主体直接持股顾中科技，有利于芯屏基金独立行使顾中科技的股东权利，并独立决定对顾中科技的投资和处置，也有利于提升芯屏基金的资金使用效率，相关安排进一步体现了其不以控制为目的的投资初衷，也构成了发行人主要股东 2018 年实施本次交易的前提条件；

另一方面，从客观历史原因看，根据合肥市国资工作领导小组 2017 年第 7 次组长会议于 2017 年 12 月 20 日审议通过的“合肥建投和芯屏基金对封测有限的投资事项”，以及合肥市国资委于 2018 年 7 月 6 日出具《关于合肥市建投集团调整双子项目出资主体事宜的反馈意见》（合国资办[2018]92 号），上述战略投资原计划由合肥建投与芯屏基金共同出资，后因合肥建投资金紧张，而芯屏基金资金充裕，因此合肥建投拟将其所持封测合伙的认缴份额通过协议转让方式改为芯屏基金持有。根据合肥市国资委反馈意见，认为前述出资主体调整事项原则上符合《企业国有资产交易监督管理办法》第三十一条第二款的规定，有利于进一步提高资金使用效率。后经合肥市国资工作领导小组 2018 年第 4 次组长会议于 2018 年 8 月 14 日正式审议通过封测合伙变更出资主体事项，同意合肥建投调整封测合伙出资主体为芯屏基金。因此，上述变更出资主体事项也客观上导致了当前芯屏基金既直接持有发行人股份，又通过历史上受让其控制方合肥建投对封测合伙的份额从而通过合肥顾中控股间接持有发行人股份。

综上，基于主观投资目的及前述历史原因导致的出资主体变更，芯屏基金既直接持有发行人股份又通过合肥顾中控股持股具有合理性。

## （二）合肥市国资委合计间接持有公司股份的情况

截至本补充法律意见书之一出具之日，芯屏基金系合肥建投控制的主体并直接持有发行人 12.50% 的股份，合肥建投是合肥市国资委出资的国有全资企业，经穿透芯屏基金的出资结构，合肥市国资委间接持有芯屏基金 99.9401% 的财产份额，合肥市国资委通过芯屏基金间接持有发行人 12.49% 的股份。

截至本补充法律意见书之一出具之日，合肥顾中控股直接持有发行人

40.15%的股份，经穿透合肥顾中控股的股权结构，封测合伙持有其 99.9994%的股权，芯屏基金持有封测合伙 99.4851%的财产份额，合肥市国资委间接持有芯屏基金 99.9401%的财产份额，合肥市国资委通过合肥顾中控股间接持有发行人 39.91%的股份。

综上，虽然合肥市国资委通过合肥顾中控股和芯屏基金合计间接持有发行人 52.41%的股份财产权益，但由于其中 39.91%的股份财产权益系通过以有限合伙人身份入伙封测合伙从而间接持有发行人股份所形成，因而合肥市国资委及其下属合肥建投、芯屏基金依其持有的股份所控制的表决权比例低于其间接持有的合计股份财产权益。

**（三）是否存在对发行人重大事项及日常经营管理的特殊安排，依其所享有的表决权是否足以对公司股东大会的决议产生重大影响，是否实质控制发行人**

根据发行人的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》等内部治理制度文件，并经芯屏基金书面确认：

“1、本企业未向合肥顾中科技股份有限公司及其子公司（以下简称“顾中科技”）派驻管理人员和员工，不直接参与顾中科技的日常经营管理，亦不存在对顾中科技重大事项及日常经营管理的特殊安排。本企业确认顾中科技无控股股东和实际控制人的事实情况，并认可自 2019 年 1 月 1 日至今顾中科技无实际控制人的状态未发生变更。

2、本企业对顾中科技的股权投资不以控制为目的，且承诺未来不违反合肥奕斯伟封测投资中心合伙企业（有限合伙）的合伙协议以单独或共同谋求顾中科技的控制权。本企业作为产业投资基金及顾中科技股东，将依法依规并依据公司章程行使股东权利，重视并支持顾中科技的持续发展。

3、本企业承诺与顾中科技其他股东不存在任何一致行动、表决权委托、委托持股或信托持股等的协议或约定。”

如前所述，虽然合肥国资委通过合肥顾中控股和芯屏基金合计间接持有发行人 52.41%的股份财产权益，但由于其中 39.91%的股份财产权益系通过以有限合伙人身份入伙封测合伙从而间接持有发行人股份所形成。又根据封测合伙

的合伙协议约定及全体合伙人一致确认，基于封测合伙的投资结构、合伙协议约定和实际情况，奕斯伟投资或芯屏基金均不能单独控制封测合伙，封测合伙不存在实际控制人。因而合肥国资委及其下属合肥建投、芯屏基金依其持有的股份所控制的表决权比例为芯屏基金所直接持有发行人 12.50% 股份对应的表决权，不足以对公司股东大会的决议产生重大影响，不存在实质控制发行人的情形。

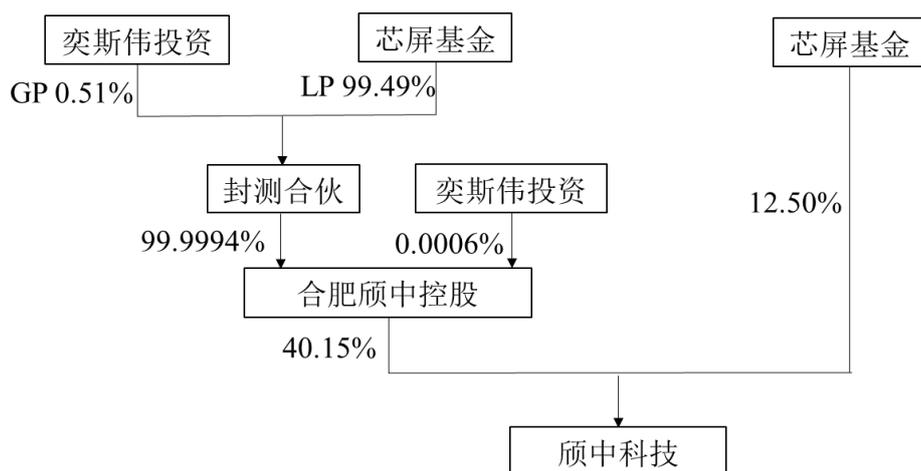
综上，合肥市国资委及芯屏基金不存在对发行人重大事项及日常经营管理的特殊安排，依其所享有的表决权不足以对公司股东大会的决议产生决定性影响，不存在实质控制发行人的情形。

**四、合肥颀中控股与芯屏基金是否构成《上市公司收购管理办法》第 83 条规定的一致行动关系，奕斯伟投资和芯屏基金约定均不控制封测合伙的原因，该等约定安排是否具有稳定性，是否符合合伙企业的实际运行情况及《合伙企业法》关于有限合伙企业的有关规定。请结合重大投资决策应由双方一致同意、对发行人董事高管提名及日常经营管理等方面，说明二者是否共同控制发行人**

**（一）合肥颀中控股与芯屏基金是否构成《上市公司收购管理办法》第 83 条规定的一致行动关系**

根据《上市公司收购管理办法》第 83 条的规定，在上市公司的收购及相关股份权益变动活动中有一致行动情形的投资者，互为一致行动人。一致行动，是指投资者通过协议、其他安排，与其他投资者共同扩大其所能够支配的一个上市公司股份表决权数量的行为或者事实。同时，第 38 条第二款规定了：“如有相反证据的，则可认定其不存在一致行动关系。”据此，合肥颀中控股与芯屏基金不构成《上市公司收购管理办法》第 83 条规定的一致行动关系的论证情况如下：

合肥颀中控股的控股股东系封测合伙，封测合伙的合伙人系奕斯伟投资和芯屏基金。其中，芯屏基金系已在中国证券投资基金业协会进行私募基金备案（编号为 SM7232），执行事务合伙人与私募基金管理人系合肥建投资本管理有限公司。



如上图所示并经奕斯伟投资和芯屏基金确认，奕斯伟投资与芯屏基金不存在关联关系，不存在股权控制关系，相互之间亦不存在表决权委托或一致行使表决权的有关协议或其他协议约定。

基于上述事实情况，发行人根据《上市公司收购管理办法》第 83 条的规定，逐条核查了合肥顾中控股与芯屏基金是否构成法规推定的一致行动人，具体情况如下：

序号	规定	情况说明
1	投资者之间有股权控制关系	截至本补充法律意见书之一出具之日，经穿透合肥顾中控股的股权结构，封测合伙持有其99.9994%的股权。芯屏基金系封测合伙的有限合伙人，根据《合伙企业法》的规定和封测合伙现行有效的《合伙协议》的规定，芯屏基金无法控制封测合伙，进而无法控制合肥顾中控股，不符合本条规定。
2	投资者受同一主体控制	芯屏基金的控股方为合肥建投，合肥建投通过其子公司合肥建投资本管理有限公司控制芯屏基金。合肥顾中控股的控股股东为封测合伙，封测合伙系无实际控制人的合伙企业。因此，合肥顾中控股与芯屏基金不属于同一主体控制，不符合本条规定。
3	投资者的董事、监事或者高级管理人员中的主要成员，同时在另一个投资者担任董事、监事或者高级管理人员	芯屏基金作为有限合伙企业，其不存在董事、监事、高级管理人员之设置，不符合本条规定。
4	投资者参股另一投资者，可以对参股公司的重大决策产生重大影响	芯屏基金作为有限合伙人持有合肥顾中控股股东封测合伙99.49%的份额，并通过合肥顾中控股间接持有发行人股权。
5	银行以外的其他法人、其他组织和自然人为投资者取得相关股份提供融资安排	不适用
6	投资者之间存在合伙、合作、联营等其他经济利益关系	不适用

序号	规定	情况说明
7	持有投资者30%以上股份的自然人，与投资者持有同一上市公司股份	不适用
8	在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，与投资者持有同一上市公司股份	不适用
9	持有投资者30%以上股份的自然人和在投资者任职的董事、监事及高级管理人员，其父母、配偶、子女及其配偶、配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹及其配偶等亲属，与投资者持有同一上市公司股份	不适用
10	在上市公司任职的董事、监事、高级管理人员及其前项所述亲属同时持有本公司股份的，或者与其自己或者其前项所述亲属直接或者间接控制的企业同时持有本公司股份	不适用
11	上市公司董事、监事、高级管理人员和员工与其所控制或者委托的法人或者其他组织持有本公司股份	不适用
12	投资者之间具有其他关联关系	不适用

如上表所示，合肥顾中控股与芯屏基金符合上述规定的“投资者参股另一投资者，可以对参股公司的重大决策产生重大影响”，但根据《上市公司收购管理办法》的规定，对于法规推定的一致行动人，如有相反证据的，则可以认定其不存在一致行动关系，故认定其是否构成一致行动关系需结合各方是否存在一致行动的意图和相反证据来判断。合肥顾中控股与芯屏基金虽然存在股权关系，但不构成一致行动关系，具体原因如下：

### 1、根据股权（投资）结构，合肥顾中控股与芯屏基金不属于同一控制

一方面，芯屏基金的控制方为合肥建投，其直接持有芯屏基金 47.44% 的出资额，并通过合肥建投控股子公司合肥建投资本管理有限公司控制芯屏基金；另一方面，合肥顾中控股的控股股东为封测合伙，封测合伙系无实际控制人的合伙企业。因此，合肥顾中控股与芯屏基金不属于同一控制权下的关联企业。

另根据前述交易背景的介绍，芯屏基金对发行人的投资不以控制为目的，且不谋求控制权。如果合肥国资以控制为目的，则应全部直接持股而没有与奕斯伟集团合资设立合肥顾中控股的必要性。因此，该等股权（投资）结构的设定，是“芯屏基金意在独立行使决策权，避免与合肥顾中控股形成一致行动人”的证据之一。

## **2、根据合伙企业决策机制，芯屏基金无法单独决定对合肥颀中控股的投资决策**

芯屏基金对奕斯伟投资不存在股权关系、控制关系，芯屏基金不存在通过控制奕斯伟投资而间接控制封测合伙的情形。根据封测合伙合伙协议的约定，封测合伙设投资决策委员会，奕斯伟投资委派 2 名委员，芯屏基金委派 1 名委员。对被投资项目的投资和处置决定，需得到投资决策委员会全体成员一致同意方为有效。因此，芯屏基金无法单方决策封测合伙对项目的投资和处置决议，从而对合肥颀中控股的投资决策形成独立控制。

## **3、根据各方出具的确认与承诺，芯屏基金与合肥颀中控股不存在任何一致行动、表决权委托、委托持股或信托持股等的协议或约定**

### **(1) 芯屏基金及合肥建投的声明**

芯屏基金、合肥建投于 2022 年 4 月 7 日出具《承诺函》：“芯屏基金、合肥建投承诺与颀中科技其他股东或其他第三方之间不存在任何一致行动、表决权委托、委托持股或信托持股等的协议或约定。”

### **(2) 合肥颀中控股及封测合伙的声明**

合肥颀中控股及其控股股东封测合伙于 2022 年 4 月 8 日出具《承诺函》：“合肥颀中控股、封测合伙承诺与颀中科技其他股东或其他第三方之间不存在任何一致行动、表决权委托、委托持股或信托持股等的协议或约定。”

### **(3) 封测合伙全体合伙人的声明**

根据合肥颀中控股控股股东封测合伙全体合伙人出具的《确认函》：“合肥奕斯伟投资有限公司（以下称“奕斯伟投资”）与合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）（以下称“芯屏基金”）不存在一致行动协议。合肥颀中控股向颀中科技提名（或委派）的董事中，除一致认可其中 1 席董事人选授权由合肥颀中控股提名（或委派）苏州颀中总经理担任外，其余董事均由奕斯伟投资和芯屏基金各自独立提名（或委派），不存在共同推选或联合提名（或委派）的情形。奕斯伟投资与芯屏基金不存在关联关系，不存在表决权委托、控制关系或委托持股、信托持股等其他约定或利益安排。”

因此，合肥顾中控股和芯屏基金在发行人历次股东（大）会中均独立表决，不存在《上市公司收购管理办法》第 83 条规定的共同扩大其所能够支配的发行人股份表决权数量的行为或者事实。

综上，根据上述论述，合肥顾中控股与芯屏基金不存在《上市公司收购管理办法》第 83 条规定的共同扩大其所能够支配的发行人股份表决权数量的行为或者事实，不构成《上市公司收购管理办法》第 83 条规定的一致行动关系。

此外，根据《上市公司收购管理办法》（2020 年 3 月修订）第一条之规定，该等办法旨在规范上市公司的收购及相关股份权益变动活动。根据该等立法精神，对于 IPO 企业而言，应当避免通过“推定一致行动关系”的情形规避股份锁定或权益变动等信息披露要求。为此，公司主要股东合肥顾中控股、顾中控股（香港）、芯屏基金均已出具《关于股份锁定、持股意向、减持意向及其约束措施的承诺函》，承诺：“自发行人股票上市之日起 36 个月之内，不转让或者委托他人管理本公司/本企业直接和间接持有的发行人首次公开发行 A 股股票前已发行的股份，不由发行人回购该部分股份。”因此，虽然合肥顾中控股与芯屏基金不构成《上市公司收购管理办法》第 83 条规定的一致行动关系，但均比照控股股东的要求，通过一致自愿锁定等方式满足了《上市公司收购管理办法》的立法精神，不存在通过“推定一致行动关系”的情形规避股份锁定或权益变动信息披露要求的情形。

**（二）奕斯伟投资和芯屏基金约定均不控制封测合伙的原因，该等约定安排是否具有稳定性，是否符合合伙企业的实际运行情况及《合伙企业法》关于有限合伙企业的有关规定**

**1、奕斯伟投资和芯屏基金均不控制封测合伙的原因，该等约定安排是否具有稳定性**

首先，根据封测合伙现行有效的《合伙协议》约定以及其实际经营情况，封测合伙的经营范围和主营业务为投资，其合伙目的为发展合肥集成电路封测产业。因此，对拟投或被投项目的投资及处置决策权是以投资为主营业务的封测合伙之最核心的权力。

根据《合伙协议》第二十六条约定：“为提高投资决策的专业化程度，控制

投资风险，合伙企业设投资决策委员会负责对项目的投资和处置进行决策。投资决策委员会成员 3 人，由普通合伙人委派 2 人，有限合伙人或其指定主体委派 1 人。对被投资项目的投资和处置决定，需得到投资决策委员会全体成员一致同意方为有效。”根据该等约定，投资决策委员会（以下简称“投委会”）拥有合伙企业投资和处置的决策权。在人员构成上，该投委会现有合伙人均有权委派投委会成员；在决策机制上，则需得到全体成员一致同意方为有效。因此，奕斯伟投资和芯屏基金均不能单独控制封测合伙，封测合伙不存在实际控制人。

其次，根据《合伙协议》第七条之约定，封测合伙的存续期限为十年，自合伙企业成立之日起计算。期满后经全体合伙人同意可延续延长期限。根据该等约定，封测合伙的经营期限至 2028 年 2 月 27 日，且目前不存在《合伙协议》中约定的解散、清算情形。

最后，根据封测合伙的合伙人奕斯伟投资和芯屏基金于 2022 年 7 月 18 日出具的书面确认文件：“基于封测合伙的投资结构、合伙协议约定和实际情况，本公司/本企业确认，奕斯伟投资或芯屏基金均不能单独控制封测合伙，封测合伙不存在实际控制人，且双方均不谋求改变封测合伙的控制权现状。”

综上，根据合伙协议约定并经全体合伙人确认，奕斯伟投资和芯屏基金均不控制封测合伙，且该等约定安排具有稳定性。

## 2、该等约定安排符合《合伙企业法》关于有限合伙企业的有关规定

**(1) 封测合伙的《合伙协议》及合伙人相关约定和安排不存在违反《合伙企业法》关于有限合伙企业的有关规定的情形。**

经对照《合伙企业法》关于有限合伙企业的有关规定，封测合伙的《合伙协议》及合伙人相关约定和安排不存在违反《合伙企业法》关于有限合伙企业的有关规定的情形。经核查，封测合伙《合伙协议》的主要条款与《合伙企业法》之规定的具体对照分析如下：

《合伙协议》 条款编号	封测合伙《合伙协议》 条款内容	《合伙企业法》相关规定	对照结果
第十八条	根据封测合伙《合伙协议》的约定，不参加执行事务的合伙人（芯屏基金）有权监督执行事	第二十六条 合伙人对执行合伙事务享有同等的权利；按照合伙协议的约定或者经全体合伙人决定，可以委托一	封测合伙《合伙协议》的约定符合《合伙企业法》的相关规定

《合伙协议》 条款编号	封测合伙《合伙协议》 条款内容	《合伙企业法》相关规定	对照结果
	务的合伙人，检查其执行合伙企业事务的情况。	个或者数个合伙人对外代表合伙企业，执行合伙事务；作为合伙人的法人、其他组织执行合伙事务的，由其委派的代表执行。 第二十七条 依照本法第二十六条第二款规定委托一个或者数个合伙人执行合伙事务的，其他合伙人不再执行合伙事务；不执行合伙事务的合伙人有权监督执行事务合伙人执行合伙事务的情况。	
第二十六条	根据封测合伙《合伙协议》约定，为提高投资决策的专业化程度，控制投资风险，合伙企业设投资决策委员会负责项目的投资和处置进行决策。投资决策委员会成员3人，由普通合伙人委派2人，有限合伙人或其指定主体委派1人。对被投资项目的投资和处置决定，需得到投资决策委员会全体成员一致同意方为有效。	第三十条 合伙人对合伙企业有关事项作出决议，按照合伙协议约定的表决办法办理。合伙协议未约定或者约定不明确的，实行合伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过的表决办法。 本法对合伙企业的表决办法另有规定的，从其规定。 第六十条 有限合伙企业及其合伙人适用本章规定；本章未作规定的，适用本法第二章第一节至第五节关于普通合伙企业及其合伙人的规定。	封测合伙《合伙协议》的约定属于对合伙企业有关事项决议的明确约定，符合《合伙企业法》的相关规定
第二十三条、 第二十四条	有限合伙人不参与合伙企业的管理或以合伙企业的名义开展任何业务、签署任何文件或代表合伙企业行事。 有限合伙人的下列行为不得被认为参与合伙企业的管理： （一）参与决定普通合伙人入伙、退伙； （二）对合伙企业的经营管理提出建议； （三）参与选择承办合伙企业审计业务的会计师事务所； （四）获取经审计的合伙企业财务会计报告及本协议约定的其他信息； （五）对涉及自身利益的情况，查阅合伙企业财务会计账簿等财务资料；	第六十八条 有限合伙人不执行合伙事务，不得对外代表有限合伙企业。 有限合伙人的下列行为，不视为执行合伙事务： （一）参与决定普通合伙人入伙、退伙； （二）对企业的经营管理提出建议； （三）参与选择承办有限合伙企业审计业务的会计师事务所； （四）获取经审计的有限合伙企业财务会计报告； （五）对涉及自身利益的情况，查阅有限合伙企业财务会计账簿等财务资料； （六）在有限合伙企业中的利益受到侵害时，向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼； （七）执行事务合伙人怠于行使权利时，督促其行使权	封测合伙《合伙协议》的约定与《合伙企业法》一致。 《合伙企业法》未明确界定哪些行为属于执行合伙事务，但依据第三十条规定，合伙人按照合伙协议约定对合伙企业有关事项作出决议应不构成执行合伙事务。 芯屏基金作为有限合伙人和主要出资人，委派1名投资决策委员会成员独立参与相关事项的表决，体现了《合伙企业法》第五条规定的自愿、平等和公平原则。该等安排不构成执行合伙事务，芯屏基金

《合伙协议》 条款编号	封测合伙《合伙协议》 条款内容	《合伙企业法》相关规定	对照结果
	(六) 其在合伙企业中的利益受到侵害时，向有责任的合伙人主张权利或者提起诉讼； (七) 在执行事务合伙人怠于行使权利时，督促其行使权利或为了合伙企业的利益以自己的名义提起诉讼； (八) 为合伙企业提供担保； (九) 适用法律明确规定有限合伙人可以从事的其他行为。	利或者为了本企业的利益以自己的名义提起诉讼； (八) 依法为本企业提供担保。	也未对外代表封测合伙。 上述约定符合《合伙企业法》的相关规定。

综上，经对照《合伙企业法》关于有限合伙企业的有关规定，封测合伙的合伙协议及合伙人相关约定和安排不存在违反《合伙企业法》关于有限合伙企业的有关规定的情形。

## (2) 奕斯伟投资作为封测合伙的普通合伙人并非封测合伙的实际控制人不违反《合伙企业法》的相关规定

根据《合伙企业法》第二条之规定，有限合伙企业由普通合伙人和有限合伙人组成，普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。从封测合伙的实际情况而言，其《合伙协议》中关于合伙目的、普通合伙人权限及债务承担等相关约定如下：

《合伙协议》 条款编号	《合伙协议》 条款概述	《合伙协议》条款内容
第六条	合伙目的	合伙目的：发展合肥集成电路封测产业。
第八条	经营范围	经营范围：投资管理、投资咨询。
第十四条	合伙企业债务 偿还约定	全体合伙人确认，合伙企业的债务应先以合伙企业财产偿还，当合伙财产不足以清偿时，有限合伙人以其认缴出资额为限承担有限责任，普通合伙人承担无限责任。
第十七条	普通合伙人为 执行事务合伙 人	执行事务合伙人由全体合伙人共同委托产生。全体合伙人共同委托普通合伙人为执行事务合伙人，执行事务合伙人应委派 1 名自然人代表负责具体执行合伙事务（以下简称“执行事务代表”），其他合伙人不再执行合伙企业事务。
第二十条	执行事务合伙 人的权限	执行事务合伙人的权限包括但不限于： (一) 负责企业日常运营，对外代表合伙企业，执行合伙企业的管理、投资及其他业务； (二) 管理、维持合伙企业的一切资产，包括但不限于投资性资产、非投资性资产、知识产权等；

《合伙协议》 条款编号	《合伙协议》 条款概述	《合伙协议》条款内容
		(三) 采取维持合伙企业合法存续、以有限合伙身份开展经营活动所必需的一切行动； (四) 开立、维持和撤销合伙企业的银行账户，开具支票和其他付款凭证； (五) 为合伙企业的利益决定提起诉讼或应诉，进行仲裁，解决合伙企业与第三方的争议，与争议对方进行协商、和解等，采取所有可能的行动保障合伙企业的财产安全，减少因合伙企业的业务活动而可能对有限合伙人、普通合伙人及其财产带来的风险； (六) 根据中国税收管理规定处理合伙企业的涉税事项； (七) 采取为实现合伙目的、维护或争取合伙企业合法权益所必需的其他行动； (八) 代表合伙企业对外签署文件； (九) 独立决定聘任或者解聘专业人士、中介及顾问机构对合伙企业提供服务，不论前述人士或机构是否是普通合伙人的分支机构、关联企业或者是普通合伙人或其分支机构、关联企业另外雇佣的人或机构； (十) 决定编制合伙企业会计档案或财务报告时所采用的会计处理方法和惯例，决定合伙企业利润分配和亏损分担方案； (十一) 执行合伙企业的解散和清算。
第二十五条	执行事务合伙人对合伙企业进行管理	全体合伙人一致同意，执行事务合伙人即为合伙企业的管理人，根据本协议约定对合伙企业进行管理和运作。
第二十六条	合伙企业设投资决策委员会	为提高投资决策的专业化程度，控制投资风险，合伙企业设投资决策委员会负责对项目的投资和处置进行决策。投资决策委员会成员 3 人，由普通合伙人委派 2 人，有限合伙人或其指定主体委派 1 人。对被投资项目的投资和处置决定，需得到投资决策委员会全体成员一致同意方为有效。

如上表所示，奕斯伟投资作为封测合伙的普通合伙人以及执行事务合伙人对合伙企业进行管理，并依法承担无限连带责任。但封测合伙作为投资合肥顾中控股的股权投资平台，根据《合伙协议》约定，合伙企业设投资决策委员会负责对项目的投资和处置进行决策，对被投资项目的投资和处置决定，需得到投资决策委员会全体成员一致同意方为有效。因此，奕斯伟投资作为封测合伙的普通合伙人并非封测合伙的实际控制人。根据封测合伙的合伙协议约定及全体合伙人一致确认，基于封测合伙的投资结构、合伙协议约定和实际情况，奕斯伟投资或芯屏基金均不能单独控制封测合伙，封测合伙不存在实际控制人。该等约定及安排不违反《合伙企业法》的理由如下：

1、经检索我国现行的《合伙企业法》全文，该等法规并无关于合伙企业如

何认定“控制”或“实际控制人”的明确规定或指引。虽然《合伙企业法》第二条规定，普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任。但另根据《合伙企业法》第三十条之规定，“合伙人对合伙企业有关事项作出决议，按照合伙协议约定的表决办法办理。合伙协议未约定或者约定不明确的，实行合伙人一人一票并经全体合伙人过半数通过的表决办法。”因此，普通合伙人（或执行事务合伙人）并不必然是法定的有限合伙企业的实际控制人。

2、奕斯伟投资虽然作为普通合伙人对外执行合伙事务，但封测合伙除对合肥顾中控股进行股权投资外不进行其他任何生产经营活动，且相关投资资金全部来自于合伙人出资，不存在外部借款或普通合伙人对外担保等其他融资行为。因此，封测合伙对外承担债务的风险较低，且截至目前仅作为合肥顾中控股的股东承担以出资额为限的有限责任。

3、从封测合伙投资决策委员会的决策机制上看，奕斯伟投资除执行合伙事务外，还在投委会表决时享有“一票否决权”，该等权利也实质保障了普通合伙人奕斯伟投资对于投资风险的控制力。

此外，经查询，A股上市公司的案例中亦存在有限合伙企业无实际控制人的情形，具体如下：

公司名称	有限合伙企业系无实际控制人的案例
南网科技 (688248.SH)	股东南网能创股权投资基金（广州）合伙企业（有限合伙）系无实际控制人
润邦股份 (002483.SZ)	出资设立的南通瑞诚环保科技企业（有限合伙）系无实际控制人
中电电机 (603988.SH)	间接股东五矿元鼎股权投资基金（宁波）合伙企业（有限合伙）系无实际控制人
国科军工 (IPO在审)	股东中兵国调（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）系无实际控制人

注：上表中有限合伙企业均仅有一名普通合伙人，上述信息源自相关公司公开披露文件。

综上，封测合伙《合伙协议》的约定以及奕斯伟投资和芯屏基金的相关约定和安排符合《合伙企业法》关于有限合伙企业的有关规定。

(三) 请结合重大投资决策应由双方一致同意、对发行人董事高管提名及日常经营管理等方面, 说明二者是否共同控制发行人

### 1、奕斯伟投资和芯屏基金不存在 IPO 相关规则中认定“共同控制”的情形

首先, 在《<首次公开发行股票并上市管理办法>第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用——证券期货法律适用意见第 1 号》和《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答(二)》(以下简称“IPO 相关规则”)中, 均有关于“共同控制”的明确规定。经对照 IPO 规则中对于“共同控制”的若干规定, 奕斯伟投资和芯屏基金不属于亦不符合规则中认定的“共同控制”的情形。具体情况如下:

法规名称	法规规定	情况说明
《<首次公开发行股票并上市管理办法>第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用——证券期货法律适用意见第 1 号》	认定共同控制应当符合的条件之一为“多人共同拥有公司控制权的情况, 一般应当通过公司章程、协议或者其他安排予以明确, 有关章程、协议及安排必须合法有效、权利义务清晰、责任明确……”	奕斯伟和芯屏基金不存在通过公司章程、协议或者其他安排明确共同控制的情形。
《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答(二)》第 5 项之“(二)共同实际控制人”	法定或约定形成的一致行动关系并不必然导致多人共同拥有公司控制权的情况, 发行人及中介机构不应为扩大履行实际控制人义务的主体责任范围或满足发行条件而作出违背事实的认定。	根据事实情况并经奕斯伟投资和芯屏基金共同书面确认, 奕斯伟投资与芯屏基金不存在关联关系, 不存在一致行动协议、表决权委托、控制关系或委托持股、信托持股等其他约定或利益安排。

其次, 根据封测合伙的《合伙协议》约定: “为提高投资决策的专业化程度, 控制投资风险, 合伙企业设投资决策委员会负责对项目的投资和处置进行决策。投资决策委员会成员 3 人, 由普通合伙人委派 2 人, 有限合伙人或其指定主体委派 1 人。对被投资项目的投资和处置决定, 需得到投资决策委员会全体成员一致同意方为有效。”据此, 在封测合伙投委会的决策机制上, 需得到全体成员一致同意方为有效。基于该等约定, 奕斯伟投资和芯屏基金均具有对封测合伙投资决策委员会议案的“一票否决权”, 但由于奕斯伟投资和芯屏基金委派的投委会成员均系独立发表意见, 且奕斯伟投资和芯屏基金之间不存在一致行动协议, 也未通过公司章程、协议或者其他安排对发行人的经营管理方面进行共同控制。因此, 双方在封测合伙投委会上均拥有“一票否决权”的约定, 并不构成

证监会及交易所相关 IPO 规则中认定的“共同控制”情形。

再次，从出资结构上看，芯屏基金除与奕斯伟投资通过合肥顾中控股间接持有发行人股份外，亦作为直接股东持有发行人股份，而未采取将全部出资均投资于合肥顾中控股从而形成与奕斯伟投资共同出资的情形，该等出资结构进一步验证了芯屏基金作为发行人股东，不与其他股东一致行动或共同控制，并保持独立决策的诉求与意愿。

最后，从出资目的和股东利益看，芯屏基金系合肥市国资委控制的产业投资基金，以带动当地“芯、屏”相关产业集聚及发展为目的，其代表着合肥国资的利益。而奕斯伟集团系基于完善产业链投资尤其是保障自身产品供应链安全的目的投资发行人。由于出资目的和股东利益不同，芯屏基金与奕斯伟投资均独立行使股东权利，不存在共同控制发行人的情形。

综上，奕斯伟投资和芯屏基金不符合 IPO 规则中认定的“共同控制”的情形。双方基于不同的立场和利益独立行使股东权利，双方不存在共同控制发行人的情形。

## **2、奕斯伟投资和芯屏基金均不参与发行人日常经营管理，且各自提名（或委派）的发行人董事之间不存在一致行动协议或安排**

基于发行人董事提名及日常经营管理的实际情况，并经奕斯伟投资和芯屏基金书面确认：

（1）在合肥顾中控股提名（或委派）的董事中，一方面，奕斯伟投资和芯屏基金均不存在单独一方能够任免（或委派）发行人过半数董事的情形；另一方面，除 1 席董事人选授权由合肥顾中控股提名（或委派）苏州顾中总经理担任外，发行人其余董事均由奕斯伟投资和芯屏基金各自独立提名（或委派），亦不存在共同推选或联合提名（或委派）的情形。因此，奕斯伟投资和芯屏基金各自独立提名（或委派）的董事均独立进行表决，不存在一致行动协议或安排。

（2）根据奕斯伟投资和芯屏基金出具的确认函，确认未向发行人及其子公司派驻管理人员和员工，不直接参与顾中科技的日常经营管理，亦不存在对顾中科技重大事项及日常经营管理的特殊安排。因此，虽然合肥顾中控股提名的非独立董事席位中有 1 席为苏州顾中总经理，但苏州顾中自设立以来的总经理

均系创始员工或公司内部培养并经苏州硕中董事会聘任，而后再由合肥硕中控股提名并经发行人股东大会选举为发行人董事。苏州硕中的总经理与合肥硕中控股及其奕斯伟投资、芯屏基金均不存在关联关系。

(3) 发行人已按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律、法规及其他规范性文件的规定制定了符合上市公司治理要求的《公司章程》，建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的公司治理架构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，发行人依照公司有关制度、依靠上述公司治理架构保证公司决策的有效性。

综上，奕斯伟投资和芯屏基金均不参与发行人日常经营管理，不存在对硕中科技重大事项及日常经营管理的特殊安排；且奕斯伟投资和芯屏基金提名（或委派）的董事之间不存在一致行动协议或安排，不存在 IPO 相关规则中认定“共同控制”的情形。

### **3、发行人全体股东均确认发行人无控股股东和实际控制人的事实**

发行人全体股东均已书面确认发行人无控股股东和实际控制人的事实，并认可自 2019 年 1 月 1 日至今发行人无实际控制人的状态未发生变更。

综上，奕斯伟投资和芯屏基金不存在 IPO 相关规则中认定“共同控制”的情形，不存在共同控制硕中科技的情形。

**五、结合前述重要股东自身及关联企业的实际经营业务，分析是否通过无控股股东、无实际控制人认定规避同业竞争监管要求。**

#### **(一) 前述重要股东自身及关联企业的实际经营业务情况**

##### **1、合肥硕中控股**

###### **(1) 合肥硕中控股及对外投资企业**

合肥硕中控股系硕中科技第一大股东，系控股型公司，无其他实际经营业务。合肥硕中控股之控股股东封测合伙与合肥硕中控股类似，也系控股型平台企业，无其他实际经营业务。除发行人外，合肥硕中控股仅对外投资合肥硕材科技有限公司一家企业。合肥硕材科技有限公司主要从事卷带的生产与销售，属于发行人所处行业的上游企业，不构成与发行人经营相同或相似业务的情形。

## (2) 芯屏基金

芯屏基金系封测合伙的有限合伙人，相关情况参见本题回复之“3、芯屏基金”相关内容。

## (3) 奕斯伟投资及相关情况

奕斯伟投资系封测合伙的执行事务合伙人，其控股股东为奕斯伟集团。经奕斯伟集团确认并通过企查查等公开信息查询，截至本补充法律意见书之一出具之日，奕斯伟集团直接或间接控制的企业中经营范围和主营业务与集成电路相关的企业如下：

序号	企业名称	经营范围	实际经营业务
1	北京奕斯伟计算技术股份有限公司	技术开发、技术咨询、技术服务；软件开发；产品设计；贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子元器件、金属材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；设备租赁；委托加工集成电路芯片	芯片设计
1.1	西安奕斯伟集成电路有限公司	集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；软件开发；技术进出口；货物进出口	芯片设计
1.2	成都奕斯伟集成电路有限公司	集成电路技术开发、技术咨询、技术服务；产品设计；经济信息咨询（不含投资咨询）；电子元器件、金属材料（不含稀贵金属）销售；货物及技术进出口；集成电路设备租赁	芯片设计
1.3	成都奕斯伟芯片设计有限公司	集成电路技术开发、技术咨询、技术服务；电子元器件销售；集成电路设备租赁；电子产品软硬件的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；电子产品、集成电路、电子设备、机械设备的批发；货物及技术进出口；社会经济咨询（不含证券、期货、金融类及投资咨询）	芯片设计
1.4	海宁奕斯伟集成电路设计有限公司	集成电路设计；智能卡芯片及电子标签芯片、集成电路技术开发、技术咨询、技术服务；电子产品、集成电路、电子元器件、机电设备租赁、批发；从事各类商品及技术的进出口业务（国家禁止或限制的除外；涉及前置审批的除外）；软件开发	芯片设计
1.5	合肥奕斯伟集成电路有限公司	集成电路技术开发、技术咨询、技术服务；产品设计；经济信息咨询；电子元器件、金属材料销售；自营和代理各类商品和技术进出口（除国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术）；集成电路设备租赁	芯片设计
1.6	南京奕斯伟集成电路有限公司	一般项目：集成电路芯片设计及服务；技术进出口；货物进出口；集成电路芯片及产品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；软件开发	芯片设计
1.7	苏州奕斯伟集成电路设计有限公司	许可项目：货物进出口；技术进出口 一般项目：集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；集成电路销售；电力电子元器件销售；软件开发	芯片设计
1.8	上海奕斯伟集成电路有限公司	一般项目：集成电路芯片设计及服务；从事集成电路科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品销售；电子元器件批发；软件开发；技术进出口；货物进出口	芯片设计

序号	企业名称	经营范围	实际经营业务
1.9	深圳市奕斯伟集成电路有限公司	技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；专业设计服务；贸易经纪；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；金属材料销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电子元器件制造；机械设备租赁；集成电路芯片及产品制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理	技术开发
1.10	北京奕斯伟信息技术有限公司	计算机系统集成、信息系统集成服务；技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；货物进出口、技术进出口	未开展实际经营业务
1.10.1	广州全盛威信息技术有限公司	软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储服务；集成电路设计；信息电子技术服务；计算机信息安全设备制造；计算机信息安全产品设计；网络信息技术推广服务；电子元件及组件制造；电子产品批发；电子元器件零售；电子产品零售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子防伪系统技术开发、技术服务；电子产品检测；电子工程设计服务；电子产品设计服务；电子设备回收技术咨询服务；数据交易服务；数据处理和存储产品设计；监控系统工程安装服务；安全系统监控服务；卫星及共用电视系统工程服务；卫星通信技术研究、开发；计算机网络系统工程服务；计算机房维护服务；计算机技术开发、技术服务；贸易代理；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；商品信息咨询服务；网络技术的研究、开发	软件开发
2	西安埃纳检测技术有限公司	一般项目：半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；专用设备修理；技术进出口；货物进出口；软件开发；软件销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广	半导体设备，拟对外转让
3	西安奕斯伟材料科技有限公司	一般项目：电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业总部管理；企业管理咨询；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；专用设备修理；计算机软硬件及辅助设备批发；电子元器件与机电组件设备销售；机械设备租赁；金属切削加工服务；非居住房地产租赁；软件开发；货物进出口；技术进出口；进出口代理	半导体材料
3.1	西安奕斯伟材料技术有限公司	集成电路用材料的研发、制造、销售、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；商业运营管理（国家有专项规定除外）；货物与技术的进出口经营	半导体材料
3.1.1	西安奕斯伟设备技术有限公司	泛半导体晶体生长及相关设备、泛半导体智能制造装备及相关部件的生产、销售及技术开发、技术咨询、安装、调试、维修、保养；电子电气设备、自动化控制设备的生产、销售与技术服务、安装、调试、维修、保养；计算机控制系统、控制软体的销售与技术服务；货物与技术的进出口经营（国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外）；房屋租赁；设备租赁；技术开发、技术转让、技术咨询	半导体设备
3.1.2	西安奕斯伟硅片技术有限公司	半导体材料的研发、制造、销售；半导体材料、金属材料切削加工、批发；光电晶体材料、半导体器件、光电器件、电子元器件研发、批发；机械设备及零部件、金属材料的批发；半导体技术、光电技术、晶体技术、电子技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；企业管理咨询；商业运营管理；货物及技术的进出口（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）；房屋租赁；设备租赁	半导体材料

如上表所示，并经奕斯伟集团确认，截至本补充法律意见书之一出具之日，奕斯伟集团控股子公司主要从事芯片设计或半导体材料业务，不存在直接或间接从事与发行人业务构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务的情形。

除上表所列公司外，根据公开信息及奕斯伟集团确认，除间接投资硕中科技外，奕斯伟集团还对外投资成都奕斯伟系统技术有限公司（以下简称“成都系统公司”）。成都系统公司拟从事先进封测业务，但该公司生产基地仍处于建设期，尚未实际开展经营活动，且尚未形成主营业务收入。

另根据公开信息整理并经成都系统公司确认，该公司未来所使用的封装技术、封装产品与发行人差异较大，不构成与发行人从事同类业务或存在竞争关系的情形。具体而言：1、在封装技术方面，成都系统公司主要封装形式为面板级扇出封装（Fan-out Panel Level Packaging），属于扇外型封装（Fan-out）的细分领域，目前行业内仅三星、日月光等少数头部企业具备相关能力，尚未规模化应用；而发行人目前主要从事凸块制造、覆晶封装以及扇入型芯片尺寸封装（Fan-In WLCSP），在生产制程、主要机器设备、技术难点等方面与成都系统公司存在较大差异，且发行人尚未从事或规划从事扇外型封装业务；2、在封装产品方面，成都系统公司的面板级扇出封装主要产品以移动终端芯片、高性能异构集成芯片等为主，不含显示驱动芯片。而发行人封装产品主要以显示驱动芯片为主，二者所封装的产品种类各不相同，因而成都系统公司的目标客户群体、市场定位也与发行人存在较大差异。

根据奕斯伟集团于 2022 年 8 月 2 日出具的《确认函》，相关事项确认如下：

“1、截至本确认函出具日，本公司及下属公司实际控制的企业中不存在直接或间接从事与合肥硕中科技股份有限公司（以下简称‘硕中科技’）业务构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务的情形，本公司亦未筹划直接或间接控制集成电路封测企业。

2、截至本确认函出具日，本公司控股子公司主要从事芯片设计或半导体材料业务，未从事集成电路封测业务。

3、截至本确认函出具日，除间接投资硕中科技外，本公司还对外投资成都奕斯伟系统技术有限公司（含下属控股子公司，以下简称“成都系统公司”）。经

成都系统公司决议，本公司持有成都系统公司股权比例计划降至 50% 以内且不控制成都系统公司。

4、成都系统公司拟从事先进封测业务，但该公司生产基地仍处于建设期，尚未实际开展经营，且未形成主营业务收入。除上述对外投资情况外，本公司并未投资其他集成电路封测企业。

5、根据成都系统公司规划，该公司定位于面板级扇出封装（Fan-out Panel Level Packaging），主要产品以移动终端芯片、高性能异构集成芯片等为主，不包括硕中科技主营的显示驱动芯片封测业务。成都系统公司当前及未来生产经营所需的资产、人员、机构和财务等方面都完全独立于硕中科技。

6、综上，截至本确认函出具日，本公司对外投资的成都系统公司拟从事的业务与硕中科技主营业务之间定位不同，在技术、产品、工艺制程、下游应用、客户群体等方面均存在较大差异，不构成与硕中科技从事同类业务或存在竞争关系的情形。”

综上，截至本补充法律意见书之一出具之日，奕斯伟集团控制的企业中未实际从事集成电路封测业务，不存在直接或间接从事与硕中科技业务构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务的情形。

## 2、硕中控股（香港）

虽然发行人与硕中控股（香港）的股东硕邦科技存在从事同类业务的情形，但报告期内，发行人与硕邦科技资产、人员、业务、财务和机构相互独立，硕邦科技作为发行人间接股东，通过委派董事正常参与公司治理，不存在通过股东地位及委派董事导致双方非公平竞争、利益输送、相互让渡商业机会的情形。为防范单方让渡商业机会、不当利益输送和非公平竞争，发行人制定了一系列公司治理制度，对公司重大投资、交易、资金往来的审议和决策程序进行了规定，并制定了研发、采购、生产、销售、人力及财务管理制度，对公司各类业务审批、执行和管理事项进行了规定。报告期内，发行人与硕邦科技从事同类业务不会对发行人构成重大不利影响。

关于公司与硕邦科技之间的独立性详见本回复“问题 2. 关于业务布局及公司独立性”相关内容。

### 3、芯屏基金

截至本补充法律意见书之一出具之日，芯屏基金系合肥建投控股子公司，穿透后芯屏基金的实际控制人为合肥市国资委。

首先，通过启信慧眼、企查查等公开信息查询并经确认，芯屏基金不存在控股子公司。

其次，通过启信慧眼、企查查等公开信息查询以及合肥建投公开披露文件并经确认，合肥建投直接或间接持股比例超过 30%的企业经营范围和主营业务中与集成电路相关的企业如下：

序号	企业名称	经营范围	实际经营业务
1	合肥晶合集成电路股份有限公司	集成电路相关产品、配套产品研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	芯片制造
1-1	南京晶驱集成电路有限公司	一般项目：集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）	晶合集成子公司，未实际经营
1-2	晶芯成（北京）科技有限公司	半导体技术和产品的技术开发、技术服务；销售集成电路、集成电路芯片及产品；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	晶合集成子公司，未实际经营
2	合肥中科微电子创新中心有限公司	一般项目：集成电路销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备零售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	技术开发
3	合肥泽众城市智能科技有限公司	物联网数据收集、分析；通信技术的开发、服务、咨询、推广和成果转让；能源设备及配件、消防设备、安防监控设备、状态监测设备、智能化系统设备、机械设备、仪表仪器、自动化设备的设计、技术服务、销售及安装；计算机软硬件、电子产品、集成电路、通讯设备、特种车辆（除专项许可）的设计、开发、销售及技术服务；计算机网络及应用工程；信息系统集成及运维、电子系统工程、建筑智能化工程、工业安全与消防工程的设计、技术咨询及安装；安全防范工程的设计与安装；信息系统规划、设计与咨询；地理信息测绘；基础设施安全运行监测系统项目投资管理；建设项目代建管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	软件开发

如上表所示，截至本补充法律意见书之一出具之日，合肥建投持股 30%以上的企业中不存在直接或间接从事与硕中科技业务构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务的情形。

再次，根据《公司法》第二百一十六条之规定：“关联关系，是指公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。但是，国家控股的企业之间不仅因为同受国家控股而具有关联关系。”

虽然合肥建投不与合肥国资委控制的其他法人仅因受国有资产监督管理机构控制的原因就因此形成关联关系，但出于谨慎考虑，发行人及中介机构通过启信慧眼、企查查等公开信息网站和合肥国资下属国有企业发行债券的募集说明书等公开披露资料查询，对芯屏基金实际控制人合肥市国资委直接或间接持股比例超过 30% 的其他企业的经营范围和主营业务进行逐一分析确认，其中与集成电路相关的其他企业（不含上表中已列示的）如下：

序号	企业名称	经营范围	实际经营业务
1	合肥长鑫集成电路有限责任公司	一般项目：集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；以自有资金从事投资活动；工程管理服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）	股权投资
2	合肥陆港供应链管理有限公司	一般项目：供应链管理服务；国际货物运输代理；非金属矿及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；金属矿石销售；金属材料销售；日用品销售；化肥销售；计算机软硬件及外围设备制造；集成电路芯片及产品销售；汽车新车销售；汽车零配件零售；集装箱销售；集装箱租赁服务；家用电器销售；信息技术咨询服务；进出口代理；货物进出口；技术进出口；食品进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用百货销售；化妆品零售；办公用品销售；木材销售；国内贸易代理；建筑材料销售；智能机器人销售；电线、电缆经营；农副产品销售；谷物销售；粮食收购；电子产品销售；电子元器件零售；会议及展览服务；工程塑料及合成树脂销售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；煤炭及制品销售；肥料销售；纸制品销售；针纺织品及原料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第三类医疗器械经营；食品销售；燃气经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	供应链管理
3	安徽白帝集团有限公司	供应链管理；房屋租赁；物业管理；企业不良资产并购、代理、重组事务代理；企业管理咨询；电线电缆、消防产品、半导体集成电路及相关产品、计算机软硬件及辅助设备、电子元器件、木材、粮油、饲料、铁矿石、酒具、电器、数码产品、电子产品（不含电子出版物）、通讯设备、机电设备、医疗器材、预包装食品（不含复热）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）、保健食品、酒类、矿产品、煤炭、润滑油、化工产品（不含危险化学品）、塑料制品、有色金属、水泥及水泥预制品、混凝土、沙石、铁精粉、钢材、建材（除专项许	供应链管理

序号	企业名称	经营范围	实际经营业务
		可)、稀土及冶炼分离产品、金属制品、标准件、电力器材、工程机械、电梯、沥青、非金属矿、汽车、二手车销售;黄金、珠宝首饰、海产品、农副产品加工及销售;机油滤清器、柴油滤清器、空气滤清器、燃油滤清器、车用空调滤清器、汽车零部件、轨道交通零部件制造、销售;热镀锌六角螺栓和防盗螺栓生产、销售;电力设备安装、销售;电力工程;再生资源回收(不含固体废物、危险废物、报废汽车等需经相关部门批准的项目);通信工程的投资、建设(以上未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);通信基站设施租赁、维护、保养及运营管理;道路普通货物运输(不含快递、不含危险品);货物或技术进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外);货物配载、装卸;仓储服务(除危险品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	
4	长鑫新桥存储技术有限公司	存储技术服务;集成电路设计、制造、加工、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训及技术检测;电子产品销售并提供售后服务及技术服务;半导体集成电路芯片研发、设计、委托加工、销售;计算机软硬件及网络软硬件产品的设计、开发;计算机软硬件及辅助设备、电子元器件、通讯设备的销售;设备、房屋租赁;产业并购;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	存储芯片设计、制造
5	合肥华登华芯集成电路产业投资合伙企业(有限合伙)	集成电路项目投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、代客理财、融资担保等金融业务);企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	股权投资
6	合肥市山海半导体技术有限公司	一般项目:集成电路芯片设计及服务;集成电路销售;软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;人工智能硬件销售;信息系统集成服务(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)	芯片设计
7	合肥市微电子研究院有限公司	电子和集成电路领域的技术开发、转让、销售、咨询、服务;计算机软硬件开发、销售、技术转让和服务;公共技术平台服务;企业管理、咨询、服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	为合肥市集成电路产业提供公共服务
8	合肥矽迈微电子科技有限公司	半导体及相关产品的研发、生产和销售;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家法律法规限制或禁止的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)	芯片封测

注:上表中企业均系合肥市国资委直接或间接持股比例超过 30%的企业,但并不代表上述企业均系国资委控制或属于国有控股企业。

如上表所示,合肥市国资委直接或间接持股比例超过 30%的企业中,仅合肥矽迈微电子科技有限公司(以下简称“矽迈微电子”)从事芯片封测业务。根据公开信息查询,其产品包括系统级三维模块、Fanout(扇外型),扇外型新型 DFN 封装、新型传感器封装等,与公司封装产品和技术存在差异。此外,经核查矽迈微电子第一大股东合肥兴泰金融控股(集团)有限公司中票发行的募集说明书,截至 2022 年 3 月 31 日,矽迈微电子不属于合肥兴泰金融控股(集团)

有限公司合并报表范围的子公司，因此也不受合肥国资委控制。另根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》之规定：“上市公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织：1. 直接或者间接控制上市公司的自然人、法人或其他组织；……上市公司与本项第 1 目所列法人或其他组织直接或间接控制的法人或其他组织受同一国有资产监督管理机构控制的，不因此而形成关联关系，但该法人或其他组织的法定代表人、总经理、负责人或者半数以上董事兼任上市公司董事、监事或者高级管理人员的除外。”根据公开信息查询，硕中科技与矽迈微电子及其股东合肥兴泰金融控股（集团）有限公司的董事、监事、高级管理人员不存在任何重叠，故硕中科技与矽迈微电子、合肥兴泰金融控股（集团）有限公司不存在关联关系。

因此，截至本补充法律意见书之一出具之日，合肥国资委直接或间接持股 30% 以上的企业中不存在直接或间接从事与硕中科技业务构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务的情形。

综上所述，公司第一大股东合肥硕中控股及其对外投资企业、第一大股东合肥硕中控股之控股股东封测合伙、封测合伙之合伙人奕斯伟投资及实际控制的企业、封测合伙之合伙人（即公司第三大股东）芯屏基金及其控制方合肥建投与合肥国资委直接或间接持股比例超过 30% 的企业中，均不存在直接或间接从事与硕中科技业务构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务的情形。

## **（二）是否通过无控股股东、无实际控制人认定规避同业竞争监管要求**

根据《审核问答（二）》的相关规定及本题回复之前文所述，硕中科技无控股股东和实际控制人系“结合发行人的股权结构、公司治理与实际经营情况，本着实事求是的原则，尊重企业的实际情况，经发行人自身认定，并经发行人全体股东确认”的事实情况，且公司第一大股东合肥硕中控股及其对外投资企业、第一大股东合肥硕中控股之控股股东封测合伙、封测合伙之合伙人奕斯伟投资及实际控制的企业、封测合伙之合伙人（即公司第三大股东）芯屏基金及其控制方合肥建投与合肥国资委直接或间接持股比例超过 30% 的企业中，均不存在直接或间接从事与硕中科技业务构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务的情形。因此，发行人不存在通过无控股股东、无实际控制人认定规避同业竞争监管要求的情形。

## 【核查情况】

### 一、核查程序

针对上述事项，本所律师履行了以下核查程序：

- 1、取得发行人及主要股东出具的说明及书面确认；
- 2、查阅发行人的工商档案材料，历次增资和股权转让所签署的相关协议、股权转让和增资的价款支付凭证；
- 3、查阅发行人的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等内部治理制度文件；
- 4、根据公开渠道查询发行人主要股东的股权结构和对外投资情况，查阅合肥颀中控股的《公司章程》和封测合伙的《合伙协议》，取得奕斯伟集团出具的《确认函》；
- 5、通过启信慧眼、企查查等公开信息网站以及相关信息公开披露文件查询主要股东对外投资企业，逐一分析其中与集成电路相关企业的经营范围和主营业务情况，并取得主要股东对相关事项的确认，核查是否存在主要股东及其关联企业及发行人的业务构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务的情形；
- 6、查阅《公司法》《合伙企业法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》《上市公司收购管理办法》《〈首次公开发行股票并上市管理办法〉第十二条“实际控制人没有发生变更”的理解和适用——证券期货法律适用意见第1号》等法规。

### 二、核查意见

经核查，本所认为：

- 1、发行人已按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41号——科创板公司招股说明书》第41条的规定在招股说明书中对持有发行人5%以上股份的股东进行补充披露；
- 2、合肥颀中控股相关股权结构设置主要考虑未来如引入其他社会资本，可在合肥颀中控股层面持股，并依据《公司法》和《公司章程》参与公司治理，

进而有助于保持封测合伙层面相关决策机制的稳定；

3、 颀中科技的前身封测有限公司 2018 年初设立，随后颀邦科技通过转让公司的控制权并引进其他投资者，使发行人股东结构实现了多元化。合肥市国资委、奕斯伟集团在入股发行人之前后，均未参与发行人及子公司苏州颀中的日常运营管理。2018 年，奕斯伟投资与芯屏基金通过对发行人的投资和增资，为发行人的业务发展和产能扩张提供了宝贵的资金支持，同时也为发行人在合肥当地投资建厂，并充分发挥产业链上下游协同效应创造了有利条件。报告期内，发行人直接或间接股东奕斯伟投资、芯屏基金和颀邦科技均依据公司章程行使股东权利，并通过委派或提名董事的方式参与公司重大事项的决策；

4、 合肥颀中控股不是发行人的控股股东，发行人无控股股东和实际控制人的控制权状态已经全体股东一致确认；

5、 基于主观投资目的及前述历史原因导致的出资主体变更，芯屏基金既直接持有发行人股份又通过合肥颀中控股持股具有合理性。合肥市国资委不存在对发行人重大事项及日常经营管理的特殊安排，依其所享有的表决权不足以对公司股东大会的决议产生决定性影响，不存在实质控制发行人的情形；

6、 芯屏基金和奕斯伟投资不构成《上市公司收购管理办法》第 83 条规定的一致行动关系，不存在共同控制发行人的情形；

7、 根据封测合伙现行有效的《合伙协议》约定以及实际经营情况，并经全体合伙人确认，奕斯伟投资和芯屏基金均不控制封测合伙，封测合伙无实际控制人。封测合伙的合伙协议及合伙人相关约定和安排不存在违反《合伙企业法》关于有限合伙企业的有关规定的情形；

8、 发行人不存在通过无控股股东、无实际控制人认定规避同业竞争监管要求的情形。

## **问题 2. 关于业务布局及公司独立性**

根据申报材料：（1）发行人主要生产经营主体苏州颀中在并入发行人前曾为第二大股东颀邦科技在境内的全资子公司，公司高管、核心技术人员均来自于苏州颀中，且公司 29 项发明专利中有 21 项是苏州颀中在并入发行人体前申请的；（2）颀邦科技为全球最大规模的显示驱动芯片封装测试代工厂；（3）

2019-2021年，发行人外销收入占比分别为86.49%、83.83%、66.85%。公司主要客户、供应商与顾邦科技存在重叠，原因主要为上下游市场集中度较高，但申报材料对有关交易价格的公允性论述不够充分。

请发行人说明：（1）顾邦科技的主营业务、核心技术、下游应用领域、客户供应商构成等，公司未来业务发展战略、产品线布局、市场拓展安排等情况，与顾邦科技是否存在相同或相似业务，二者是否存在业务及销售区域的划分约定，并结合前述情况分析是否对公司未来业务发展产生限制或不利影响；（2）顾邦科技在发行人成立后是否提供技术指导支持，是否仍实际控制公司管理层并主导公司的生产经营与技术研发，发行人在业务、技术、人员、资产、采购及销售渠道、资金等方面是否存在对顾邦科技的依赖；（3）发行人与顾邦科技重叠客户、供应商的情况，相关采购、收入金额及占比，涉及的产品及工艺流程，并结合公司产业链上下游的市场集中度情况，分析重叠客户及供应商的合理性，并说明公司与相关重叠客户、供应商交易价格的公允性；（4）报告期内，子公司苏州顾中的经营情况及占母公司业绩的比重，母子公司之间的分工定位、业务布局、产线安排，发行人能否实现对子公司的有效管理及协同发展。

请保荐机构、发行人律师对上述事项核查，说明核查手段、核查方式并发表明确意见。

回复：

### 【发行人说明】

一、顾邦科技的主营业务、核心技术、下游应用领域、客户供应商构成等，公司未来业务发展战略、产品线布局、市场拓展安排等情况，与顾邦科技是否存在相同或相似业务，二者是否存在业务及销售区域的划分约定，并结合前述情况分析是否对公司未来业务发展产生限制或不利影响

（一）顾邦科技的主营业务、核心技术、下游应用领域、客户供应商构成等

#### 1、主营业务

根据公开资料，顾邦科技成立于1997年，最初以金凸块制造为起点，一方面通过内涵式发展将业务拓展至其他金属凸块制造以及后段封装领域，另一方

面通过一系列的外延式并购，不断扩大主营业务范围和经营规模。2004 年以来，其相继并购了华宸科技（2004 年）、华旻电子（2006 年）、飞信半导体（2009 年）、欣宝电子（2013 年）等显示驱动芯片封测相关企业，并与华泰电子（2020 年）、联华电子（2021 年）等集成电路知名企业通过换股进行战略合作，通过多年的发展，与南茂科技在显示驱动芯片封测领域形成双寡头的竞争格局。

截至目前，颀邦科技的主营业务包括金凸块、无铅/锡铅焊锡凸块、铜柱无铅焊锡凸块等凸块的制造销售，并可提供晶圆线路测试（CP）、后段卷带式软板封装（TCP）、薄膜覆晶封装（COF）、玻璃覆晶封装（COG）/柔性屏幕覆晶封装（COP）、晶圆级芯片尺寸封装（WLCSP）、扇出型系统级封装（FOSiP）、覆晶系统级封装（FCSiP）等服务，同时提供卷带式封装载板（Tape）、Tray 盘等封装材料的制造销售。

报告期内，颀邦科技分产品收入构成如下：

单位：新台币千元

项目	2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
凸块	6,787,382	25.06%	5,709,945	25.63%	4,373,800	21.42%
封装及测试	20,294,658	74.94%	16,565,339	74.37%	16,045,692	78.58%
合计	<b>27,082,040</b>	<b>100.00%</b>	<b>22,275,284</b>	<b>100.00%</b>	<b>20,419,492</b>	<b>100.00%</b>

注：以上数据来源于颀邦科技年度报告。

## 2、核心技术

根据颀邦科技披露的公开资料，颀邦科技的主要核心技术包括：

序号	核心技术名称
1	无氰化物金电镀制程技术
2	Polyimide 制程技术
3	TCP 封装技术在微机电产品之应用
4	覆晶 COF（Chip on film）制程技术
5	干膜（Dry film）在微影制程技术
6	LED 封装技术（AuSn）
7	背金属（BSM）制程技术
8	铜柱凸块（Cu bump）技术
9	厚铜线路（Cu RDL）技术

序号	核心技术名称
10	晶圆级封装（WLCSP）之 Tape & Reel 技术开发
11	高熔点无铅凸块技术之应用开发
12	化合物半导体之凸块与 Tape and Reel 技术
13	扇出型系统级封装（FOSiP）技术
14	覆晶系统级封装（FCSiP）技术

注：以上信息来自顾邦科技年度报告。

### 3、下游应用领域

根据顾邦科技年报，其封测产品主要应用于智能型携带装置（如：智能手机、平板计算机、4K/8K 视讯）内的 LCD/OLED 面板驱动 IC、功率放大器、射频 IC、滤波器、电源管理 IC 及功率晶体管等各类半导体组件。根据顾邦科技业绩说明会等公开披露信息，其显示类业务收入占比 75% 左右。

### 4、客户供应商构成

#### (1) 客户构成

报告期内，顾邦科技客户主要来自中国台湾、欧美及日韩等，来自于中国大陆的客户收入金额及占比较低。具体构成如下：

单位：新台币千元

项目	2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
中国台湾	17,057,245	62.98%	12,341,594	55.40%	10,655,033	52.18%
美国	5,941,320	21.94%	5,441,000	24.43%	6,054,059	29.65%
其他	4,083,475	15.08%	4,492,690	20.16%	5,154,914	25.24%
合计	<b>27,082,040</b>	<b>100.00%</b>	<b>22,275,284</b>	<b>100.00%</b>	<b>20,419,492</b>	<b>100.00%</b>

注：以上信息来自顾邦科技年度报告。

报告期各期，顾邦科技连续两年中任一年度收入占比超过 10% 的客户如下：

单位：新台币千元

2021 年度			
排名	客户名称	销售金额	占营业收入比例
1	甲客户	4,953,626	18.29%

2	丙客户	3,352,266	12.38%
3	乙客户	3,092,284	11.42%
4	丁客户	1,079,050	3.98%
合计		<b>12,477,226</b>	<b>46.07%</b>
<b>2020 年度</b>			
排名	客户名称	销售金额	占营业收入比例
1	甲客户	3,922,462	17.61%
2	丙客户	2,336,326	10.49%
3	乙客户	2,187,482	9.82%
4	丁客户	2,118,888	9.51%
合计		<b>10,565,158</b>	<b>47.43%</b>
<b>2019 年度</b>			
排名	客户名称	销售金额	占营业收入比例
1	甲客户	3,936,896	19.28%
2	丁客户	3,164,244	15.50%
3	乙客户	2,262,326	11.08%
4	丙客户	1,431,776	7.01%
合计		<b>10,795,242</b>	<b>52.87%</b>

注：以上信息来自顾邦科技年度报告。

## (2) 供应商构成

报告期各期，顾邦科技采购金额占比超过 10% 的供应商情况如下：

单位：新台币千元

<b>2021 年度</b>			
排名	供应商名称	采购金额	占采购总额比例
1	甲公司	3,397,059	46.79%
合计		<b>3,397,059</b>	<b>46.79%</b>
<b>2020 年度</b>			
排名	供应商名称	采购金额	占采购总额比例
1	甲公司	2,851,898	47.69%
合计		<b>2,851,898</b>	<b>47.69%</b>
<b>2019 年度</b>			
排名	供应商名称	采购金额	占采购总额比例

1	甲公司	1,213,851	29.00%
合计		<b>1,213,851</b>	<b>29.00%</b>

注：以上信息来自顾邦科技年度报告。

## （二）公司未来业务发展战略、产品线布局、市场拓展安排等情况

公司长期专注于显示驱动芯片的封装与测试，目前已发展成为中国境内规模最大的显示驱动芯片封装测试企业，并将业务拓展至电源管理芯片、射频前端芯片等非显示类封测领域。

根据公司现有业务发展情况，结合中国大陆显示产业链及集成电路行业发展特征，公司对未来业务发展战略、产品线布局、市场拓展安排等情况如下：

项目	具体内容
显示业务	1、加强布局 12 吋晶圆的显示驱动芯片封测业务，扩充相关产能； 2、对 AMOLED、Mini LED、Micro LED、AR/VR 涉及的新型屏幕以及 TDDI、FTDDI 等新型芯片产品研发布局。
非显示业务	1、扩大 12 吋晶圆产品封测业务； 2、不断实现电源管理芯片、射频前端芯片、MCU、MEMS 等芯片先进封测业务的导入和量产； 3、发展基于第二代、第三代半导体材料的凸块制造与封测业务。
市场拓展	1、深化与现有客户的紧密合作； 2、丰富收入来源，扩大客户群体。

（三）与顾邦科技是否存在相同或相似业务，二者是否存在业务及销售区域的划分约定，并结合前述情况分析是否对公司未来业务发展产生限制或不利影响

### 1、公司与顾邦科技业务的比较情况

报告期内，公司与顾邦科技在业务方面的差异情况如下：

项目	发行人	顾邦科技	差异情况
业务发展历程	主要依靠自主发展。即通过内部培养、引进本土人才等方式进行技术的积累和业务拓展	自主发展和外延并购并举。历史上相继并购了中国台湾的华宸科技、华昶电子、飞信半导体、欣宝电子等业内知名企业，并通过换股与华泰电子、联华电子等上下游企业进行战略合作	公司以自主发展为主，顾邦除自主发展外，还通过收购兼并较多业内企业、与上下游企业换股进行战略合作等方式外延式发展
封装技术	显示驱动芯片	金凸块制造、晶圆测试、薄膜覆晶封装（COF）、玻璃覆晶封装（COG）/柔性	1、两者均提供显示驱动芯片封测服务，但由于研发、

项目	发行人	颀邦科技	差异情况
封测	屏幕覆晶封装（COP）；除前述封装技术外，颀邦科技还开展卷带式软板封装（TCP）		生产彼此独立，且客户群体及产品型号也不完全相同，因此在部分工艺技术、原材料选择、制程能力、核心技术等方面存在较大差异； 2、发行人未开展 TCP 封装业务。
非显示类芯片封测	铜柱凸块、铜镍金凸块、锡凸块、晶圆测试、DPS 封装	无铅/锡铅焊锡凸块、铜柱无铅焊锡凸块、晶圆级芯片尺寸封装、晶圆测试、扇外型系统级封装（FOSiP）、覆晶系统级封装（FCSiP）	1、部分凸块使用材料不同，如公司均使用无铅凸块； 2、部分凸块制造工艺不同，如在黄光（光刻）环节，公司均采用湿膜（光刻胶）技术，颀邦科技则以干膜技术为主； 3、在测试环节，由于客户群体、产品种类具有较大差异，公司以国产化机台为主，颀邦科技则以日本及欧美测试机台为主，所使用的探针台、测试程式、探针卡等均不相同； 4、颀邦科技具备扇外型系统级封装（FOSiP）、覆晶系统级封装（FCSiP）等先进封装技术，公司尚未计划发展相关业务。
封装产品	显示驱动芯片封测	LCD、AMOLED 显示驱动芯片封测	1、收入占比不同，公司显示驱动芯片封测收入占比较高，报告期内超过 90%，而颀邦科技仅为 75%左右； 2、客户及产品结构不同，颀邦科技 AMOLED 封装收入占比相对更高，公司报告期内独立拓展新客户、新产品，AMOLED 封装收入持续提升； 3、颀邦科技具有卷带、Tray 盘的研发、生产和销售，且收入占比较高，而公司尚未计划发展相关业务。
	非显示类芯片封测	电源管理芯片、射频前端芯片为主，少部分为 MCU、MEMS 等产品	1、公司封测产品以电源管理产品和射频前端芯片为主（报告期各期占比超过 97%），而颀邦科技封测产品则以功率放大器、射频 IC 等为主； 2、由于客户群体、产品型号不同，发行人非显示类业务目前以 8 吋为主（占比超过 99%），于 2021 年形成 12 吋产品全制程能力，而颀邦科技

项目	发行人	颀邦科技	差异情况
			12 吋产品收入占比相对更高。
销售区域及客户结构	显示驱动芯片封测	以中国台湾、中国大陆客户为主	受益于显示产业链转移的大趋势，公司来自中国大陆客户收入占比逐年提升（2021 年接近 30%），而颀邦科技以中国台湾、美国及日韩客户为主，来自中国大陆的客户收入占比极低。
	非显示类芯片封测	以中国大陆客户为主	公司主要客户为中国大陆 IC 设计厂商（报告期各期收入占比超过 95%），而颀邦科技则以中国台湾、美国及日韩客户为主，中国大陆客户占比极低。

注：颀邦科技相关信息均来自于年度报告、业绩说明会等公开渠道。

虽然公司与颀邦科技存在从事相似业务的情形，但在业务发展历程、封装技术、封装产品、销售区域及客户结构等方面均有所差异，且彼此在资产、人员、业务、财务和机构等方面保持独立。

此外，根据颀中控股（香港）及其控股股东颀邦科技出具的《关于保持业务独立性的承诺函》，颀邦科技保证不在中国大陆设立其他企业或投资于颀中科技以外的其他企业以生产或销售与颀中科技相同或相似的产品。

## 2、公司与颀邦科技不存在业务及销售区域的划分约定

由于区位优势、技术特点等方面的不同，且公司与颀邦科技业务相互独立，因此，双方在业务构成、销售区域、客户群体等方面存在差异，且该等差异系基于行业特点及各自业务独立发展所形成的客观结果，不存在任何业务及销售区域划分的主观约定。

一般而言，IC 设计公司在选择封测厂商时，会基于运输成本（上游晶圆制造厂、下游面板厂或模组厂的地理位置）、下游客户要求（封测厂商往往需要通过面板厂商乃至终端品牌厂商的验证）以及封测厂商的封装能力、技术特点、产能情况等因素综合选择供应商。

就显示类业务而言，在显示产业链不断向中国大陆转移的趋势下，中国大陆 IC 设计公司日益崛起，上游晶圆制造厂商产能持续扩充，叠加大陆面板厂逐渐树立全球领先地位，意味着显示驱动芯片从设计、制造、封测到下游面板厂组装、终端应用本土化趋势越来越明显。同时，贸易摩擦使得各大 IC 设计厂商

本土化意愿更加强烈，部分境外 IC 设计客户也将越来越多的芯片制造、封测转移至中国大陆，以服务其下游客户。在此背景下，公司来自中国大陆 IC 设计客户收入不断提升。而位于中国台湾的硕邦科技，依托于当地强大的 IC 设计公司、晶圆制造、显示产业链等有利因素，主要客户以中国台湾、美国以及日韩 IC 设计公司为主，境内客户占比极低。

在非显示类业务领域，公司选择布局该领域主要是由于中国大陆具备多类金属凸块量产的封测企业较少，且中国大陆电源管理及射频前端芯片行业正处于传统封装向先进封装演变的过程中。随着矽力杰、杰华特、艾为电子、唯捷创芯、希荻微等中国大陆相关 IC 设计企业能力不断提升，公司采取以境内客户为主的市场开发策略，报告期各期来自境内客户的收入占比超过 95%。而硕邦科技在后段封装方面具备 Fan-out、SiP 等多种先进封装能力，产品结构也有较大不同，因此其客户群体和收入结构上与公司存在较大差异。

因此，由于该等行业和既有的产业链上下游特点，以及所处地理位置不同所面对境内外市场环境差异，作为该领域的市场参与者，公司和硕邦科技之间客观上不存在业务及销售区域划分的外部基础，主观上均会独立地结合自身竞争优势寻求对各自发展更为有利的业务路径及销售区域。

### **3、不会对公司未来业务发展产生限制或不利影响**

#### **(1) 发行人业务发展与硕邦科技保持独立**

发行人自 2018 年成立之日起，即与硕邦科技在资产、人员、业务、财务和机构等方面均彼此独立。硕邦科技作为发行人间接股东，通过委派或提名董事正常参与公司治理，不存在通过股东地位及委派或提名董事导致双方非公平竞争、利益输送、相互让渡商业机会的情形。为防范单方让渡商业机会、不当利益输送和非公平竞争，发行人制定了一系列公司治理制度，对公司重大投资、交易、资金往来的审议和决策程序进行了规定，并制定了研发、采购、生产、销售、人力及财务管理制度，对公司各类业务审批、执行和管理事项进行了规定。

此外，硕邦科技委派或提名一名董事亦不会对发行人未来业务发展产生不利影响。首先，根据《公司法》规定，董事对公司负有忠实义务和勤勉义务，

其中包括不得擅自披露公司秘密等，其违反相关义务所得的收入应当归公司所有，且需对给公司造成的损失承担赔偿责任；其次，顾邦科技已承诺不会利用股东表决权和董事会席位等谋求不正当利益，相关承诺内容参见本题回复之“二/（二）/7、发行人主要股东顾中控股（香港）及其控股股东顾邦科技已出具《关于保持业务独立性的承诺函》”相关内容；最后，本次公开发行后，顾邦科技将通过顾中控股（香港）持有发行人 25.43% 的股份，因此发行人未来业务的健康发展亦将有助于顾邦科技获得更高的投资回报，符合其股东利益。

## （2）发行人具备一定的比较优势

公司深耕集成电路先进封测领域多年。近年来随着中国大陆集成电路设计企业及下游面板厂商占比的不断提升，公司不断完善本土化客户服务团队，使得在地域上更贴近客户及下游企业，能够更全面、更迅速地提供方案及技术支持，可实时对客户及下游企业的需求做出快速响应，并针对问题及时制定相应解决方案。同时，在技术研发方面，公司通过招募及培养优秀的本土化人才，针对客户的特定需求进行定制化的研发活动，并取得了较多研发成果，如在大版面覆晶封装技术、凸块多层堆叠结构以及相关特色工艺等方面，处于行业领先水平。

综上，虽然公司与顾邦科技从事相似业务，但发行人业务独立发展，并在客户响应、技术研发等方面建立了比较优势，上述事项不会对公司未来业务发展产生限制或不利影响。

**二、顾邦科技在发行人成立后是否提供技术指导支持，是否仍实际控制公司管理层并主导公司的生产经营与技术研发，发行人在业务、技术、人员、资产、采购及销售渠道、资金等方面是否存在对顾邦科技的依赖**

**（一）顾邦科技在发行人成立后是否提供技术指导支持，是否仍实际控制公司管理层并主导公司的生产经营与技术研发**

### 1、创立初期及成长阶段（2004 年-2010 年）

2004 年，顾邦科技看好中国大陆电子产业发展并基于显示产业链向中国大陆转移的大趋势，在集成电路产业配套相对完善的苏州工业园区设立苏州顾中，定位于显示驱动芯片的先进封装测试业务。

成立之初，苏州硕中一方面通过购进先进的封装设备，另一方面在早期来自硕邦科技的少部分高级管理人员及技术人员带领下，通过本土人才的引进和培养，快速实现了金凸块及后段 COF 封装规模化生产能力，并自行建立了相对独立的生产、研发体系。

在此阶段，苏州硕中的经营管理和技术研发团队不断建立和完善，重大事项主要由硕邦科技进行决策和主导。

## **2、成熟及独立发展阶段（2011年-2017年）**

2011 年以来，苏州硕中抓住金融危机后经济复苏以及电子产业向中国大陆不断转移的机遇，不断完善制程能力，在此后的两年内先后完成晶圆测试（CP）、研磨切割、玻璃覆晶封装制程（COG）的建置，并于 2013 年形成了 8 吋显示驱动芯片的全制程能力。此后，苏州硕中一方面加大显示驱动芯片封测产能扩充力度，另一方面于 2015 年开始布局非显示类封测业务。

随着苏州硕中经营团队日益成熟，本土化人才不断涌现并在公司各主要部门担任要职，具有硕邦科技背景的管理及技术研发人员则逐渐减少。硕邦科技从管理半径、资源及资金投入以及所处地理位置等因素考量，参与苏州硕中日常经营决策的频率日渐降低。到 2017 年左右，除按照章程约定需由股东或董事会决策的事项外，与日常经营活动有关的事项均由苏州硕中的管理团队决策并执行。

在此阶段，苏州硕中经营团队日益成熟，并形成独立的研发体系和研发团队，研发人员主要来自内部培养，经营及研发活动已转为自身主导，硕邦科技参与苏州硕中日常经营决策的频率日渐降低。

## **3、硕中科技（发行人）成立至今（2018年至今）**

2018 年，硕中科技成立，通过收购苏州硕中并引入战略投资者，进一步充实了自身发展所需的资金和资源。公司充分利用股东投入资本，迅速扩大生产规模，当年二期无尘室厂房（Fab2）建成完毕，标志着公司已具备 12 吋显示驱动芯片的全制程封测量产能力。在非显示类封测领域，公司在不断丰富凸块制造种类的基础上，于 2019 年自主建立完成后段 DPS 封装业务，标志着公司已具备扇入型晶圆级芯片尺寸封装（Fan-in WLCSP）的全制程能力。2018 年以来，

公司自主研发了多项核心技术，覆盖了先进封测的诸多关键环节。

在此阶段，硕邦科技除作为发行人间接股东通过委派董事正常参与公司治理、行使股东表决权外，不存在任何直接或间接参与公司经营管理、技术研发的情况。

综上所述，发行人成立前，苏州硕中日常的经营管理及技术研发已较为独立；在发行人成立后，公司与硕邦科技彼此独立发展，除通过委派董事正常参与公司治理、行使股东表决权外，硕邦科技不存在任何影响公司日常经营管理的情况，也不存在向公司提供任何技术指导支持的情况。

## （二）发行人在业务、技术、人员、资产、采购及销售渠道、资金等方面是否存在对硕邦科技的依赖

经过多年发展，公司在业务、技术、人员、资产、采购及销售渠道、资金等方面均独立于硕邦科技，不存在对硕邦科技的依赖。具体情况如下：

### 1、业务独立

报告期内，发行人与硕邦科技之间业务发展完全独立，不存在依赖硕邦科技开展业务的情况。

如本题第（一）部分所述，从业务发展历程上来看，苏州硕中于 2004 年设立，主要通过内部人才培养和引进生产设备，逐渐建立完善了 8 吋显示驱动芯片封测全制程业务，并且与硕邦科技之间的业务独立性不断提高。在 2018 年发行人成立之后，发行人基于自身所处的市场环境、发展阶段、行业发展趋势、技术演变过程等方面独立开展业务，与硕邦科技之间完全独立。发行人业务的主要发展历程及背景如下：

时间	事件	背景
2004 年	苏州硕中成立	硕邦科技看好显示产业链向中国大陆转移的趋势，并且苏州工业园区相关上下游企业配套完善
2005 年	1、在部分来自硕邦科技人员的带领下，通过内部人才培养、设备引进，快速形成金凸块量产能力； 2、COF 产线建成并发展相关封装技术	1、苏州当地集成电路相关企业较多，当时聚集了较多相关人才； 2、金凸块及 COF 工艺难度较大，当时具备相关能力的大陆厂商相对较少，且随着大陆面板厂的发展，出现大量显示驱动芯片封装需求，因此选择金凸块及 COF 作为切入点

时间	事件	背景
2008年	Fab1投入使用，金凸块、COF产能大幅提升	随着业务的快速发展，原租赁物业无法满足需求，从而建立自有无尘厂房
2013年	1、逐渐建立CP、COG等制程； 2、具备8吋产品全制程封测能力	针对客户全制程的需求，引进核心设备以及本地专业人才，独立完成研磨切割及COG等工艺制程的建设
2015年	开始布局非显示类业务	基于技术积累、中国大陆市场需求等考虑，进入该领域
2018年	1、硕中科技成立； 2、Fab2建成，具备12吋全制程量产能力	1、显示产业链及集成电路行业向大陆转移趋势日益明显； 2、优化股权结构，引入战略投资者，提供发展所需资金； 3、顺应显示驱动芯片向12吋转移的趋势，建立全制程封测产线
2019年	完成DPS建设，具备Fan-in WLCSP全制程能力	扩大后段封装种类，满足非显客户全制程需求，丰富产品种类
2021年	1、收入规模快速增长，突破13亿； 2、非显示类封测业务收入规模及占比持续攀升	受益于中国大陆出台多项利好政策、显示产业链加速转移、集成电路较高景气程度等有利因素，公司业绩快速增长，继续保持细分领域领先地位的同时，产品结构得到进一步优化

## 2、技术独立

### (1) 发行人具有独立的研发体系和研发团队

在外资控股期间，苏州硕中已形成了较为独立的研发体系和研发团队，并可自主从事研发活动。截至2021年末，公司已取得55项授权专利，其中发明专利29项、实用新型专利26项，上述专利申请日期均在2011年之后；且2011-2017年期间，公司所申请的21项已授权发明专利中，发明人均均为苏州硕中当时的在职员工，其中仅有1项专利的一名发明人拥有硕邦科技从业背景，其他发明人全部来自苏州硕中内部培养，无任何硕邦科技的从业经历。此外，截至2022年7月31日，公司已授权的发明专利36项，实用新型专利38项，申请中的发明专利29项，实用新型专利7项，较2021年末公司新增了多项专利。

2018年成为中外合资企业后，发行人独立性进一步提高，自主进行各项技术研发活动并申请相关专利保护，与硕邦科技之间保持完全独立，不存在任何合作研发、技术交流、共用技术研发人员等情况，亦不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷。

截至2021年末，发行人共有技术研发人员207名，均为大陆籍员工且无硕

邦科技工作经历，主要来自内部培养。

## **(2) 发行人独立完成相关核心技术的研发**

发行人的核心技术均是基于市场需求、技术发展、行业趋势等因素自主研发产生的成果，具有特定的形成背景和发展过程，发行人通过自行申请专利予以保护。

公司目前产品所涉及的核心技术均来自自主研发，绝大部分形成于 2011 年之后，并且以 2018 年发行人设立之后为主。具体而言，2018 年成为中外合资企业后，发行人与颀邦科技技术研发完全独立，一方面对已形成的核心技术进行持续优化和升级，保持技术先进性的同时提升相关技术的产业化程度，以满足下游客户日益增长的需要；另一方面完全自主研发出“光阻气泡解决技术”、“微细间距金凸块高可靠性制造技术”、“高精度高密度内引脚接合技术”、“125mm 大版面覆晶封装技术”、“高稳定性晶圆研磨切割技术”、“真空落球技术”、“小尺寸高密度焊锡凸块技术”等多项核心技术，涉及凸块制造、后段封装等多个环节，技术水平和适用范围进一步提升。

公司各项核心技术形成背景、发展过程及技术来源情况具体如下：

分类	工艺	核心技术	形成发展过程	核心技术来源及形成阶段
凸块制造技术	金凸块	微细间距金凸块高可靠性制造技术	<p>随着显示技术迭代更新，更高的分辨率与刷新率成为市场热点，相应地驱动芯片中凸块数量大幅增加，凸块间距愈来愈小，随之而来的问题是如何在满足微细间距的前提下保持，甚至进一步提升金凸块的可靠性。</p> <p>基于以上背景，公司于2006年起，不断研究并优化金凸块工艺技术，通过调整烘箱参数、增加紫外光照射等方式，开发出一整套防凸块短接技术；2018年后，公司通过对光刻胶涂布机台管路的设计以及涂布结构单元的设计，提高了光刻胶预制图形的可靠性，并通过调整刻蚀工艺参数、韧化机台构造与参数等，进一步加强了金凸块的可靠性。</p> <p>基于研发成果，公司目前已取得 3 件相关专利。</p>	苏州硕中创立初期即建立了金凸块制程，并具备当时领先的凸块制造能力，但原有技术已不能满足对凸块间距越来越小的需求，该技术后续的优化及升级（如微细间距等）主要由公司在2018年之后独立完成。
		大尺寸高平坦化电镀技术	<p>随着显示技术发展，TDDI 驱动芯片集成显示驱动与触控逐渐成为市场主流。伴随高集成度芯片需求，对晶圆尺寸及线宽制程要求越来越高，对大尺寸晶圆上金凸块平坦化的要求进一步提高。</p> <p>基于以上背景，公司于2017年开始不断研究大尺寸芯片高平坦化电镀技术，通过对阳极阴极的技术改造、改变等电位平面、改善低电流区域的电流分布，并对电镀夹具进行研究、重新设计及持续改造，不断改进夹具导通均匀性，提升了大尺寸晶圆凸块的平坦化水准。</p> <p>基于研发成果，公司目前已取得 3 件相关专利。</p>	2017年开始研发，由公司独立完成。
	铜柱凸块	高厚度光阻涂布技术	<p>铜柱凸块高度一般在 50<math>\mu\text{m}</math> 以上，而光刻胶旋涂厚度通常在 40<math>\mu\text{m}</math> 以下，光刻胶厚度难以满足其高度需求。目前业界有两种做法，一种是采用机械方式直接在晶圆贴上一层预制干膜（Dry Film），一般有 80<math>\mu\text{m}</math>、120<math>\mu\text{m}</math> 等厚度，但此方式有厚度灵活度低、机械贴膜撕膜易破片、膜层与晶圆结合力弱等问题；另一种做法是通过两道涂布的方式，将光刻胶的总厚度提高，此类方法可行性高，但工序上比较繁琐。基于对以上两种做法的研究与实践，公司在 2015 年实现只用一道工序完成两次涂布（Double Coating）的生产方案，并协同设备厂商共同开发，在一个生产程序实现了两次涂布生产方式，并建立了 60<math>\mu\text{m}</math>/80<math>\mu\text{m}</math>/90<math>\mu\text{m}</math>/110<math>\mu\text{m}</math>/130<math>\mu\text{m}</math> 完整体系，满足各类铜柱凸块的电镀需求。</p>	2015 年开始研发，由公司独立完成，与硕邦科技采用不同工艺路线。
		光阻气泡解决技术	<p>光阻气泡是光刻胶涂布的主要异常之一，对光刻品质和良率有比较大的影响，一般的改善点在于对设备的优化，而公司从理论和实践出发，于2019年发现衬底表面的亲水性也会导致光阻气泡的出现，弥补了长期以来气泡难以根治的问题点。公司提出利用介电层 PI 粗糙度的方式来改变衬底的润湿性能，从而解决光阻气泡问题。应用于实际生产，高效且经济地解决了气泡问题。</p>	2019年开始研发，由公司独立完成。

分类	工艺	核心技术	形成发展过程	核心技术来源及形成阶段
			基于研发成果，公司目前已取得 1 件相关专利。	
铜镍金凸块		低应力凸块下金属层技术	凸点下金属层（UBM, Under bump metal）是凸块制造技术的重要环节，业界通常使用钛（Ti）金属层，形成钛/铜（Ti/Cu）的 UBM 结构。相较于 Ti，钛钨（TiW）层具备更低的薄膜应力，其形成的 TiW/Cu 的 UBM 结构可使芯片翘曲度降低、内应力更小、性能更稳固，尤其适用于大面积的铜镍金技术。公司在铜镍金凸块领域建置之初即使用 TiW/Cu 结构，并对相关工艺进行持续优化。	2015 年开始独立研发，为公司自主开展铜镍金凸块研发时形成的核心技术。
		微间距线圈环绕凸块制造技术	随着集成电路技术下游应用的不断发展，对于高电磁、强感应等特殊芯片的封测需求逐渐增多，此类产品需要以重布线（CuNiAu）环绕的方式在芯片表面布满线圈，一方面为了使键合端凸块有更好的键合能力，另一方面重布线层因为表层是 Au 而具有更优良的可靠性。如何缩小线圈的宽度和间距，成为此类凸块技术的关键，而线圈的宽度主要受到曝光、显影、电镀等多方面能力影响。为应对工艺问题，公司于2017年开始研发微间距线圈环绕凸块制造技术，目前公司成熟量产工艺可加工线圈最小宽度（size）为10μm，最小间距（space）为9μm，根据 IC 分布情况可实现最大长度环绕。 基于研发成果，公司目前已取得 1 件相关专利。	2017年开始研发，由公司独立完成。
		高介电层加工技术	PI 的厚度受到材料、工艺等方面的限制，一般 PI 的厚度不超过10μm，部分高介电的铜镍金凸块对 PI 厚度要求更高。为了使 PI 厚度能够达到更高需求，公司在2017年引进先进的低温固化光刻胶材料，研发相关量产工艺。低温固化 PI 皱缩率低，在相同固化目标厚度下，低温材料固化前厚度更低，光刻工艺更容易实现。在这一技术要点下，控制固化前光刻工艺诸如涂布、曝光、显影等制程极为关键。目前，公司在15μm 及20μm 的 PI 工艺已具备成熟量产能力，形成完整的5μm、10μm、15μm、20μm 的 PI 厚度体系，使得 PI 的应用范围明显扩大，满足了各类高端芯片的需求。 基于研发成果，公司目前已取得 1 件相关专利。	2017年开始研发，由公司独立完成，而顾邦科技使用不同 PI 材质，无对应技术。
		多层堆叠封装技术	在先进封装领域，多层 PI 与多层金属堆叠是比较常见的技术，一般来讲不超过2P2M。然对于 CuNiAu 凸块技术来说，不仅是最外层凸点需要，还有各金属层出于对功能的需要，逐层叠加，最终形成完整的元器件单元，因此在 CuNiAu 技术领域，多 P 多 M 的叠加需求更多。越往上叠加，各层的良率控制越困难。自2015年开始，公司顺应电源管理芯片等领域的发展趋势，不断提升工艺、技术水平，在2021年时已实现最高4P4M 的量产工艺。多年来，公司在 CuNiAu 凸块加工技术	2015年开始研发，由公司独立完成，顾邦科技采用不同 PI 材质，且公司所形成的凸块堆积结构领先于顾邦科技。

分类	工艺	核心技术	形成发展过程	核心技术来源及形成阶段
			上不断进行开拓创新，具备较强的技术实力。 基于研发成果，公司目前已取得 4 件相关专利	
	锡凸块	真空落球技术	锡凸块植球的制造工艺中，球体落球以及回收会遇到刮刀损伤球体，刮刀毛刷藏球混球，严重影响植球可靠度。2019 年公司通过引进采用真空落球技术的植球机台，以非物理接触的方式完成植球制程，开发各项系统管控，解决了传统植球制程的品质隐患，提高了产品可靠度。	2019 年开始研发，由公司独立完成。
		小尺寸高密度焊锡凸块技术	锡凸块植球的制造工艺受限于钢板的精度以及球体的尺寸，基本量产的型号尺寸在150 $\mu\text{m}$ 以上，2019年公司通过优化电镀工艺，以截球体积精准换算截球尺寸和高度，实现以电镀的方式生产40 $\mu\text{m}$ 以上的锡凸块产品，填补植球产品小尺寸的空缺，达成超高集成密度的焊锡凸块。 基于研发成果，公司目前已取得专利 5 项	2019年开始研发，由公司独立完成。
测试技术		测试核心配件设计技术	半导体的晶圆测试过程中，其核心配件探针卡起着至关重要的作用，每片探针卡上约 2~4 千根探针，不仅数量多而且针间距也较小，探针卡的检测和维修主要靠人工作业，相对耗时，且对人员的技能要求极高。 为解决此问题，公司从 2010 年开始，对自动调针机开始着手研发。初期的自动调针机可以用于新卡针位、水平、针径的检测。2019 年之后，研发团队将自动调针机进一步升级，逐步可实现针位、水平自动调整，极大地缩短了探针卡维修时间。 基于研发成果，目前公司已取得 1 项相关专利。	2010 年开始研发，并于 2019 年之后进一步升级，由公司独立完成。
		集成电路测试自动化系统	在半导体测试过程中，需要人工设定较多测试参数，若人为设定错误则会造成测试品质风险，给客户产品造成损失。 基于以上问题，公司于 2012 年启动测试自动化系统的研发，并于 2020 年成立了自动化部门，目前已实现测试设备参数的自动设定、自动分片机、自动烘烤等一整套测试自动化功能，并可为客户提供定制化的测试自动化解决方案，实现产品高质量及高效率的测试。 基于研发成果，目前公司已取得 1 项相关专利。	2012 年开始研发，2020 年公司形成专门自动化部门并对该技术进行升级，由公司独立完成。
封装技术	COF	高精度高密度内引脚接合技术	随着目前显示技术的快速提升，显示驱动芯片封装朝着高密度、微间距方向发展，单颗芯片的 I/O 数量大幅增加，间距越来越小，接合精度直接影响封装良率及终端产品稳定性。 基于以上背景，公司自2011年成立研发小组并投入大量资金，从取芯翻转、接合等环节进行相关的机构改良及参数优化，COF 引脚最小间距达到了16 $\mu\text{m}$ 。 2018年之后，公司通过对料带传送、接合治具、接合后检查等方面进一步研发及改造，优化了多	2011年开始研发，并于 2018年之后进一步升级（如料带传送、接合治具、接合后检查等），由公司独立完成。

分类	工艺	核心技术	形成发展过程	核心技术来源及形成阶段
			项结构和治具，目前 COF 引脚间距进一步缩小至12μm，凸块与引脚的偏移率控制在1.5μm 以内，单颗芯片 I/O 数量超过4,000个，在行业内处于领先水平。 基于研发成果，目前公司已取得 8 项相关专利。	
		高精度柔性线路板封装工艺中微尘保护技术	以往封装工艺中因凸块或引线间距较大，对外物防护不够，COF 产品因其间距较小，金属类和卤素类物质均会造成产品电性异常。 基于以上背景，公司于2006年成立研发小组持续开发外物防护技术，从人、机、料、法等方面入手，重点针对接合工艺环节进行数据收集、分析、改善，找出风险点并针对性研发异物防护措施。 近年来，公司持续开发外物防护技术，扩大防护的研究范围，从卷带原材、卷带上料及收料机构、设备料带传送结构等方面进行设计优化，进一步提升了微尘保护技术能力。 基于研发成果，目前公司已取得相关专利 5 项	在苏州顾中创立初期即建立了无尘技术，但仅局限于部分工序，发行人后续对相关技术进行独立地升级优化。目前所使用的主要技术形成于2018年 Fab2 厂房建立完成后。
		125mm 超大带宽薄膜技术	随着高阶显示技术的发展，尤其是高分辨率高刷新率的需求越来越多，显示驱动芯片的 I/O 数量要求也越来越高。薄膜宽度最大为70mm，限制了 I/O 数量的进一步增加。 基于以上背景，2020 年公司自主研发并改良了多个设备的核心作业机构，通过自行对设备的改造并优化相关工艺参数，目前在行业首创了 125mm 大版面覆晶封装技术，并具备量产能力。	2020年开始研发，为行业首创。
		全方位高效能散热解决技术	随着新型显示技术的发展，以及4K/8K 超高清的显示需求，显示驱动芯片需要高功率运行，在使用过程中芯片会产生大量热量，为了保证长时间的运行，需要对 COF 产品提出有效的散热解决方案。 基于以上背景，公司自2018年成立研发小组，持续开发各类不同的散热解决方案，从散热材料、产品贴附方式、贴附设备、贴附工艺等方面入手，研发出多种高效能的散热解决技术，可以根据客户不同的产品需求提供针对性的散热解决方案。 基于研发成果，目前共提出专利 1 项	2018年开始研发，由公司独立完成。
	COG/COP	高稳定性晶圆研磨切割技术	随着显示驱动芯片厚度不断降低，芯片尺寸长宽比越来越大，晶圆研磨切割过程中容易造成芯片断裂、裂痕、崩缺等异常。 为解决上述问题，公司于2018年成立研发小组，自主研发机台管理系统，研发改良了切割冲水机构及开发出厚片切割技术，不同尺寸晶圆的快速切换技术，提升研磨切割良率，目前公司的研磨切割工艺在行业内处于领先水平。	2018年开始研发，由公司独立完成。

分类	工艺	核心技术	形成发展过程	核心技术来源及形成阶段
			基于研发成果，公司目前取得 3 项专利	
		超薄晶圆盖印技术	随着 SiP 封装趋势日益凸显，集成芯片越来越多，晶圆越来越薄，对薄片盖印技术的需求日益增加。 基于以上背景，公司自 2019 年成立研发小组，自主研发出超薄晶圆激光盖印技术，在不增加设备成本的情况下，盖印工艺可实现晶圆最薄至 90 $\mu\text{m}$ ，而且可保证盖印深度在 1 $\mu\text{m}$ 以内，有效减少薄片晶圆在透膜盖印时的残胶问题。	2019年开始研发，由公司独立完成。
	DPS	高精高稳定性新型半导体材料晶圆切割技术	DPS 是公司为实现 Fan-WLCSP 全制程技术的重要环节，随着新型半导体材料的兴起，对切割稳定性要求也日益提高。 基于上述背景，公司于2020年成立研发小组投入大量资金及人力，进行一系列优化切割技术稳定性的研发活动，从晶圆传送，切割，清洗各环节进行相关机构，治具改良设计，以及工艺参数优化，研发出针对厚度的切割技术，以及切割水管高度量测技术等，有效提升切割良率。 基于研发成果，公司目前取得 3 项专利。	2020年开始研发，由公司独立完成。

综上所述，发行人具有独立的研发体系和研发团队，具备独立的研发能力，目前所拥有的核心技术均来自自主研发，不存在对顾邦科技的依赖。

### **3、人员独立**

公司的员工完全独立于顾邦科技。具体而言，公司现任的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员均不在顾邦科技及其控制的其他企业中担任任何职务，亦不在顾邦科技领薪。除杨宗铭曾在顾邦科技任职（已离职超过 15 年）以及外部董事罗世蔚外，公司现任董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及公司研发人员、财务人员均无顾邦科技任职经历。

综上，除行使股东权利提名一名董事外，顾邦科技不参与公司任何人事任命，公司人员与顾邦科技相互独立，不存在对顾邦科技的依赖。

### **4、资产独立**

公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，合法拥有与生产经营有关的主要土地、厂房、机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具备与经营有关的所有业务体系及主要相关资产。发行人上述资产完整且完全独立于顾邦科技，双方不存在共有、共用或借用任何资产的情形，不存在对顾邦科技的依赖。

### **5、采购及销售渠道独立**

报告期内，公司对供应商均独立接洽、谈判、定价、维护，基于供应商的供货品质、稳定性、供货价格与生产需求建立合格供应商名录。公司的主要原材料和设备采购均由公司独立决策、独立执行。顾邦科技未向顾中科技委派任何高管或员工，不参与公司采购的任何环节，公司供应商的取得、维系独立于顾邦科技。报告期内，公司主要供应商与顾邦科技重叠情况详见本题回复之“三、（二）”相关内容。

报告期内，公司对客户均独立接洽、谈判、定价、维护，主要依据客户经营规模、资金实力、技术能力和销售能力等因素对客户进行调查评估并开展合作，相关产品均独立通过客户的验证。公司的销售模式、商务政策及业务拓展均独立决策、独立执行。顾邦科技未向顾中科技委派任何高管或员工，不参与公司销售的任何环节。报告期内，公司主要客户与顾邦科技重叠情况详见本题回复之“三、（一）”相关内容。

综上，公司采购及销售渠道均独立于顾邦科技，不存在对顾邦科技的依赖。

## 6、资金独立

公司制定了《资金调度及管理作业规范》、《付款作业规范》、《借款作业规范》等一系列资金管理制度并严格执行，资金管理完全独立于顾邦科技，不存在与顾邦科技共用银行账户、相互提供财务资助或互相担保等情况。公司资金不存在对顾邦科技的依赖。

## 7、发行人主要股东顾中控股（香港）及其控股股东顾邦科技已出具《关于保持业务独立性的承诺函》

顾邦科技股份有限公司作为合肥顾中科技股份有限公司（以下称“顾中科技”）的股东 CHIPMORE HOLDING COMPANY LIMITED（HK）之控股股东，就以下事宜向顾中科技确认并承诺如下：

“（1）本公司及本公司下属企业在资产、业务、人员、机构、财务等方面均与顾中科技相互独立，不存在与顾中科技共用资产或资产混同、相互参与业务开拓、人员在顾中科技兼职或领薪、与顾中科技机构混同等影响顾中科技独立性的情形。

（2）本公司及本公司下属企业与顾中科技的相关技术和专利均系双方自主研发，不存在技术授权、职务发明，不存在纠纷或潜在纠纷。

（3）本公司及本公司下属企业与顾中科技的客户、供应商均系双方独立开发、谈判、维护，不存在非公平竞争、通过客户或供应商进行利益输送、相互或单方让渡商业机会等情形。

（4）本公司及本公司下属企业与顾中科技之间的关联交易均遵循市场化交易原则，系双方协商确定，交易价格公允。

（5）本公司作为顾中科技股东并通过提名董事在顾中科技股东大会和董事会层面参与顾中科技重大事项的决策，不存在干预顾中科技采购、生产、销售、研发、财务、人事等日常经营决策的情形。

（6）本公司过去未曾且承诺未来亦不会利用股东表决权和董事会席位等谋求不正当利益或作出不利于顾中科技而有利于本公司及本公司下属企业的任何

决定，不会损害顾中科技及其他股东的合法权益。

(7) 本公司保证将严格遵循相关法律法规和上海证券交易所及中国证监会的要求，确保顾中科技按照上市公司的规范独立自主经营，保证顾中科技的资产、业务、财务、人员、机构独立。

(8) 本公司及本公司下属企业保证不在中国大陆设立其他企业或投资于顾中科技以外的其他企业以生产或销售与顾中科技相同或相似的产品。

(9) 本公司及本公司下属企业保证不以任何方式向从事与顾中科技相同或相似业务的第三方提供任何技术支持。

(10) 若因违反本承诺函的任何条款而导致顾中科技遭受损失的，本公司将依法赔偿，最终赔偿方案由双方协商确定或由有管辖权的法院作出的生效判决确定。

(11) 本承诺函之成立、生效、解释、适用、变更、解除、失效、终止等均适用中华人民共和国法律，并依据中华人民共和国法律解释。有关本承诺函的一切争议均应提交至顾中科技住所地有管辖权的人民法院，通过诉讼的方式解决。

(12) 本承诺函自本公司有权代表签字并加盖本公司公章之日起生效，本公司签署本承诺函已获得全部必要之批准及授权，不存在未经授权或者超出授权范围签发本承诺函的情形。”

综上，发行人在业务、技术、人员、资产、采购及销售渠道、资金等方面不存在对顾邦科技的依赖。

三、发行人与颀邦科技重叠客户、供应商的情况，相关采购、收入金额及占比，涉及的产品及工艺流程，并结合公司产业链上下游的市场集中度情况，分析重叠客户及供应商的合理性，并说明公司与相关重叠客户、供应商交易价格的公允性

(一) 发行人与颀邦科技重叠客户的情况，相关收入金额及占比，涉及的产品及工艺流程，并结合公司产业链上下游的市场集中度情况，分析重叠客户的合理性，并说明公司与相关重叠客户交易价格的公允性

### 1、重叠客户的情况，相关收入金额及占比，涉及的产品及工艺流程

#### (1) 显示驱动芯片封测业务

报告期内，公司显示驱动芯片封测业务主要客户与颀邦科技收入占比超过5%的客户重叠情况、相关收入金额及占比情况如下：

单位：万元

2021年度				
排名	客户名称	显示业务销售金额	占显示业务收入总额的比例	是否重叠
1	联咏科技	42,246.70	35.23%	是
2	敦泰电子	14,798.66	12.34%	是
3	集创北方	14,747.98	12.30%	否
4	瑞鼎科技	6,428.00	5.36%	是
5	奕斯伟	6,300.33	5.25%	否
6	谱瑞科技	5,499.06	4.59%	否
7	深圳通锐微电子有限公司	5,207.01	4.34%	否
8	晶门科技	3,645.05	3.04%	否
9	格科微电子	3,580.00	2.99%	否
10	奇景光电	3,545.48	2.96%	是
	合计	<b>105,998.28</b>	<b>88.40%</b>	
2020年度				
排名	客户名称	显示业务销售金额	占显示业务收入总额的比例	是否重叠
1	联咏科技	44,425.26	55.13%	是
2	敦泰电子	13,620.24	16.90%	是
3	瑞鼎科技	4,953.99	6.15%	是

4	奇景光电	4,612.08	5.72%	是
5	格科微电子	3,545.67	4.40%	否
6	集创北方	2,888.96	3.58%	否
7	奕斯伟	1,582.28	1.96%	否
8	晶门科技	752.19	0.93%	否
9	昆山云英谷电子科技有限公司	685.76	0.85%	否
10	禹创半导体（深圳）有限公司	662.43	0.82%	否
<b>合计</b>		<b>77,728.86</b>	<b>96.45%</b>	
2019 年度				
排名	客户名称	显示业务销售金额	占显示业务收入总额的比例	是否重叠
1	联咏科技	44,655.40	69.53%	是
2	奇景光电	5,447.48	8.48%	是
3	瑞鼎科技	4,192.78	6.53%	是
4	格科微电子	4,154.99	6.47%	否
5	敦泰电子	1,941.14	3.02%	是
6	晶门科技	1,580.71	2.46%	否
7	瑞章科技有限公司	568.62	0.89%	否
8	华大恒芯科技有限公司	227.86	0.35%	否
9	上海复旦微电子集团股份有限公司	222.33	0.35%	否
10	苏州日月新半导体有限公司	214.60	0.33%	否
<b>合计</b>		<b>63,205.91</b>	<b>98.41%</b>	

注 1：上述客户销售金额统计按照合并口径计算，其中敦泰电子包括 FocalTech Electronics, Ltd.、FocalTech Systems Co., Ltd.；瑞鼎科技包括 Raydium Semiconductor Corporation、昆山瑞创芯电子有限公司；格科微电子包括格科微电子（上海）有限公司、格科微电子（浙江）有限公司、GALAXYCORE（HONG KONG） LIMITED；集创北方包括 Chipone（Hong Kong） Co. Limited、OLED VICTORY INTERNATIONAL LIMITED、北京集创北方科技股份有限公司；奕斯伟包括北京奕斯伟计算技术有限公司（已更名为“北京奕斯伟计算技术股份有限公司”）、合肥奕斯伟集成电路有限公司、成都奕斯伟系统集成电路有限公司、成都奕斯伟系统技术有限公司；晶门科技包括晶门科技（中国）有限公司、晶门科技（深圳）有限公司；

注 2：客户重叠情况由硕邦科技提供。

如上表所示，由于下游 IC 设计客户集中度较高，公司与硕邦科技重叠的主要客户为中国台湾的联咏科技（证券代码：3034.TW）、敦泰电子（证券代码：3545.TW）、瑞鼎科技（证券代码：3592.TW）、奇景光电（证券代码：HIMX.O），均为行业领先的显示驱动芯片设计企业。报告期内，上述重叠客户的收入金额占公司显示业务收入的比例分别为 87.56%、83.90%和 55.89%，占

比逐年降低。

①公司与硕邦科技向重叠客户提供的服务存在差异

报告期内，公司向主要重叠客户销售的产品类型与硕邦科技向同一客户销售产品类型的对比情况如下：

序号	客户名称	发行人提供的封测服务	硕邦科技提供的封测服务	差异情况
1	联咏科技	主要产品为大尺寸（TV、Monitor）COF封装及中阶手机（HD 720 TDDI）应用封装服务	主要为高阶手机 TDDI（FHD）COG及 AMOLED 等高阶产品之应用封装服务	双方所封装的产品类型不完全相同，且相同产品均需独立通过客户的验证
2	敦泰电子	主要为手机 HD720 & FHD TDDI 产品之封装服务	除手机 HD720 & FHD TDDI 产品之封装服务外，还包含 AMOLED、可穿戴设备等产品	
3	瑞鼎科技	仅有大尺寸（TV、Monitor）COF封装服务，2021年开始验证 AMOLED 产品，并于 2022 年 Q2 开始量产	除大尺寸（TV、Monitor）COF封装服务，还包括了可穿戴设备、手机、车载电子等 AMOLED 产品封装	
4	奇景光电	仅小部分大尺寸（TV、Monitor）COF封装	包括 TV、Monitor、Pad、车载电子等显示驱动芯片封装	

②重叠客户为公司独立开发并进行产品验证

公司在与上述重叠客户就相关产品达成合作前，需要独立通过客户的产品验证，只有在产品通过客户的验证流程后，发行人开始与客户协商洽谈量产出货。其次，不同 IC 设计公司所对应的下游面板厂商也需要单独对封测企业进行验证以满足其要求。另外，部分终端品牌商出于对重要供应商全流程的掌控，也需对封测厂商进行单独验证。

2018 年至今，公司与上述重叠 IC 设计公司就主要销售产品的验证情况如下：

序号	客户名称	产品类型	首批试产	小批量量产	大批量生产	销售人员是否与硕邦科技存在关系
1	联咏科技	8" DDI COF Turnkey	2018/01	2018/05	2018/05	否
		8" DDI COG Turnkey	2018/04	2018/12	2019/06	
		12" DDI COF Turnkey	2018/04	2018/08	2018/08	

序号	客户名称	产品类型	首批试产	小批量量产	大批量生产	销售人员是否与硕邦科技存在关系
		12" TDDI COG Turnkey	2019/01	2019/03	2019/07	
		12" DDI COG Turnkey	2019/09	2020/11	2021/01	
		8" TV P2P COF Turnkey	2020/04	2020/05	2020/05	
		12" 28nm AMOLED COP Turnkey	2021/10	-	-	
		12" 40nm AMOLED COP Turnkey	2022/01	-	-	
2	敦泰电子	12" 80nm TDDI COG Turnkey	2019/07	2019/09	2019/09	否
		12" 55nm TDDI COG Turnkey	2019/08	2019/09	2019/12	
3	瑞鼎科技	8" DDI COF Turnkey	2018/01	2018/02	2018/04	否
		12" AMOLED COP Turnkey	2022/04	2022/05	2022/06	
		8"车载 DDIC COG Turnkey	2021/03	-	-	
4	奇景光电	12" DDI COF Turnkey	2018/06	2018/08	2018/09	否
		12" TDDI COG Turnkey	2021/05	-	-	

2018 年至今，公司显示驱动芯片封测业务向重叠客户销售的主要产品均为公司根据客户需求独立开发并通过客户验证后实现量产。

## (2) 非显示类芯片封测业务

报告期内，公司非显示类芯片封测业务主要客户与硕邦科技收入占比超过 5% 的客户重叠情况、相关收入金额及占比情况如下：

单位：万元

2021 年度				
排名	客户名称	非显示业务销售金额	占非显示业务收入总额的比例	是否重叠
1	矽力杰	2,137.52	21.20%	否
2	杰华特	998.07	9.90%	否
3	南芯半导体	981.90	9.74%	否
4	钰泰半导体股份有限公司	890.98	8.84%	否
5	艾为电子	744.88	7.39%	否

6	西安拓尔微电子股份有限公司	650.69	6.45%	否
7	杭州迦美信芯通讯技术有限公司	520.89	5.17%	否
8	唯捷创芯	478.36	4.74%	否
9	圣邦微电子（北京）股份有限公司	393.15	3.90%	否
10	昂瑞微	199.54	1.98%	否
<b>合计</b>		<b>7,995.99</b>	<b>79.29%</b>	
2020 年度				
排名	客户名称	非显示业务 销售金额	占非显示业务收 入总额的比例	是否重叠
1	钰泰半导体股份有限公司	663.00	17.18%	否
2	南芯半导体	603.88	15.65%	否
3	矽力杰	410.44	10.64%	否
4	西安拓尔微电子股份有限公司	399.03	10.34%	否
5	杰华特	348.22	9.02%	否
6	深圳飞骧科技股份有限公司	157.44	4.08%	否
7	奥特斯（中国）有限公司	152.78	3.96%	否
8	无锡芯朋微电子股份有限公司	151.72	3.93%	否
9	昂瑞微	123.90	3.21%	否
10	江苏卓胜微电子股份有限公司	88.07	2.28%	否
<b>合计</b>		<b>3,098.49</b>	<b>80.29%</b>	
2019 年度				
排名	客户名称	非显示业务 销售金额	占非显示业务收 入总额的比例	是否重叠
1	杰华特	313.93	23.95%	否
2	南芯半导体	151.27	11.54%	否
3	钰泰半导体股份有限公司	131.09	10.00%	否
4	江苏卓胜微电子股份有限公司	122.11	9.32%	否
5	矽力杰	98.07	7.48%	否
6	深圳飞骧科技股份有限公司	89.62	6.84%	否
7	上海岭芯微电子电子有限公司	63.10	4.81%	否
8	无锡芯朋微电子股份有限公司	61.27	4.67%	否
9	京隆科技（苏州）有限公司	51.72	3.95%	否
10	嘉盛半导体（苏州）有限公司	50.63	3.86%	否
<b>合计</b>		<b>1,132.81</b>	<b>86.43%</b>	

注：上述客户销售金额统计按照合并口径计算，其中矽力杰包括 Silergy Corp.、矽力杰半

导体技术（杭州）有限公司、南京矽力微电子科技有限公司；唯捷创芯包括唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司、上海唯捷创芯电子科技有限公司；昂瑞微包括格北京昂瑞微电子技术股份有限公司、HONGKONG ONMICRO ELECTRONICS。

在非显示类封测领域，公司客户主要集中在中国大陆，与顾邦科技的客户群体差异较大。报告期内，公司非显示类芯片封测业务主要客户与顾邦科技收入占比超过 5% 的客户均不重叠。

## 2、结合公司产业链上下游的市场集中度情况，分析重叠客户的合理性

发行人与顾邦科技存在重叠客户的主要原因系：

### （1）显示驱动芯片设计公司集中度较高

在显示驱动芯片市场上，联咏科技、奇景光电、瑞鼎科技、敦泰电子等中国台湾企业凭借多年以来的技术积累，成为了市场的领导者，主导着显示驱动芯片市场的技术发展与应用。

根据沙利文的统计，2020 年度中国显示驱动芯片设计公司市场排名情况如下：

排名	中文名	英文名	所属地区	备注
1	联咏科技	Novatek	中国台湾	全球排名第二
2	奇景光电	Himax	中国台湾	全球排名第四
3	瑞鼎科技	Raydium	中国台湾	全球排名第五
4	天钰科技	Fitipower	中国台湾	全球排名第七
5	奕力科技	ILITEK	中国台湾	全球排名第九
6	矽创电子	Sitronix	中国台湾	全球排名第十
7	集创北方	Chipone	中国大陆	
8	敦泰电子	FocalTech	中国台湾	
9	奕斯伟	ESWIN	中国大陆	
10	晶门科技	Solomon	中国香港	

根据显示驱动芯片行业领先企业联咏科技 2021 年年报披露：显示驱动芯片行业呈现大者恒大的发展趋势，依据国际知名研究机构 Omdia 发布的 2021 年前三季度显示驱动芯片跟踪报告，全球前十大显示驱动芯片设计公司市场占有率高达 92.2%。

随着中国大陆半导体产业的迅速发展，集创北方、奕斯伟、晶门科技等显

示驱动芯片设计企业规模持续增长，加之公司非显示类芯片封测业务收入规模不断攀升，公司客户结构不断优化。报告期内，发行人与硕邦科技不同客户的占比在逐年提升，特别是 2021 年重叠客户销售收入占比出现明显下降。

## (2) 客户对封测服务的需求量和稳定性要求较高

同一客户（特别是大型企业）通常会在全球范围内寻找多家头部封测厂商以确保其获得稳定可靠的封测服务，分散经营风险，提升供应链安全。根据同行业可比公司汇成股份公开披露的资料，其报告期前五大客户包括联咏科技、瑞鼎科技、奇景光电、晶门科技、昆山瑞创芯等，与发行人及硕邦科技亦存在客户重叠的情形。因此，同时选择多家封测厂商对于 IC 设计公司（即发行人客户）而言具有必要性和合理性，符合行业经营特点。

综上，公司与硕邦科技存在重叠客户具有商业合理性。

## 3、说明公司与相关重叠客户交易价格的公允性

报告期内，公司显示业务各制程定价主要影响因素如下：

项目	价格主要影响因素	说明
Gold Bumping	黄金价格、黄金用量、检验工序、吋别等	受黄金价格波动影响，且不同时别及不同产品所需黄金用量不同，销售单价存在差异；此外，不同产品类型对检验工序的要求不同也会影响销售单价
CP	测试平台、测试时长等	测试精确性、同测能力、机器设备规格差异等，都会造成单位工时的价格差异，性能高或规格高的单价更高；此外，不同时别、不同产品类型、产品规格的测试方案不同，均会导致所需的测试时长不同，进而影响每片的测试单价
COG	每片晶粒数、Tray 吋别、产品工序等	不同产品类型对工艺要求不同，因此产品定价存在差异
COF	每片晶粒数、卷带长度及宽度、引脚间距、FT 测试平台、FT 测试时长、散热工艺等	不同产品的工艺要求、技术指标、FT 测试时长各有差异，因此产品定价存在差异

报告期内，公司与主要重叠客户联咏科技、敦泰电子、瑞鼎科技、奇景光电交易价格的公允性分析如下：

### (1) 联咏科技

报告期内，公司对联咏科技实现的显示业务销售金额分别为 44,655.40 万元、44,425.26 万元和 42,246.70 万元，下游终端应用领域主要包括智能手机（TDDI）、

笔记本电脑、高清电视，所封装产品尺寸包括 8 吋和 12 吋。

非重叠客户同类产品销售均价和联咏科技之间的差异率及原因如下：

① 智能手机（TDDI）

制程	吋别	客户名称	2021 年度	2020 年度	2019 年度	定价差异原因
Gold Bumping	12	非重叠客户 1	0.81%	2.24%	/	报告期内，不同客户销售均价不存在重大差异
CP	12	非重叠客户 1	52.52%	31.56%	/	报告期内，不同客户销售均价存在差异主要是由于产品规格不同，使用的测试设备不同，以及因测试程序设计不同导致单片所需的测试时长不同，非重叠客户 1 相关产品单片测试时间更长，因此销售均价更高
COG	-	非重叠客户 1	-2.17%	93.47%	/	2020 年，非重叠客户 1 销售均价相对较高，主要是由于 2020 年其处于初期开发工程阶段，工程品销售均价较高

注：表格中差异率=（非重叠客户同类产品销售均价-重叠客户同类产品销售均价）/重叠客户同类产品销售均价，下同。

②笔记本电脑

制程	吋别	客户名称	2021 年度	2020 年度	2019 年度	定价差异原因
Gold Bumping	12	非重叠客户 2	26.27%	17.53%	/	报告期内，不同客户销售均价存在差异主要是由于产品规格不同，黄金使用量存在差异，且公司综合考虑客户性质、价格敏感性收取不同的加工费
	8	非重叠客户 1	0.43%	-8.08%	8.75%	报告期内，不同客户销售均价不存在重大差异
CP	12	非重叠客户 2	-43.01%	-59.22%	/	报告期内，不同客户销售均价存在差异主要是由于产品规格不同，使用的测试设备不同，以及因测试程序设计不同导致单片所需的测试时长不同，联咏科技单片晶圆测试时间平均更长，因此销售均价更高
	8	非重叠客户 1	-61.86%	-55.40%	-20.68%	
COG	-	非重叠客户 2	93.01%	123.18%	/	报告期内，不同客户销售均价存在差异主要是由于产品规格不同，所需工艺水平存在差异，且公司综合考虑客户

制程	吋别	客户名称	2021 年度	2020 年度	2019 年度	定价差异原因
		非重叠客户 1	-27.63%	-12.33%	14.41%	

### ③ 高清电视

制程	吋别	客户名称	2021 年度	2020 年度	2019 年度	定价差异原因
Gold Bumping	12	非重叠客户 1	9.15%	5.13%	/	报告期内，不同客户销售均价存在差异主要是由于产品规格以及检测工序要求不同，黄金使用量存在差异
		非重叠客户 3	26.45%	/	/	
	8	非重叠客户 1	26.60%	30.62%	/	
		非重叠客户 3	17.64%	/	/	
CP	12	非重叠客户 1	-70.57%	-67.54%	/	报告期内，不同客户销售均价存在差异主要是由于产品规格不同，使用的测试设备不同，以及因测试程序设计不同导致单片所需的测试时长不同，非重叠客户 1 相关产品单片测试时间较短且由其提供探针卡，因此销售均价更低
		非重叠客户 3	9.10%	/	/	
	8	非重叠客户 1	-64.55%	-39.58%	/	
		非重叠客户 3	82.86%	/	/	
COF	-	非重叠客户 1	4.69%	17.87%	/	报告期内，不同客户销售均价不存在重大差异，因联咏科技销售量较大，因此定价略低于其他客户；此外，FT 测试使用测试设备不同，测试程序设计不同，也导致销售均价存在差异
		非重叠客户 3	32.27%	/	/	

### (2) 敦泰电子

报告期内，公司对敦泰电子实现的显示业务销售金额分别为 1,941.14 万元、13,620.24 万元和 14,798.66 万元，下游终端应用领域主要产品为智能手机（TDDI），晶圆尺寸主要为 12 吋。

非重叠客户同类产品销售均价和敦泰电子之间的差异率及原因如下：

制程	吋别	客户名称	2021 年度	2020 年度	2019 年度	定价差异原因
Gold Bumping	12	非重叠客户 1	-1.55%	4.79%	/	报告期内，不同客户销售均价不存在重大差异

制程	时别	客户名称	2021 年度	2020 年度	2019 年度	定价差异原因
CP	12	非重叠客户 1	25.82%	63.94%	/	报告期内，不同客户销售均价存在差异主要是由于产品规格不同，使用的测试设备不同，以及因测试程序设计不同导致单片所需的测试时长不同，非重叠客户 1 相关产品单片测试时间更长，因此销售均价更高
COG	-	非重叠客户 1	-7.56%	25.45%	/	2020 年，非重叠客户 1 销售均价相对较高，主要是由于 2020 年其处于初期开发工程阶段，工程品销售均价较高

### (3) 瑞鼎科技

报告期内，公司对瑞鼎科技实现的示业务销售金额分别为 4,192.78 万元、4,953.99 万元和 6,428.00 万元，分应用领域主要产品为高清电视（TV），所封装产品尺寸主要为 8 吋。

非重叠客户同类产品销售均价和瑞鼎科技之间的差异率及原因如下：

制程	时别	客户名称	2021 年度	2020 年度	2019 年度	定价差异原因
Gold Bumping	8	非重叠客户 1	2.43%	5.09%	/	报告期内，不同客户销售均价不存在重大差异
		非重叠客户 3	-4.82%	/	/	
CP	8	非重叠客户 1	-85.13%	-64.28%	/	报告期内，不同客户销售均价存在差异主要是由于产品规格不同，使用的测试设备不同，以及因测试程序设计不同导致单片所需的测试时长不同，非重叠客户 1 相关产品单片测试时间较短且由其提供探针卡，因此销售均价更低
		非重叠客户 3	-23.31%	/	/	
COF	-	非重叠客户 1	-14.34%	-18.25%	/	报告期内，不同客户销售均价存在差异主要是由于 FT 测试使用测试设备不同，测试程序设计不同；且公司综合考虑客户订单数量差异，确定不同的销售单价
		非重叠客户 3	8.22%	/	/	

### (4) 奇景光电

报告期内，公司对奇景光电实现的显示业务销售金额分别为 5,447.48 万元、4,612.08 万元和 3,545.48 万元，分应用领域主要产品为高清电视（TV），晶圆尺寸主要为 12 吋。

非重叠客户同类产品销售均价和奇景光电之间的差异率及原因如下：

制程	时别	客户名称	2021 年度	2020 年度	2019 年度	定价差异原因
Gold Bumping	12	非重叠客户 1	-0.81%	4.76%	/	报告期内，奇景光电销售均价和非重叠客户 1 相比不存在重大差异；报告期内，非重叠客户 3 销售均价相对较高，主要是由于产品规格不同，黄金使用量较多
		非重叠客户 3	14.91%	/	/	
CP	12	非重叠客户 1	-44.58%	-46.93%	/	报告期内，不同客户销售均价存在差异主要是由于产品规格不同，使用的测试设备不同，以及因测试程序设计不同导致单片所需的测试时长不同，非重叠客户 1 相关产品单片测试时间较短且由其提供探针卡，因此销售均价较低
		非重叠客户 3	105.44%	/	/	
COF	-	非重叠客户 1	-14.44%	-12.45%	/	报告期内，不同客户销售均价存在差异主要是由于 FT 测试使用测试设备不同，测试程序设计不同；且公司综合考虑客户订单数量差异，确定不同的销售单价
		非重叠客户 3	8.10%	/	/	

如前述各表所示，由于不同客户所设计的芯片产品存在差异，即使下游终端应用领域相同，其所要求的封装工艺和测试程式也会有所不同，因此在定价上均存在差异。公司自主与上述客户进行议价，相关定价方式遵循行业惯例，针对不同客户的定价存在差异具有合理性。

综上，公司与颀邦科技重叠的客户均为业内领先的显示驱动芯片设计企业，且均为中国台湾地区上市公司，均具有完善且市场化的定价体系，不存在通过不公允定价帮助公司与颀邦科技进行利益输送的情况。发行人主要参照各工序的工艺、难易程度、订单规模等多方面因素，自主与上述客户进行议价，与重叠客户的交易价格具有公允性。

(二) 发行人与硕邦科技重叠供应商的情况，相关采购金额及占比，涉及的产品及工艺流程，并结合公司产业链上下游的市场集中度情况，分析重叠供应商的合理性，并说明公司与相关重叠供应商交易价格的公允性

### 1、重叠供应商的情况，相关采购金额及占比，涉及的产品及工艺流程

#### (1) 材料供应商

报告期内，公司向前十大原材料供应商与硕邦科技材料采购占比超过 5% 的供应商重叠情况、相关采购金额及占比情况如下：

单位：万元

2021 年度					
序号	供应商名称	采购内容	发行人采购金额	占发行人材料采购总额的比例	是否重叠
1	光洋科技	金盐、靶材	21,812.23	62.00%	否
2	美泰乐科技（苏州）有限公司	金盐	1,718.96	4.89%	否
3	上海怡康化工材料有限公司	光阻液	969.76	2.76%	否
4	仕益科技股份有限公司	散热贴	807.50	2.30%	否
5	NAMICS CORPORATION	胶材	675.32	1.92%	否
6	原津工业股份有限公司	Tray 盘	670.54	1.91%	否
7	安美特企业有限公司	研磨胶带	577.30	1.64%	否
8	上海飞凯材料科技股份有限公司	显影液、蚀刻液	464.34	1.32%	否
9	NICHING INDUSTRIAL CORPORATION	Tray 盘	429.18	1.22%	否
10	安集微电子（上海）有限公司	蚀刻液	424.93	1.21%	否
合计			<b>28,550.06</b>	<b>81.13%</b>	
2020 年度					
序号	供应商名称	采购内容	发行人采购金额	占发行人材料采购总额的比例	是否重叠
1	光洋科技	金盐、靶材	17,153.63	65.74%	否
2	美泰乐科技（苏州）有限公司	金盐	1,177.85	4.51%	否
3	上海怡康化工材料有限公司	光阻液	574.61	2.20%	否
4	安美特企业有限公司	研磨胶带	485.72	1.86%	否
5	迪思科科技（中国）有限公司	刀具、磨轮等	446.63	1.71%	否
6	安集微电子（上海）有限公司	蚀刻液	332.42	1.27%	否

7	JSR Corporation	光阻液	326.32	1.25%	否
8	NICHING INDUSTRIAL CORPORATION	Tray 盘	324.58	1.24%	否
9	原津工业股份有限公司	Tray 盘	311.00	1.19%	否
10	NAMICS CORPORATION	胶材	303.82	1.16%	否
合计			<b>21,436.58</b>	<b>82.16%</b>	

2019 年度					
序号	供应商名称	采购内容	发行人采购金额	占发行人材料采购总额的比例	是否重叠
1	光洋科技	金盐、靶材	6,972.46	59.96%	否
2	NAMICS CORPORATION	胶材	422.70	3.64%	否
3	昭和电工	胶材	386.76	3.33%	否
4	迪思科科技（中国）有限公司	刀具、磨轮等	369.69	3.18%	否
5	安美特企业有限公司	研磨胶带	283.50	2.44%	否
6	JSR Corporation	光阻液	206.56	1.78%	否
7	安集微电子（上海）有限公司	蚀刻液	199.31	1.71%	否
8	上海怡康化工材料有限公司	光阻液	192.57	1.66%	否
9	苏州原津光电有限公司	Tray 盘	184.75	1.59%	否
10	ADVANCED CORPORATION	钛钨靶材	122.25	1.05%	否
合计			<b>9,340.55</b>	<b>80.34%</b>	

注 1：光洋科技包括光洋化学应用材料科技（昆山）有限公司、光洋新材料科技（昆山）有限公司；昭和电工包括昭和电工材料（香港）有限公司、嵩司蒂材料（上海）有限公司；注 2：供应商重叠情况由硕邦科技提供。

报告期内，公司前十大材料供应商与硕邦科技材料采购占比超过 5% 的供应商均不存在重叠。其中，光洋科技母公司光洋应用材料科技股份有限公司（证券简称：光洋科，证券代码：1785.TWO）与硕邦科技存在合作，但硕邦科技向其采购金额占其材料采购总额的比例较低，报告期各期分别为 0.42%、0.32% 和 0.28%。

## （2）设备供应商

报告期内，公司向十大设备供应商与硕邦科技设备采购占比超过 5% 的供应商重叠情况、相关采购金额及占比情况如下：

单位：万元

2021 年度					
序号	供应商名称	主要采购内容	发行人采购金额	占发行人设备采购总额的比例	是否重叠
1	Advantest (爱德万)	集成电路测试机	28,381.27	42.28%	是
2	TOKYO SEIMITSUCO., LTD (东京精密)	探针台	4,496.24	6.70%	是
3	SPTS Technologies Ltd.	金属溅镀机	3,769.43	5.62%	否
4	京隆科技(苏州)有限公司	集成电路测试机、探针台、挑拣机等	3,648.78	5.44%	否
5	上海微电子装备(集团)股份有限公司	步进投影式光刻机	2,933.55	4.37%	否
6	NIDEC-READ CORPORATION	晶圆立体检查仪	1,377.47	2.05%	否
7	纽约智能识别技术(无锡)有限公司	晶粒检取机	1,351.91	2.01%	否
8	翔胜企业股份有限公司	散热片贴附机	1,279.59	1.91%	否
9	DISCO CORPORATION (迪思科科技)	切割机	931.89	1.39%	是
10	苏州优越精密机械有限公司	挑拣机	928.54	1.38%	否
合计			<b>49,098.67</b>	<b>73.14%</b>	
2020 年度					
序号	供应商名称	主要采购内容	发行人采购金额	占发行人设备采购总额的比例	是否重叠
1	TOKYO SEIMITSUCO., LTD (东京精密)	探针台、配件	5,507.70	13.49%	是
2	Advantest (爱德万)	集成电路测试机及其测试头、电路板	4,682.68	11.47%	是
3	上海微电子装备(集团)股份有限公司	步进投影式光刻机	3,067.10	7.51%	否
4	SPTS Technologies Ltd.	金属溅镀机、12吋 SPTSHSE 腔陶瓷	2,379.67	5.83%	否
5	ASM NEXX, Inc.	全自动铜镍锡电镀机	2,207.23	5.41%	否
6	DISCO CORPORATION (迪思科科技)	切割机	2,194.97	5.38%	是
7	ASM Pacific (Hong Kong) Limited	激光开槽机	1,931.33	4.73%	否
8	NIDEC-READ CORPORATION	晶圆立体检查仪	1,833.90	4.49%	否
9	UTECHZONE CO., LTD.	自动光学检查机	1,267.09	3.10%	否

10	PNT SOLUTION Co., LTD	摆动气缸、卷轴挡板、驱动器等	1,053.68	2.58%	否
合计			<b>26,125.35</b>	<b>63.98%</b>	
<b>2019 年度</b>					
序号	供应商名称	主要采购内容	发行人采购金额	占发行人设备采购总额的比例	是否重叠
1	Advantest (爱德万)	集成电路测试机	41,128.16	59.08%	是
2	TOKYO SEIMITSUCO., LTD (东京精密)	探针台	5,748.48	8.26%	是
3	翔胜企业股份有限公司	封胶机、盖印机、激光盖印机、散热片贴附机	4,175.09	6.00%	否
4	Shibaura Mechatronics Corp. (芝浦)	内引脚接合机	3,830.00	5.50%	否
5	YouUS Cooperation	卷带传输机	2,897.37	4.16%	否
6	ASM Pacific (Hong Kong) Limited	激光开槽机	965.79	1.39%	否
7	广东奥普特科技股份有限公司	内引脚接合自动检验模组	688.70	0.99%	否
8	苏元贸易(上海)有限公司	风管温度焓值传感器、风管温度露点传感器等	512.43	0.74%	否
9	DISCO CORPORATION (迪思科科技)	切割机	491.16	0.71%	是
10	NIDEC-READ CORPORATION	晶圆立体检查仪	394.22	0.57%	否
合计			<b>60,831.39</b>	<b>87.38%</b>	

注 1: Advantest (爱德万) 包括 Advantest Corporation 和 Advantest Taiwan Inc.。

注 2: 供应商重叠情况由顾邦科技提供。

报告期内, 公司前十大设备供应商与顾邦科技设备采购占比超过 5% 的供应商重叠的有爱德万 (证券代码: 6857.T)、东京精密 (证券代码: 7729.T)、迪思科科技 (证券代码: 6246.T), 上述供应商均为全球领先的集成电路设备厂商, 且均为日本上市公司, 相关设备市场占有率较高。

## 2、结合公司产业链上下游的市场集中度情况, 分析重叠供应商的合理性

发行人与顾邦科技存在重叠供应商的主要原因系: 半导体行业对原材料和设备有较高要求, 半导体原材料和设备行业市场集中度较高, 行业领先的供应商在产品质量、供货稳定性、售后服务等方面具有优势。

材料方面, 根据光洋科 (1785.TWO) 2021 年年度报告及官网, 光洋科成

立于 1978 年，在贵金属回收、特殊成型、加工以及销售领域已有 40 年经验，产品包括靶材、贵金属化学材料等，在集成电路及电子产业链中具有较高的知名度，相关领域市场占有率较高，如在半导体产业之 III-V 半导体及金凸块制造领域所需的贵金属材料领域，光洋科在中国台湾的市场占有率高达 50% 以上。

设备方面，根据研究报告《中信建投电子 2022 年中期投资策略报告：供需呈现结构性差异，国产化仍是长期主线》，泰瑞达和爱德万测试机市场份额分别为 47% 和 35%，合计超过 80%；东京电子和东京精密探针台市场份额分别为 46% 和 42%，合计接近 90%；根据研究报告《民生证券半导体设备系列一：本土设备商开启多年向上周期》，2017 年迪思科科技晶圆切割机市场份额达到 80%。

根据同行业可比公司汇成股份公开披露的资料，其主要供应商包括光洋化学、爱德万、东京精密、迪思科科技、翔胜企业、芝浦等，亦与公司及硕邦科技存在重叠；另根据同行业可比公司南茂科技的年度报告，光洋科为其第一大供应商。因此，公司与硕邦科技存在部分供应商重叠符合行业特点。

从服务半径、运输成本、使用安全性、国产化替代等角度考虑，发行人的供应商与硕邦科技的供应商存在差异，且该等差异预计会随着硕中科技中国大陆地区业务量的提升以及封测设备国产化的不断提高而日趋增加。

### **3、说明公司与相关重叠供应商交易价格的公允性**

报告期内，公司与主要重叠供应商光洋科技（双方交易主体不同，出于谨慎考虑，作为重叠供应商进行分析）、爱德万、东京精密、迪思科科技交易价格的公允性分析如下：

#### **（1）光洋科技**

报告期内，公司向光洋科技的采购金额分别为 6,972.46 万元、17,153.63 万元和 21,812.23 万元，其中金盐采购金额分别为 6,521.46 万元、15,187.49 万元和 20,425.37 万元，占比分别为 93.53%、88.54% 和 93.64%。

报告期内，公司向光洋科技和非重叠供应商美泰乐科技（苏州）有限公司（以下简称“美泰乐”）采购金盐的单价对比如下：

单位：元/克

项目	2021 年度		2020 年度		2019 年度	
	光洋科技	美泰乐	光洋科技	美泰乐	光洋科技	美泰乐
金盐	227.96	229.20	235.83	230.95	192.37	-

如上表所示，公司向光洋科技和非重叠供应商美泰乐的采购单价差异较小。

## (2) 爱德万

报告期内，公司对爱德万的采购金额分别为 41,128.16 万元、4,682.68 万元和 28,381.27 万元，主要为测试机。由于爱德万在高端测试机台市场份额较高，公司未向其他供应商采购同类型测试机台。

报告期各期，公司向爱德万采购测试机的平均采购单价变动情况如下：

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
平均采购单价	-3.24%	4.00%	/

因向主要设备供应商的采购单价涉及商业秘密，公司无法获取硕邦科技及其他封测厂商向爱德万采购测试机的平均单价。根据同行业可比公司汇成股份披露的报告期内各季度的测试机到货数量和到货金额测算，其测试机平均采购单价区间为 121.86 万元至 596.78 万元，因测试机型号不同，采购单价差异较大，汇成股份高端测试机平均采购单价亦位于公司向爱德万采购测试机的单价区间内。

报告期内，公司自主与爱德万进行议价，平均采购单价因型号差异和市场供求情况存在一定波动，但整体波动较小。

## (3) 东京精密

报告期内，公司对东京精密的采购金额分别为 5,748.48 万元、5,507.70 万元和 4,496.24 万元，主要为探针台。报告期内，由于东京精密在高端探针台市场份额较高，公司未向其他供应商采购同类型探针台。

报告期各期，公司向东京精密采购探针台的平均采购单价变动情况如下：

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
平均采购单价	-7.05%	-16.50%	/

因向主要设备供应商的采购单价涉及商业秘密，公司无法获取硕邦科技及

其他封测厂商向东京精密采购探针台的平均单价。根据同行业可比公司汇成股份披露的报告期内各季度的探针台到货数量和到货金额测算，其探针台平均采购单价区间为 100.56 万元至 152.77 万元，因探针台型号不同，采购单价差异较大，其中可同时用于多种平台的探针台定价相对较高。

报告期内，公司自主与东京精密进行议价，平均采购单价因型号差异和市场供求情况存在一定波动。2019 年平均采购单价较高，主要是由于设备型号不同，2019 年采购的大部分探针台可同时适用于 ND4（S）和 ND4（C）两种平台，而 2020 年和 2021 年采购的探针台只适用于一种平台。2020 年和 2021 年，平均采购单价波动较小。

#### （4）迪思科科技

报告期内，公司对迪思科科技的采购金额分别为 491.16 万元、2,194.97 万元和 931.89 万元，主要为晶圆切割机。报告期内，由于迪思科科技在晶圆切割机市场份额较高，公司未向其他供应商采购同类型晶圆切割机。

报告期各期，公司向迪思科科技采购晶圆切割机的平均采购单价变动情况如下：

项目	2021 年度	2020 年度	2019 年度
平均采购单价	-5.83%	9.65%	/

因向主要设备供应商的采购单价涉及商业秘密，公司无法获取硕邦科技及其他封测厂商向迪思科科技采购晶圆切割机的平均单价。根据同行业可比公司汇成股份披露的报告期内各季度的晶圆切割机到货数量和到货金额测算，其晶圆切割机平均采购单价区间为 109.63 万元至 236.86 万元，因晶圆切割机型号不同，采购单价差异较大，其 2019 年和 2020 年平均采购单价与公司平均采购单价不存在重大差异。

报告期内，公司自主与迪思科科技进行议价，平均采购单价因型号差异和市场供求情况存在一定波动，但整体波动较小。

综上，爱德万、东京精密、迪思科科技作为全球领先的集成电路设备厂商，均为日本上市公司，且均具有完善且市场化的定价体系，不存在通过非公允定价帮助公司与硕邦科技进行利益输送的情况。报告期内，公司与上述重叠供应

商均自主进行议价，各期平均采购单价存在一定差异，主要系各期采购产品型号和市场供求情况不同，交易价格具有公允性。

**四、报告期内，子公司苏州硕中的经营情况及占母公司业绩的比重，母子公司之间的分工定位、业务布局、产线安排，发行人能否实现对子公司的有效管理及协同发展**

**（一）报告期内，子公司苏州硕中的经营情况及占母公司业绩的比重**

为充分发挥产业集群协同效应、契合当地政府对集成电路产业的布局政策，硕中科技于 2018 年在合肥市成立，苏州硕中同年成为硕中科技子公司。报告期内，除募投项目相关前期准备工作外，母公司硕中科技尚未实际开展业务。

**（二）母子公司之间的分工定位、业务布局、产线安排**

根据规划，母公司硕中科技是承载公司未来业务发展的重要经营主体，也是本次募投项目“硕中先进封装测试生产基地项目”及“硕中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目”的实施主体，未来将充分利用合肥当地显示产业链的集群效应以及集成电路领域的人才优势，专注于 12 吋晶圆的显示驱动芯片全制程封装与测试，特别是应用于大尺寸面板的 COF 封装业务，中远期规划将成为公司显示业务的主要生产基地。

苏州硕中为发行人目前的主要生产所在地，下设 Fab1、Fab2 两座现代化封测工厂，其中 Fab2 主要进行前段的凸块制造与晶圆测试工序，Fab1 主要进行后段先进封装工序。未来，除对现有产线及生产工艺进行技术改造外，苏州硕中着力于 12 吋晶圆各类金属凸块技术的深度研发和产业化，大力发展基于第二代、第三代半导体材料的凸块制造与封测业务，加快电源管理芯片、射频前端芯片等非显示类芯片先进封测业务的导入和量产，中远期规划将成为公司非显示业务的承载主体。

**（三）发行人能否实现对子公司的有效管理及协同发展**

**1、发行人能够实现对子公司的有效管理**

为实现对子公司的有效管理，发行人制定了《子公司管理制度》，并在现行有效的《公司章程》《总经理工作细则》《对外担保管理办法》《对外投资管理办

法》《关联交易管理办法》《内部审计制度》等规章制度中对子公司的内控、人员、财务方面作出了相关规定，将子公司的管控纳入发行人整体系统化管控的制度框架内。主要体现在下述方面：

（1）子公司的经营及发展规划必须服从和服务于公司的发展战略和总体规划，在公司发展规划框架下，细化和完善自身规划，制定经营计划，并根据公司的风险管理政策，结合自身实际业务，建立风险管理程序。

（2）公司通过委派或选举董事、监事和高级管理人员等办法实现对子公司的治理监控。子公司董事、监事由公司董事提名，经公司董事会选举委派，并经子公司股东会（或股东）选举产生；子公司高级管理人员由公司总经理提名，并经子公司董事会聘任。

（3）子公司发生对外投资、关联交易、收购、出售资产等重大事项，除应及时报告董事会外，依据法律法规、部门规章、自律性规则及《公司章程》、公司相关规章制度规定的权限，应当提交公司董事会审议的，提交公司董事会审议；应当提交股东大会审议的，提交股东大会审议，并按照公司《信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定进行信息披露。

（4）子公司应当按照公司编制合并会计报表和对外披露财务会计信息的要求，以及公司财务部对报送内容和时间的要求，及时报送财务报表和提供会计资料。

（5）公司定期或不定期实施对子公司的审计监督。子公司在接到审计通知后，应当做好接受审计的准备，并在审计过程中给予主动配合。

综上，发行人对子公司的内部管理制度健全，并得到了有效执行，能够实现对子公司的有效管理。

## **2、发行人能够实现对子公司的协同发展**

根据《中国半导体行业发展状况报告》（2021年版），长三角地区是目前中国大陆集成电路产业的主要集群区域，已形成了芯片研发、设计、制造、封装测试以及相关物料和设备等较完整的集成电路产业链。

发行人所在地合肥市近年来在集成电路领域形成了一定的规模效应，目前

已成为中国大陆集成电路产业发展最快、成效最显著的城市之一。合肥市被国家发改委和工信部列为集成电路产业重点发展城市，也是全国首个“海峡两岸集成电路产业合作试验区”和首批“国家集成电路战略性新兴产业集群”，据不完全统计，2022年初合肥市拥有集成电路企业超300家，聚集从业人员超2.5万人，晶合集成、京东方、维信诺等与公司相关的上下游企业均在合肥有所布局。

基于上述背景，发行人制定了关于母子公司的发展规划。根据发行人中短期规划，母公司将作为未来显示业务产能扩张的主要实施主体，并且聚焦于大尺寸COF封装，而苏州顾中在扩充部分显示业务瓶颈产能的同时，也将着力于非显示业务的扩张。在此阶段，发行人将根据两地的实际产能情况、订单情况、客户地理位置等方面合理安排两地生产，并实施统一的管理，充分发挥地处“双城”的地域和产业集群优势，实现协同发展。根据发行人中远期规划，由于苏州顾中具有非显示业务的实施经验和人才，其未来主要专注于非显示业务，显示业务将逐步转移至母公司，母子公司分工更加明确。

综上所述，苏州顾中经营及发展规划将在发行人的发展战略和总体规划框架下得到进一步细化和完善，发行人能够实现对子公司实施有效管理及协同发展。

## **【核查情况】**

### **一、核查程序**

针对上述事项，本所律师履行了以下核查程序：

1、查阅了顾邦科技官方网站、年度报告等公开信息，取得顾邦科技提供的相关资料并访谈了顾邦科技董事长，了解顾邦科技的主营业务、核心技术、下游应用领域、客户供应商构成等；

2、取得发行人出具的说明文件，访谈了发行人总经理，了解发行人未来业务发展战略、产品线布局、市场拓展安排等情况，以及发行人与顾邦科技之间业务的相似性和差异性，确认双方是否存在业务及销售区域的划分约定，并分析相关情况是否对发行人未来业务发展产生限制或不利影响；

3、访谈发行人总经理、研发总监、人事总监、财务总监，取得发行人的专

利证书、核心技术明细表、员工花名册、土地和房屋产权证书、主要机器设备采购合同、主要供应商和客户的采购和销售合同、银行对账单等，确认发行人在业务、技术、人员、资产、采购及销售渠道、资金等方面是否存在对顾邦科技的依赖；

4、对发行人主要供应商和客户进行访谈和函证，网络查询主要供应商和客户的公开资料，确认主要供应商和客户的市场占有率情况，取得顾邦科技对主要客户及供应商重叠情况的确认，并分析重叠客户及供应商的原因及合理性；取得发行人采购和销售明细表，对比分析发行人与相关重叠客户、供应商交易价格和非重叠客户、供应商交易价格或其他可比价格之间的差异情况，判断相关交易价格是否公允；

5、访谈发行人总经理、董事会秘书，确认发行人母子公司之间的分工定位、业务布局、产线安排，取得发行人子公司相关管理制度，确认发行人能否实现对子公司的有效管理及协同发展；

6、取得了顾中控股（香港）及其控股股东顾邦科技出具的《关于保持业务独立性的承诺函》。

## 二、核查意见

经核查，本所认为：

1、虽然公司与顾邦科技从事相似业务，但在业务发展历程、封装技术、封装产品、销售区域及客户结构等方面均有所差异。双方在资产、人员、业务、财务和机构等方面保持独立，不存在业务及销售区域的划分约定，该等情形不会对公司未来业务发展产生限制或不利影响；

2、顾邦科技在发行人成立后不存在向公司提供技术指导支持或实际控制公司管理层并主导公司的生产经营与技术研发的情况，发行人在业务、技术、人员、资产、采购及销售渠道、资金等方面均不存在对顾邦科技的依赖，且顾中控股（香港）及其控股股东顾邦科技已出具《关于保持业务独立性的承诺函》；

3、发行人与顾邦科技存在重叠客户及供应商具有合理性，相关重叠客户及供应商均为各自领域的领先企业且均为上市公司，具有完善且市场化的定价体系，不存在通过非公允定价帮助公司与顾邦科技进行利益输送的情况，发行人

与相关重叠客户、供应商交易价格公允；

4、发行人母公司是公司未来业务发展的重要经营主体和本次首发上市募投项目的实施主体之一，报告期内尚未实际开展业务。发行人母子公司之间的分工定位、业务布局和产线安排合理，发行人能够实现对于子公司的有效管理及协同发展。

#### 问题 9. 关于关联交易

根据申报材料：（1）公司间接股东奕斯伟投资与前五大客户奕斯伟计算为北京奕伟斯集团同一控制下的企业。报告期内，公司与奕斯伟计算的关联销售金额分别为 166.33 万元、1,586.29 万元和 6,312.61 万元，呈不断上升趋势，申报材料对有关交易价格的公允性论述不够充分；（2）报告期内，公司与硕邦科技关联采购金额分别为 889.88 万元、524.47 万元和 719.98 万元，主要系二手探针卡及设备、Tray 盘、卷带采购。

请发行人说明：（1）发行人与奕斯伟计算及其下属公司的合作背景及时间，关联交易的必要性，未来交易规范及占比计划等情况，该等交易是否与奕斯伟投资入股发行人有关，奕斯伟投资入股前后的交易金额、交易价格、交易条件是否发生变化，双方是否存在业绩承诺或类似安排；（2）区分不同产品与服务，并结合从其他渠道采购销售相同或近似产品的价格，比较分析与奕斯伟计算及其下属公司、硕邦科技之间关联交易价格的公允性。

请保荐机构、发行人律师对上述事项核查并发表明确意见。

回复：

## 【发行人说明】

一、发行人与奕斯伟计算及其下属公司的合作背景及时间，关联交易的必要性，未来交易规范及占比计划等情况，该等交易是否与奕斯伟投资入股发行人有关，奕斯伟投资入股前后的交易金额、交易价格、交易条件是否发生变化，双方是否存在业绩承诺或类似安排

（一）发行人与奕斯伟计算及其下属公司的合作背景及时间，关联交易的必要性，未来交易规范及占比计划等情况

### 1、合作背景及时间

奕斯伟计算及下属公司系国内知名集成电路领域产品和服务提供商奕斯伟集团内显示驱动芯片设计领域的业务经营主体。奕斯伟计算下属公司合肥奕斯伟集成电路有限公司（以下简称“合肥奕斯伟”）成立于 2016 年 8 月，经过两年的积累与发展，合肥奕斯伟开始积极寻求中国境内封装测试服务的合作厂商。而公司是境内少数具备显示驱动芯片封装测试能力的厂商之一，在国内市场具有较强的竞争力，奕斯伟计算及下属公司（以下简称“奕斯伟计算”）经营所需封装测试服务（主要包括 Gold Bumping、CP、COF 等制程）与公司主营业务相匹配。经合肥奕斯伟相关采购部门调研，公司产品良率较高，技术具有一定领先性，新产品定制响应较快，客户服务及时。因此，2018 年 8 月，合肥奕斯伟与公司通过商务洽谈达成业务合作关系。

### 2、关联交易的必要性

随着显示行业产业链逐步向境内转移，包括下游面板厂、上游显示驱动设计公司业务均有较大发展，公司内销业务占比也逐步提升。根据 Omdia 的统计，奕斯伟计算是大尺寸显示驱动芯片市场 2021 年占有率最高的境内显示驱动芯片设计公司。奕斯伟计算与公司系产业链上下游关系，双方开展业务且规模逐年上升与市场整体发展趋势和各自的行业地位相匹配，符合商业逻辑，具有必要性与合理性。

### 3、未来交易规范及占比计划等情况

在国家政策、资金以及技术等全面支持下，国产面板龙头厂商快速崛起，带动中国大陆亦成为全球显示驱动芯片的重要市场。受中美贸易战影响，显示

驱动芯片产业国产替代趋势加快，随着国产面板龙头厂商在全球面板产业链中话语权不断增强，对供应链安全需求日益迫切，扶持中国大陆显示驱动芯片厂商建立生态联盟的动力强劲，有力推动了中国大陆显示驱动芯片市场快速发展。未来，随着中国大陆显示芯片厂商技术实力的不断提升，以及面板龙头厂商的市场地位进一步加强，中国大陆显示驱动芯片产业将继续保持快速发展趋势。

因此，未来随着奕斯伟计算及其下属公司的业务规模和市场占有率不断提升，其显示驱动芯片封测服务需求亦随之增加。2022年，公司与奕斯伟计算及其下属公司之间的关联交易预计将较报告期有所增长，占比预计也将有所上升。

针对上述关联交易，公司将采取以下措施进行规范：

(1) 严格执行《公司章程》《股东大会议事规则》《关联交易管理办法》等相关制度中关于关联交易的规定；(2) 严格履行关联交易决策、回避表决等公允决策程序；(3) 确保关联交易价格的公允性、批准程序的合规性，最大程度的保护股东利益；(4) 保证相关交易按市场化原则和公允价格进行公平操作；(5) 充分发挥独立董事的作用，确保关联交易价格的公允性、批准程序的合法、合规性，最大程度的保护本公司股东利益。

**(二) 该等交易是否与奕斯伟投资入股发行人有关，奕斯伟投资入股前后的交易金额、交易价格、交易条件是否发生变化，双方是否存在业绩承诺或类似安排**

出于对公司在显示驱动芯片封测行业市场地位和技术实力的认可，同时为了保障其自身的供应链安全，奕斯伟集团联合芯屏基金共同投资设立封测合伙，并通过合肥颀中控股受让颀中控股（香港）所持公司部分股权。

奕斯伟计算全资子公司合肥奕斯伟成立于2016年，经过2年的研发和积累，合肥奕斯伟显示驱动芯片业务将于2018年投入量产并具备一定的业务规模。基于前期对公司相关产品服务的调研验证，合肥奕斯伟选择与公司于2018年8月正式建立合作关系。因此，双方合作主要是建立在奕斯伟计算自身对显示驱动芯片封测服务的实际需求以及公司具备相应技术实力的基础上，且公司封测后的产品亦需得到下游面板厂的认可。因此，奕斯伟投资入股发行人以及奕斯伟计算与公司发生交易均体现了奕斯伟集团对于颀中科技市场地位和业务前景的

认可，但两者之间系独立决策的经济行为，并无必然关系或互为条件。

根据奕斯伟投资和芯屏基金共同出具的《确认函》，确认其作为合肥硕中控股及封测合伙的出资人，对硕中科技的股权投资不存在任何业绩承诺或类似安排。

综上，相关交易与奕斯伟投资入股公司系独立决策的经济行为，并无必然关系或互为条件。奕斯伟投资与发行人之间不存在业绩承诺或类似安排。

二、区分不同产品与服务，并结合从其他渠道采购销售相同或近似产品的价格，比较分析与奕斯伟计算及其下属公司、硕邦科技之间关联交易价格的公允性。

#### （一）与奕斯伟计算及其下属公司之间关联交易价格的公允性

报告期各期，发行人与奕斯伟计算及其下属公司的封装测试销售收入金额分别为 166.33 万元、1,586.29 万元和 6,312.61 万元，占当期营业收入的比例分别为 0.25%、1.83%和 4.78%，关联交易金额占比较小，关联销售产品主要为 12 吋显示驱动芯片薄膜覆晶封装（COF）产品，应用领域为高清电视（TV）。对比非关联客户同类产品销售均价如下：

制程	吋别	客户名称	2021 年度	2020 年度	2019 年度	定价差异原因
Gold Bumping	12	非关联客户 1	-29.96%	-26.88%	/	报告期内，不同客户销售均价存在差异主要是由于产品规格不同，黄金使用量存在差异，奕斯伟相关产品单片黄金用量相对较多。
		非关联客户 2	10.04%	0.35%	/	
		非关联客户 3	14.72%	/	/	
CP	12	非关联客户 1	20.98%	55.85%	/	报告期内，不同客户销售均价存在差异主要是由于产品规格不同，使用的测试设备不同，以及因测试程序设计不同导致单片所需的测试时长不同；奕斯伟销售均价处于中间水平。
		非关联客户 2	-46.89%	-38.83%	/	
		非关联客户 3	108.70%	/	/	
COF	-	非关联客户 1	-5.42%	-11.62%	-12.71%	报告期内，不同客户销售均价存在差异主要是由于 FT 测试使用测试设备不同，测试程序设计不同；且公司综合考虑客户订单数量差异，确
		非关联客户 2	22.36%	34.63%	24.64%	

制程	时别	客户名称	2021 年度	2020 年度	2019 年度	定价差异原因
		非关联客户 3	8.10%	/	/	定不同的销售单价，奕斯伟销售均价与非关联主要客户不存在显著差异。

注：表格中差异率=（非重叠客户同类产品销售均价-重叠客户同类产品销售均价）/重叠客户同类产品销售均价，下同。

如上表所示，公司自主与上述客户进行议价，相关定价方式遵循行业惯例，针对不同客户的定价受封装工艺、测试程序等要求不同的影响存在差异，具有合理性。

综上，报告期内，公司与奕斯伟计算交易采取市场化原则定价，销售均价与非关联第三方之间的差异原因合理，定价具有公允性。

## （二）与顾邦科技之间关联交易价格的公允性

报告期内，公司与顾邦科技关联采购金额分别为 889.88 万元、524.47 万元和 719.98 万元，主要系二手探针卡及设备、Tray 盘和卷带采购，占报告期各期营业成本的比例分别为 2.02%、0.91%和 0.92%，占比较低。相关交易的背景和定价方式如下：

产品类型	交易必要性	定价方式
二手探针卡	客户出于特定产品型号要求及降低采购成本考虑，指定公司向顾邦科技采购特定型号的二手探针卡。	购销双方议价，定价依据主要为探针长度、PIN 数、损耗程度等。
二手设备	由于新设备交付周期较长，且单价较高。公司为尽快满足业务增长需求同时降低采购成本，向顾邦科技采购部分二手设备。	购销双方议价，定价依据主要为新设备采购单价、成新率等。
Tray 盘	根据客户需求采购 Tray 盘。顾邦科技高雄分公司为 Tray 盘供应商，其产品能够满足客户需求且价格合理。	购销双方议价，定价依据包括尺寸、单面或双面使用等。
卷带	根据客户需求采购卷带。顾邦科技高雄分公司为卷带供应商，其产品能够满足客户需求且价格合理。	购销双方议价，定价依据为卷带宽度、传动孔数量、最小间距等。

### 1、二手探针卡

探针卡（Probe Card）是晶圆测试的必备工具，通过探针与晶圆上的每个晶粒接触来检测其电气特性。探针卡属于生产耗材，主要由探针和 PCB 板构成，使用过程中探针会逐渐损耗缩短，直至达到探针报废长度。因此，二手探针卡

主要以全新探针卡价格为基准，依据探针的损耗率进行折价。

报告期内，发行人向颀邦科技和非关联第三方采购对比情况如下：

单位：万元、个

供应商名称	采购金额	采购数量	平均采购单价	采购单价区间
颀邦科技	1,221.87	92	13.28	2.71-30.40
南茂科技	428.01	21	20.38	3.86-46.95

由于二手探针卡定价主要以全新探针卡价格为基准，结合探针损耗率进行折价，故针对不同探针损耗率水平的二手探针卡单位定价不同。发行人主要根据探针损耗率与对方协商确定二手探针卡的价格，定价符合行业惯例，具有公允性。

## 2、二手设备

发行人仅于 2019 年因生产经营需要，向颀邦科技采购少量挑拣机、视觉检查机、紫外线照射机等二手设备，采购金额较小，结合设备已使用年限，采取市场化原则定价。

报告期内，发行人自颀邦科技与非关联第三方购买二手设备的对比情况如下：

序号	供应商名称	产品名称	采购数量（台）	采购单价（万元）
1	颀邦科技	挑拣机 GPMKS-812	4	28.22
2		视觉检查机 Vi-4303	1	183.65
3		紫外线照射机 PC-10020-LT	1	22.99
4	京隆科技	挑拣机 KS-812	4	18.75
5		视觉检查机 ACIS-105	6	10.52

上表中，视觉检查机 Vi-4303 用于对晶圆切割后的每颗芯片进行光学检查，生成良品、不良品地图，检出精度小于 5 $\mu$ m；而视觉检查机 ACIS-105 用于对挑拣到 Tray 盘内的芯片进行光学检查，再用取放臂挑走检出的不良品，放入良品，检出精度 10 $\mu$ m。两款设备用途不同、检出精度不同，因此在采购单价上差异较大。

由于上述二手设备型号和成新率情况不同，采购单价存在差异。发行人主

要参考二手设备的残值、市场紧缺程度、贸易条款与对方协商确定二手设备的价格，定价符合行业惯例，具有公允性。

### 3、Tray 盘

Tray 盘是用于承托晶粒（芯片）的托盘，是 COG 产品的重要原材料，其定价主要考虑尺寸、单面或双面使用等。

报告期内，发行人向颀邦科技和非关联第三方采购 Tray 盘对比情况如下：

单位：万元、万个、元/个

产品类型	供应商	采购金额	采购数量	单价
3 寸单面	颀邦科技股份有限公司高雄分公司	100.23	122.13	0.82
	HWA SHU ENTERPRISE CO.,LTD.	0.98	0.99	0.99
	NICHING INDUSTRIAL CORPORATION	312.30	354.69	0.88
	苏州原津光电有限公司	1,013.97	1,162.93	0.87
	原津工业股份有限公司	324.16	318.46	1.02
	合计	<b>1,751.63</b>	<b>1,959.20</b>	<b>0.89</b>
3 寸双面	颀邦科技股份有限公司高雄分公司	6.49	5.85	1.11
	苏州原津光电有限公司	9.81	10.12	0.97
	原津工业股份有限公司	8.08	6.96	1.16
	合计	<b>24.39</b>	<b>22.93</b>	<b>1.06</b>
4 寸单面	颀邦科技股份有限公司高雄分公司	170.14	54.73	3.11
	HWA SHU ENTERPRISE CO.,LTD.	2.95	1.05	2.81
	NICHING INDUSTRIAL CORPORATION	542.03	175.62	3.09
	苏州原津光电有限公司	341.66	121.77	2.81
	原津工业股份有限公司	660.20	214.40	3.08
	合计	<b>1,716.98</b>	<b>567.57</b>	<b>3.03</b>

报告期内，发行人向颀邦科技高雄分公司采购 Tray 盘的价格，与向其他非关联供应商采购价格不存在明显差异，相关定价公允。

### 4、卷带

卷带是连接显示芯片和终端产品的柔性封装基板，是薄膜覆晶封装（COF）的原材料，其定价主要考虑宽度、传动孔数量、最小间距等因素。

报告期内，发行人向颀邦科技和非关联第三方采购卷带对比情况如下：

单位：万元、万颗、元/颗

供应商名称	采购总金额	采购数量	平均采购单价	采购单价区间
硕邦科技股份有限公司高雄分公司	256.27	224.09	1.14	1.12-1.21
江苏上达半导体有限公司	384.95	285.00	1.35	0.85-1.35
易华电子股份有限公司	493.50	374.10	1.32	1.26-1.56

报告期内，发行人向硕邦科技采购的卷带平均单价与非关联第三方存在差异，主要是由于不同卷带产品的宽度、传动孔数量、最小间距等存在差异，其定价符合行业惯例，具有公允性。

综上所述，发行人与奕斯伟计算、硕邦科技报告期内关联交易金额及占比较低，相关定价符合行业惯例，关联交易价格具有公允性。

### 【核查情况】

#### 一、核查程序

针对上述事项，本所律师履行了以下核查程序：

- 1、访谈了奕斯伟计算及发行人相关业务经办人员，了解双方合作背景及时间；
- 2、访谈了发行人对奕斯伟集团业务经办人员，了解双方业务合作历史、未来交易规范及占比计划等情况；
- 3、取得并核查了发行人报告期内销售和采购明细表及相关原始凭证，统计报告期内各项服务的单价，以及发行人向各供应商采购各类材料、设备的单价；
- 4、取得并核查了发行人与硕邦科技、奕斯伟计算及其下属公司的交易订单及相关原始凭证，分析相关定价的公允性。

#### 二、核查意见

经核查，本所认为：

- 1、公司与奕斯伟计算及其下属公司的业务合作系合理商业背景下的交易行为，相关交易与奕斯伟投资入股公司系独立决策的经济行为，并无必然关系或互为条件；
- 2、奕斯伟投资与发行人之间不存在业绩承诺或类似安排；

3、发行人与奕斯伟计算、颀邦科技报告期内关联交易金额及占比较低，相关定价符合行业惯例，关联交易价格具有公允性。

#### 问题 11. 关于股东与股权变动

根据申报材料：（1）2021 年，芯动能基金将其所持发行人部分股权对外转让，受让方包括 2 名自然人股东及苏州融可源，公司部分董事、高管及其关联方持有苏州融可源份额。本次股权转让价格（46.7244 元/每美元注册资本）明显高于同期员工持股平台的入股价格（3.16 美元/每美元注册资本）；（2）CTC 是在英国开曼群岛注册设立并有效存续的公司，2018 年与合肥颀中控股、芯屏基金等主要股东一同入股发行人；（3）公司股东中无国有股东。

请发行人按照《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》的有关规定，补充披露新增股东的有关情况。

请发行人说明：（1）公司部分董事、高管通过苏州融可源而非通过持股平台持有发行人股份的原因及合理性，该董事、高管及其他 2 名自然人股东与芯动能基金及发行人前三大股东之间是否存在关联关系及其他利益安排，该董事、高管与苏州融可源其他合伙人的关系，苏州融可源、2 名自然人股东持有发行人的股份是否存在代持或其他利益安排；（2）CTC 公司的主营业务，2018 年与合肥颀中控股等主要股东同时入股发行人的原因，与公司主要股东之间是否存在关联关系、业务往来、代持或其他利益关系；（3）请结合《企业国有资产监督管理办法》《上市公司国有股东标识管理暂行办法》等规定，说明合肥颀中控股、芯屏基金等具有国资背景的股东是否属于国有股东，相关股东入股发行人及历次股权变动是否符合国资监管要求，是否应当办理国有股东标识。

请保荐机构、发行人律师对上述事项核查并发表明确意见。

#### 【发行人披露】

一、请发行人按照《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》的有关规定，补充披露新增股东的有关情况

发行人已按照《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》的有关规定于招股说明书“第五节 发行人基本情况”之“九、发行人的股本情况”之“（六）最近一年发行人新增股东情况”对新增股东的情况进行补充披露。

## 【发行人说明】

一、公司部分董事、高管通过苏州融可源而非通过持股平台持有发行人股份的原因及合理性，该董事、高管及其他 2 名自然人股东与芯动能基金及发行人前三大股东之间是否存在关联关系及其他利益安排，该董事、高管与苏州融可源其他合伙人的关系，苏州融可源、2 名自然人股东持有发行人的股份是否存在代持或其他利益安排；

### （一）部分董事、高管通过苏州融可源持股的原因及合理性

苏州融可源的合伙人中存在发行人的董事与高管，即发行人董事、总经理杨宗铭和副总经理张玲玲。2019 年 7 月，发行人进行员工股权激励，其中杨宗铭和张玲玲分别持有员工持股平台奕斯众志 9.04% 和 0.56% 的份额，奕斯众志持有发行人 3.25% 的股份。此后，发行人未进行其他员工股权激励。

2021 年 7 月，发行人股东芯动能基金拟转让其持有的发行人部分股权，发行人部分员工在知悉芯动能基金转让老股的意向后，基于对公司经营业绩和半导体产业前景的持续看好，通过苏州融可源认购发行人的部分股份，认购价格与同期外部投资者入股价格一致。

因此，上述董事、高管通过苏州融可源持股具有合理性。

（二）该董事、高管与其他 2 名自然人股东与芯动能基金及发行人前三大股东之间不存在关联关系及其他利益安排，该董事、高管与苏州融可源其他合伙人不存在关联关系

根据股东调查表和股东访谈，2021 年 7 月，芯动能基金拟寻求受让方转让发行人部分股权，经发行人员工或股东介绍，相关自然人均因看好发行人和半导体产业前景入股发行人。

杨宗铭、张玲玲及其他 2 名自然人股东徐瑛、庄丽与芯动能基金及发行人前三大股东之间不存在关联关系及其他利益安排；且杨宗铭、张玲玲与苏州融可源的其他合伙人之间亦不存在关联关系。

### （三）苏州融可源及两名自然人股东不存在股份代持或其他利益安排

根据股东访谈及相关出资凭证，苏州融可源及股东徐瑛、庄丽系真实持有

发行人股份，不存在股份代持或其他利益安排。

**二、CTC 公司的主营业务，2018 年与合肥顾中控股等主要股东同时入股发行人的原因，与公司主要股东之间是否存在关联关系、业务往来、代持或其他利益关系**

**（一）CTC 的主营业务**

根据 CTC 提供的资料，CTC 系在英国开曼群岛注册设立并有效存续的公司，其注册证书：GI-327712，其注册地址为：Suite 102, Cannon Place, North Sound Road, George Town, Grand Cayman KY1-9006, Cayman Island。CTC 的主营业务系投资平台，不直接开展实体业务，WONG, CHUN PEI（中文名：汪钧培）作为 CTC 的第一大股东和唯一董事，控制并管理 CTC 对外投资事宜。

**（二）2018 年 CTC 与合肥顾中控股等主要股东同时入股发行人的原因**

根据 CTC 提供的资料及股东访谈，CTC 的第一大股东汪钧培先生原为苏州顾中董事，对苏州顾中的经营情况及所处的半导体产业有着较为深刻的理解。汪钧培先生看好并积极推动发行人 2018 年引进合肥国资、产业合作伙伴奕斯伟作为战略投资人的入股行为，认同顾中科技未来的发展战略和前景。基于上述原因，汪钧培先生作为本次交易的重要参与者之一，其控制的 CTC 受让了顾中控股（香港）持有的发行人部分股权，与合肥顾中控股等主要股东同时入股发行人。

**（三）CTC 与公司主要股东不存在关联关系、业务往来、代持或其他利益关系**

根据股东调查表及股东访谈，CTC 与公司主要股东合肥顾中控股、顾中控股（香港）及芯屏基金不存在关联关系、业务往来、代持或其他利益关系。

三、请结合《企业国有资产监督交易管理办法》《上市公司国有股东标识管理暂行办法》等规定，说明合肥顾中控股、芯屏基金等具有国资背景的股东是否属于国有股东，相关股东入股发行人及历次股权变动是否符合国资监管要求，是否应当办理国有股东标识

(一) 发行人具有国资背景的股东情况

截至本补充法律意见书之一出具之日，发行人股东及持股情况如下：

序号	股东名称	持股数（万股）	持股比例（%）	是否具有国资背景
1	合肥顾中控股	39,712.72	40.15	是
2	顾中控股（香港）	30,238.97	30.57	否
3	芯屏基金	12,363.93	12.50	是
4	CTC	3,439.81	3.48	否
5	奕斯众志	3,214.33	3.25	否
6	徐瑛	1,836.78	1.86	否
7	芯动能基金	1,783.53	1.80	是
8	中信投资	706.46	0.71	是
9	日出投资	706.46	0.71	否
10	中青芯鑫	706.46	0.71	是
11	珠海华金领翊	635.81	0.64	是
12	奕斯众诚	634.69	0.64	否
13	青岛初芯海屏	565.16	0.57	是
14	苏州融可源	494.52	0.50	否
15	泉州常弘星越	423.87	0.43	否
16	宁波诚池	423.87	0.43	否
17	海宁艾克斯	282.58	0.29	是
18	庄丽	282.58	0.29	否
19	山南置立方	282.58	0.29	否
20	奕斯众力	97.97	0.10	否
21	珠海华金丰盈	70.65	0.07	是
合计		<b>98,903.73</b>	<b>100.00</b>	-

如上表所示，发行人股东中合肥顾中控股、芯屏基金、芯动能基金、中青芯鑫、中信投资、珠海华金领翊、青岛初芯海屏、海宁艾克斯、珠海华金丰盈具有国资背景。

## （二）相关股东是否属于国有股东，是否应当办理国有股东标识

### 1、相关股东基本情况

#### （1）合肥硕中控股

根据合肥硕中控股现行有效的《营业执照》，合肥硕中控股基本情况如下：

名称	合肥硕中科技控股有限公司
统一社会信用代码	91340100MA2RLAL27R
类型	其他有限责任公司
注册地址	合肥市新站区大禹路 98 号合肥奕斯伟材料技术有限公司 2 层办公区
法定代表人	左长云
注册资本	170,001.00 万元人民币
成立日期	2018-04-04
经营范围	股权投资；封测技术开发、技术咨询、技术服务；产品设计；半导体及光电子、电源、无线射频类元器件的开发、生产、封装、测试、销售及售后服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；设备的销售与租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本补充法律意见书之一出具之日，合肥硕中控股的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）
1	合肥奕斯伟封测投资中心合伙企业（有限合伙）	170,000.00	99.9994
2	合肥奕斯伟投资有限公司	1.00	0.0006
合计		<b>170,001.00</b>	<b>100.00</b>

合肥硕中控股的控股股东合肥奕斯伟封测投资中心合伙企业（有限合伙）的出资结构如下：

序号	合伙人名称	认缴出资额（万元）	出资比例（%）
1	合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）	193,200.00	99.4851
2	合肥奕斯伟投资有限公司	1,000.00	0.5149
合计		<b>194,200.00</b>	<b>100.00</b>

合肥奕斯伟封测投资中心合伙企业（有限合伙）出资人之一芯屏基金系国有出资的合伙企业，合肥市建设投资控股（集团）有限公司直接持有芯屏基金 47.44% 的出资额，并通过合肥建投资本管理有限公司控制芯屏基金，故合肥硕

中控股具有国资背景。

## (2) 芯屏基金

根据芯屏基金现行有效的《营业执照》，芯屏基金的基本情况如下：

名称	合肥芯屏产业投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码	91340111MA2MRYQY4Y
类型	有限合伙企业
注册地址	合肥市包河区武汉路 229 号
执行事务合伙人	合肥建投资本管理有限公司
成立日期	2016-01-18
注册资本	2,443,125.00 万元人民币
经营范围	投资管理、资产管理；投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本补充法律意见书之一出具之日，芯屏基金的出资结构如下：

序号	合伙人类型	一级合伙人	出资比例 (%)	二级股东/合伙人	出资比例 (%)
1	普通合伙人	合肥建投资本管理有限公司	0.04	合肥市建设投资控股（集团）有限公司	70.83
				合肥德轩投资管理有限公司	29.17
2	有限合伙人	合肥市建设投资控股（集团）有限公司	47.44	合肥市人民政府国有资产监督管理委员会	100.00
3	有限合伙人	合肥瀚和投资合伙企业（有限合伙）	42.29	合肥市建设投资控股（集团）有限公司	99.82
				合肥德轩投资管理有限公司	0.18
4	有限合伙人	合肥瀚屏投资合伙企业（有限合伙）	10.23	合肥市建设投资控股（集团）有限公司	99.70
				合肥德轩投资管理有限公司	0.30

芯屏基金系国有出资的合伙企业，合肥市建设投资控股（集团）有限公司直接持有芯屏基金 47.44% 的出资份额，并通过合肥建投资本管理有限公司控制芯屏基金。合肥市建设投资控股（集团）有限公司系合肥市人民政府国有资产监督管理委员会持股 100% 的企业。

## (3) 芯动能基金

根据芯动能基金现行有效的《营业执照》，芯动能基金的基本情况如下：

名称	北京芯动能投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码	91110000355227570L
类型	有限合伙企业
注册资本	401,650.00 万元人民币
执行事务合伙人	北京益辰奇点投资中心（有限合伙）
成立日期	2015-08-21
住所	北京市北京经济技术开发区科创十四街 99 号 33 幢 D 栋二层 2232 号
经营范围	非证券业务的投资、投资管理、咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品的交易活动；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益。”企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至本补充法律意见书之一出具之日，芯动能基金的出资结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	北京益辰奇点投资中心（有限合伙）	普通合伙人	100,000.00	24.90
2	国家集成电路产业投资基金股份有限公司	有限合伙人	150,000.00	37.35
3	京东方科技集团股份有限公司	有限合伙人	150,000.00	37.35
4	北京亦庄国际新兴产业投资中心（有限合伙）	有限合伙人	1,650.00	0.41
合计			<b>401,650.00</b>	<b>100.00</b>

根据股东穿透情况，上述四名合伙人具有国资背景。

#### （4）中青芯鑫

根据中青芯鑫现行有效的《营业执照》，中青芯鑫的基本情况如下：

名称	中青芯鑫鼎橡（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91310115MA1K4LA778
企业类型	有限合伙企业
注册资本	55,100.00 万元人民币
执行事务合伙人	宁波梅山保税港区鑫芯股权投资合伙企业（有限合伙）
成立日期	2020-08-28
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区富特西三路 77 号 6 幢 2 层 202 室

经营范围	一般项目：企业管理咨询、商务信息咨询，会议及展览服务，企业形象策划，公关活动策划，工艺品（象牙及其制品除外）、计算机软件及辅助设备的销售，货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
------	--

截至本补充法律意见书之一出具之日，中青芯鑫的出资结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	芯鑫融资租赁（北京）有限责任公司	有限合伙人	30,000.00	54.45
2	中青芯鑫（苏州工业园区）资产管理有限责任公司	有限合伙人	10,000.00	18.15
3	刘志忠	有限合伙人	5,000.00	9.07
4	李天思	有限合伙人	5,000.00	9.07
5	裴红伟	有限合伙人	5,000.00	9.07
6	宁波梅山保税港区鑫芯股权投资合伙企业（有限合伙）	普通合伙人	100.00	0.18
合计			<b>55,100.00</b>	<b>100.00</b>

根据股东穿透情况，上述合伙人中芯鑫融资租赁（北京）有限责任公司、中青芯鑫（苏州工业园区）资产管理有限责任公司及宁波梅山保税港区鑫芯股权投资合伙企业（有限合伙）具有国资背景。

### （5）中信投资

根据中信投资现行有效的《营业执照》，中信投资的基本情况如下：

名称	中信证券投资有限公司
统一社会信用代码	91370212591286847J
类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册资本	1,400,000.00 万元人民币
法定代表人	方浩
成立日期	2012-04-01
注册地址	青岛市崂山区深圳路 222 号国际金融广场 1 号楼 2001 户
经营范围	金融产品投资，证券投资，股权投资（以上范围需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本补充法律意见书之一出具之日，中信投资的股权结构如下：

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
1	中信证券股份有限公司	1,400,000.00	100.00

序号	股东名称	出资额（万元）	出资比例（%）
	合计	1,400,000.00	100.00

根据股东穿透情况，中信证券股份有限公司具有国资背景。

#### （6）珠海华金领翊

根据珠海华金领翊现行有效的《营业执照》，珠海华金领翊的基本情况如下：

名称	珠海华金领翊新兴科技产业投资基金（有限合伙）
统一社会信用代码	91440400MA5612AW8R
类型	有限合伙企业
注册资本	140,100.00 万元
执行事务合伙人	珠海华金领创基金管理有限公司
成立日期	2021-03-03
营业期限	2021-03-03 至 2028-03-02
注册地址	珠海市横琴新区环岛东路 1889 号 17 栋 201 室-1083 号（集中办公区）
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本补充法律意见书之一出具之日，珠海华金领翊的出资结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	珠海华金阿尔法五号股权投资基金合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	100,000.00	71.38
2	珠海发展投资基金二期（有限合伙）	有限合伙人	40,000.00	28.55
3	珠海华金领创基金管理有限公司	普通合伙人	100.00	0.07
	合计		140,100.00	100.00

根据股东穿透情况，上述三名合伙人具有国资背景。

#### （7）青岛初芯海屏

根据青岛初芯海屏现行有效的《营业执照》，青岛初芯海屏的基本情况如下：

名称	青岛初芯海屏股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91370211MA3UJPBM11
类型	有限合伙企业
注册资本	100,000.00 万元人民币

执行事务合伙人	青岛芯屏投资管理有限公司
成立日期	2020-12-09
注册地址	山东省青岛市黄岛区灵山卫街道办事处胶州湾东路 2566 号
经营范围	一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至本补充法律意见书之一出具之日，青岛初芯海屏的出资结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	青岛海控集团金融控股有限公司	有限合伙人	30,000.00	30.00
2	青岛海发控股发展有限公司	有限合伙人	28,000.00	28.00
3	青岛融合金控投资集团有限公司	有限合伙人	10,000.00	10.00
4	青岛市市级创业投资引导基金管理中心	有限合伙人	10,000.00	10.00
5	城发集团（青岛）产业资本管理有限公司	有限合伙人	10,000.00	10.00
6	北京海林致远投资中心（有限合伙）	有限合伙人	8,000.00	8.00
7	青岛芯屏投资管理有限公司	普通合伙人	2,000.00	2.00
8	北京英飞海林投资中心（有限合伙）	有限合伙人	2,000.00	2.00
合计			<b>100,000.00</b>	<b>100.00</b>

根据股东穿透情况，上述七名有限合伙人具有国资背景。

#### （8）海宁艾克斯

根据海宁艾克斯现行有效的《营业执照》，海宁艾克斯的基本情况如下：

名称	海宁艾克斯光谷创新股权投资合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91330481MA2JFG767C
类型	有限合伙企业
注册资本	50,000.00 万元
执行事务合伙人	海宁艾克斯光谷股权投资管理有限公司
成立日期	2020-12-08
注册地址	浙江省嘉兴市海宁市海昌街道海宁经济开发区芯中路 8 号 1 幢 355 室
经营范围	一般项目：股权投资（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

截至本补充法律意见书之一出具之日，海宁艾克斯的出资结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额 (万元)	出资比例 (%)
1	浙江钱塘江投资开发有限公司	有限合伙人	25,000.00	50.00
2	海宁市泛半导体产业投资有限公司	有限合伙人	15,000.00	30.00
3	上海奕兆企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	有限合伙人	9,500.00	19.00
4	海宁艾克斯光谷股权投资管理有限公司	普通合伙人	500.00	1.00
合计			<b>50,000.00</b>	<b>100.00</b>

根据股东穿透情况，上述合伙人中浙江钱塘江投资开发有限公司及海宁市泛半导体产业投资有限公司具有国资背景。

### （9）珠海华金丰盈

根据珠海华金丰盈现行有效的《营业执照》，珠海华金丰盈的基本情况如下：

名称	珠海华金丰盈八号股权投资基金合伙企业（有限合伙）
统一社会信用代码	91440400MA54J91UXP
类型	有限合伙企业
注册资本	13,423.00 万元人民币
执行事务合伙人	珠海华金领创基金管理有限公司
成立日期	2020-04-20
注册地址	珠海市横琴新区华金街 58 号横琴国际金融中心大厦 3016
经营范围	协议记载的经营范围：股权投资（私募基金应及时在中国证券投资基金业协会完成备案）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本补充法律意见书之一出具之日，珠海华金丰盈的出资结构如下：

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
1	万杰	有限合伙人	2,500.00	18.62
2	王爱志	有限合伙人	2,500.00	18.62
3	谢祉淇	有限合伙人	500.00	3.72
4	曲志超	有限合伙人	480.00	3.58
5	吴烨桐	有限合伙人	320.00	2.38
6	卿静	有限合伙人	300.00	2.24
7	封光	有限合伙人	300.00	2.24
8	张婷	有限合伙人	300.00	2.24
9	彭婕	有限合伙人	300.00	2.24

序号	合伙人名称	合伙人类型	出资额（万元）	出资比例（%）
10	杨华	有限合伙人	300.00	2.24
11	睢静	有限合伙人	300.00	2.24
12	荣刚	有限合伙人	300.00	2.24
13	蒋少戈	有限合伙人	300.00	2.24
14	郑允杰	有限合伙人	300.00	2.24
15	陈茵	有限合伙人	300.00	2.24
16	高志建	有限合伙人	300.00	2.24
17	鲍晓峰	有限合伙人	300.00	2.24
18	谢浩	有限合伙人	290.00	2.16
19	陈发启	有限合伙人	290.00	2.16
20	陈蕾	有限合伙人	275.00	2.05
21	刘克	有限合伙人	250.00	1.86
22	何志伟	有限合伙人	205.00	1.53
23	宋晓	有限合伙人	200.00	1.49
24	谢耘	有限合伙人	200.00	1.49
25	赵丽峰	有限合伙人	200.00	1.49
26	郭瑾	有限合伙人	200.00	1.49
27	黄卫	有限合伙人	200.00	1.49
28	石小星	有限合伙人	180.00	1.34
29	叶果果	有限合伙人	170.00	1.27
30	卢波	有限合伙人	120.00	0.89
31	吴红梅	有限合伙人	120.00	0.89
32	邓华进	有限合伙人	108.00	0.80
33	何亚岚	有限合伙人	100.00	0.75
34	刘飞虹	有限合伙人	100.00	0.75
35	杨欢	有限合伙人	100.00	0.75
36	王剑雄	有限合伙人	100.00	0.75
37	高小军	有限合伙人	100.00	0.75
38	珠海华金领创基金管理有限公司	普通合伙人	15.00	0.11
合计			<b>13,423.00</b>	<b>100.00</b>

根据股东穿透情况，普通合伙人珠海华金领创基金管理有限公司具有国资背景。

## 2、是否属于国有股东，是否应当办理国有股东标识

根据国务院国有资产监督管理委员会、财政部、中国证监会于 2018 年 5 月 16 日发布，并于 2018 年 7 月 1 日起实施的《上市公司国有股权监督管理办法》（国资委、财政部、证监会令第 36 号）第三条规定：

“本办法所称国有股东是指符合以下情形之一的企业和单位，其证券账户标注‘SS’：

（一）政府部门、机构、事业单位、境内国有独资或全资企业；

（二）第一款中所述单位或企业独家持股比例超过 50%，或合计持股比例超过 50%，且其中之一为第一大股东的境内企业；

（三）第二款中所述企业直接或间接持股的各级境内独资或全资企业。”

第七十八条的规定：“国有出资的有限合伙企业不作国有股东认定，其所持上市公司股份的监督管理另行规定。”

根据上述规定，经对发行人股东进行穿透核查，发行人具有国资背景的股东均不属于国有股东，不需办理国有股东标识，具体情况如下：

（1）芯屏基金、芯动能基金、中青芯鑫、珠海华金领翊、青岛初芯海屏、海宁艾克斯、珠海华金丰盈为国有出资的有限合伙企业，不作为国有股东认定。因此，上述股东均不属于《上市公司国有股权监督管理办法》规定的国有股东，不需办理国有股东标识。

（2）中信投资系中信证券 100%控制的公司，根据中信证券公开披露信息，其第一大股东系中国中信有限公司，中国中信有限公司及其一致行动人在中信证券的股权比例约为 18.45%，不属于《上市公司国有股权监督管理办法》规定的国有股东，不需办理国有股东标识。

（3）合肥颀中控股的控股股东系封测合伙，封测合伙的合伙人系奕斯伟投资及芯屏基金，奕斯伟投资及芯屏基金不属于政府部门、机构、事业单位、境内国有独资或全资企业，故合肥颀中控股不符合《上市公司国有股权监督管理办法》第三条规定的全部情形。因此，合肥颀中控股不属于《上市公司国有股权监督管理办法》规定的国有股东，不需办理国有股东标识。

### **（三）相关股东入股发行人及历次股权变动是否符合国资监管要求**

#### **1、具有国资背景的非国有股东涉及的国资监管情况**

发行人具有国资背景的股东芯动能基金、中青芯鑫、珠海华金领翊、青岛初芯海屏、海宁艾克斯、珠海华金丰盈、中信投资不属于国有股东。根据上述股东出具的确认函，中信投资已履行了必要的决策和审批程序，其他股东中芯动能基金、中青芯鑫、珠海华金领翊、青岛初芯海屏、海宁艾克斯、珠海华金丰盈均为市场化运作基金，其入股发行人及历次股权变动均履行了必要的决策和审批程序，且无需履行任何国有资产评估、备案或审批程序，相关决策行为合法合规，不存在任何争议、纠纷或潜在纠纷。

#### **2、芯屏基金涉及的国资监管情况**

发行人股东芯屏基金作为有限合伙企业，虽不作为国有股东认定，但属于合肥市国资委实际控制的企业，存在受到国资监管的情形。发行人历史沿革中涉及芯屏基金的投资、被动稀释和股改涉及的国资程序如下：

##### **（1）2018年7月股权转让及2018年8月增资**

2017年12月，经合肥市国资委2017年第33次主任办公会、合肥市国资工作领导小组2017年第7次组长会议和市政府常务会议审议通过了芯屏基金对封测有限的投资事项，同意芯屏基金向封测有限直接投资3亿元。

北京中企华资产评估有限责任公司于2018年5月28日出具《合肥奕斯伟封测技术有限公司拟股权转让及增资事宜涉及的合肥奕斯伟封测技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【中企华评报字（2018）第3297号】（已取得合肥国资委《接受非国有资产评估项目备案表》），截至2018年1月31日，封测有限的净资产评估值为17.52亿元，封测有限当时的注册资本为10,787.70万美元。

本次芯屏基金投资事项已履行必要的国资内部审批和评估备案程序。

##### **（2）2021年5月增资**

2018年12月，经芯屏基金投决会审议并经合肥市建设投资控股（集团）有限公司办公会研究同意颀中科技（苏州）有限公司（系颀中科技子公司，以

下称“苏州顾中”)实施股权激励的方案,由受激励对象成立合肥奕斯众志科技合伙企业(有限合伙)、合肥奕斯众诚科技合伙企业(有限合伙)、合肥奕斯众力科技合伙企业(有限合伙)(以下称“3个员工持股平台”),合计持有苏州顾中4%的股权。同时,股权激励方案中明确了在顾中科技后续拟进行股改时,3个员工持股平台所持苏州顾中股权转换为顾中科技股权。

北京中企华资产评估有限责任公司于2021年4月1日出具《合肥顾中封测技术有限公司拟股权重组涉及的合肥顾中封测技术有限公司股东全部权益价值项目资产评估报告》(中企华评报字(2021)第3278-1号),截至评估基准日2020年12月31日,封测有限的总资产评估价值为301,031.00万元,净资产评估价值为300,346.80万元。

参考上述评估结果,封测有限董事会拟审议3个员工持股平台增资进入公司事项,本次增资(3个员工持股平台股权上翻)系是对前期已经审批通过的股权激励方案的落实。合肥建投资本管理有限公司于2021年4月19日出具《出资企业参会议案审批流程表》,建议芯屏基金委派董事在董事会表决投同意票。

本次苏州顾中股权激励事项和3个员工持股平台增资进入公司事项已履行必要的国资内部审批和评估程序,芯屏基金委派董事在参加顾中科技董事会前已履行内部决策流程。

### (3) 2021年7月股权转让

2021年7月,封测有限股东会拟审议芯动能基金转让其所持封测有限部分股权事项,合肥建投资本管理有限公司于2021年7月22日出具《出资企业参会议案审批流程表》,建议芯屏基金在股东会表决投同意票。

就本次芯动能基金股权转让事项,芯屏基金作为公司股东在参加本次股东会前已履行内部决策流程。

### (4) 2021年12月股改

2021年10月,封测有限股东会拟审议公司整体变更为股份有限公司事项,合肥建投资本管理有限公司于2021年10月22日出具《出资企业参会议案审批流程表》,建议芯屏基金在股东会表决投同意票。

就本次公司整体变更为股份有限公司事项，芯屏基金作为公司股东在参加本次股东会前已履行内部决策流程。

封测有限整体变更为股份公司已履行必要的审计、评估、内部审议和验资程序。股份公司设立前后，芯屏基金所持公司股权比例未发生变化。

#### （5）国资委确认意见

根据合肥市国资委于 2022 年 7 月 12 日出具的《关于确认合肥硕中科技股份有限公司历史沿革中涉及国有股权变动事项合规性的函》，芯屏基金在硕中科技历次相关股权变动中均履行了必要程序，符合国资监管的有关规定，不存在损害国有股东权益及造成国有资产流失的情形。

综上，发行人具有国资背景的股东入股发行人及历次股权变动符合国资监管要求。

### 【核查情况】

#### 一、核查程序

针对上述事项，本所律师履行了以下核查程序：

1、取得发行人出具的说明及书面确认；

2、查阅发行人非自然人股东的工商资料、自然人股东身份信息、简历等、直接股东访谈问卷、间接股东调查表及股东出资凭证，核查相关股东入股原因、入股价格、定价依据、入股真实性与合理性、股东关联关系及有无其他利益安排；

3、查阅发行人股东名册，核查现有股东中的国有股东情况；

4、通过企业信用信息公示系统查询合肥硕中控股、芯屏基金、芯动能基金、中青芯鑫、中信投资、珠海华金领翊、青岛初芯海屏、海宁艾克斯、珠海华金丰盈及其上层股东的股权结构，并查询中信证券公开披露信息，核查上述股东是否属于国有股东范畴；

5、查阅发行人的工商档案材料，历次增资和股权转让所签署的相关协议、股权转让和增资的价款支付凭证、北京中企华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》及相关国有资产评估备案文件；

6、查阅《上市公司国有股权监督管理办法》《中华人民共和国企业国有资产法》《企业国有资产监督管理暂行条例》《企业国有资产交易监督管理办法》《企业国有资产评估管理暂行办法》《上市公司国有股东标识管理暂行办法》等国有股权管理法律法规及相关文件；

7、取得具有国资背景的非国有股东出具的《关于投资合肥顾中科技股份有限公司相关事项の確認函》；

8、查阅合肥市国资委出具的《关于确认合肥顾中科技股份有限公司历史沿革中涉及国有股权变动事项合规性的函》等书面确认文件。

## 二、核查意见

经核查，本所认为：

1、发行人部分董事、高管通过苏州融可源持股的原因系持续看好发行人经营业绩和半导体产业发展，以同期外部投资者入股价格通过苏州融可源间接持有发行人股份，具有合理性；

2、苏州融可源合伙人中的发行人董事、高管与其他 2 名自然人股东与芯动能基金及发行人前三大股东之间不存在关联关系及其他利益安排，该董事、高管与苏州融可源其他合伙人不存在关联关系；

3、苏州融可源及两名自然人股东不存在股份代持或其他利益安排；

4、CTC 的主营业务系投资平台，不直接开展实体业务。CTC 的第一大股东汪钧培先生看好并积极推动发行人 2018 年引进战略投资人，认同顾中科技未来的发展战略和前景。基于上述原因，汪钧培先生作为本次交易的重要参与者之一，其控制的 CTC 受让了顾中控股（香港）持有的发行人部分股权，与合肥顾中控股等主要股东同时入股发行人；

5、截至本补充法律意见书之一出具之日，CTC 与公司主要股东不存在关联关系、业务往来、代持或其他利益关系；

6、发行人不存在国有股东，无需办理国有股东标识；

7、发行人具有国资背景的相关股东入股发行人及历次股权变动已相应履行必要的内部决策和审批程序，符合国资监管要求；

8、发行人股东芯屏基金在硕中科技历次相关股权变动中均履行了必要程序，符合国资监管的有关规定，不存在损害国有股东权益及造成国有资产流失的情形。

### 问题 13. 关于募投项目

根据申报材料：（1）本次发行拟募集资金 20 亿元，主要用于封测产线建设及有关技术改造项目，项目达产后将大幅提升 12 吋晶圆产品的封测产能；（2）公司尚未取得“硕中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目”的环评批复。

请发行人说明：（1）结合 12 吋显示驱动芯片封测业务市场规模、同行业公司有关产品的产能（含在建、新建计划）及销售情况、公司目前的产能利用率、项目达产后的预计产能情况，量化分析公司是否具有募投项目产能消化能力，测算募投项目建成后对公司产能利用率、固定资产折旧和业绩的影响；（2）研发中心项目环评批复的取得进展，是否存在无法取得的实质障碍；（3）公司募投项目涉及的固定资产投资是否超过 10 亿元，是否按有关规定履行了完整的审批报备程序。

请保荐机构、发行人律师对上述事项核查并发表明确意见。

回复：

#### 【发行人说明】

#### 一、研发中心项目环评批复的取得进展，是否存在无法取得的实质障碍

发行人已于 2022 年 7 月 11 日取得合肥市生态环境局颁发的《关于合肥硕中科技股份有限公司硕中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目环境影响报告表的批复》（环建审[2022]12041 号）。

#### 二、公司募投项目涉及的固定资产投资是否超过 10 亿元，是否按有关规定履行了完整的审批报备程序

##### 1、公司单个募投项目涉及的固定资产投资未超过 10 亿元

发行人本次募投项目中共有三个项目涉及固定资产投资，均未超过 10 亿元，具体如下：

序号	项目名称	固定资产投资金额（亿元）
1	颀中先进封装测试生产基地项目	9.70
2	颀中科技（苏州）有限公司高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目	5.00
3	颀中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目（以下简称“研发中心项目”）	0.95

“颀中科技生产基地项目”计划在合肥市新站区新建厂房以及 12 吋显示驱动芯片封测产线，旨在充分利用当地成熟的显示产业链资源与集成电路群聚效应，是公司未来产能增长的主要来源；“苏州颀中技改项目”将对苏州颀中现有产线中的高密度微尺寸凸块制造、晶圆测试等核心工序进行技术改造，以提升生产效率；“研发中心项目”则聚焦于显示驱动芯片相关的先进封装、测试及智能制造技术的研究，充分发挥合肥当地科研院校、集成电路产业的人才优势，为公司未来技术研发提供重要支持。

因此，上述募投项目均具有各自独立的建设背景和战略意义，彼此相互独立，发行人不存在将单个项目拆解为多个不同项目实施的情况，且单个项目涉及的固定资产投资均不超过 10 亿元。

## 2、公司募投项目均已履行了完整的项目投资备案程序

根据《企业投资项目核准和备案管理办法》《政府核准的投资项目目录（2016 年本）》（以下简称“《国务院核准目录》”）的相关规定，企业在中国境内投资建设的固定资产投资项，根据项目不同情况分别实行核准管理或备案管理。实行核准管理的具体项目范围以及核准机关、核准权限，由《国务院核准目录》确定。除国务院另有规定外，实行备案管理的项目按照属地原则备案。各省级政府负责制定本行政区域内的项目备案管理办法，明确备案机关及其权限。

根据《安徽省企业投资项目核准和备案管理实施办法》《江苏省企业投资项目核准和备案管理实施办法》相关规定，实行核准管理的具体项目范围以及核准机关、核准权限，由《国务院核准目录》及各省级政府发布的《核准目录》确定，实行备案管理的项目按照属地原则备案。

发行人本次募投项目聚焦于集成电路先进封测领域的生产和研发，不属于《国务院核准目录》《安徽省地方政府核准的投资项目目录（2016 年本）》《江

苏省政府关于发布江苏省政府核准的投资项目目录（2017 年本）》中规定需要的核准的投资项目，应按属地原则备案。

截至本补充法律意见书之一出具之日，发行人已完成本次募投项目备案，具体情况如下：

序号	项目名称	备案单位	项目备案号
1	顾中先进封装测试生产基地项目	合肥新站高新技术产业开发区经贸局	2112-340163-04-01-117327
2	顾中科技（苏州）有限公司高密度微尺寸凸块封装及测试技术改造项目	合肥新站高新技术产业开发区经贸局	苏园行审技备（2022）72号
3	顾中先进封装测试生产基地二期封测研发中心项目	苏州工业园区行政审批局	2202-340163-04-01-441113
4	补充流动资金及偿还银行贷款项目	不涉及	不涉及

经咨询备案单位合肥新站高新技术产业开发区经贸局和苏州工业园区行政审批局，如集成电路项目涉及的固定资产投资超过 10 亿元，则需由其层层上报至国家发改委并取得窗口指导意见。根据备案单位出具的项目备案表/备案证并向其咨询确认，发行人相关项目的固定资产投资均未超过 10 亿元，符合发改部门关于集成电路投资项目窗口指导的规定，相关程序合法合规。

综上所述，公司募投项目均已履行了完整的项目投资备案程序。

## 【核查情况】

### 一、核查程序

针对上述事项，本所律师履行了以下核查程序：

1、取得了发行人募投项目的环评批复文件；

2、获取了募投项目投资明细，核查固定资产投资金额；查阅投资项目管理的相关法律法规，取得发行人募投项目备案文件，并咨询备案单位经办人员，核查其项目备案程序的合法合规性。

### 二、核查意见

经核查，本所认为：

1、发行人已取得研发中心项目的环评批复文件；

2、发行人单个募投建设项目的固定资产投资金额均未超过 10 亿元，且均履行了完整的投资项目备案程序，相关程序合法合规。

## 问题 15. 关于其他

### 15.3

根据申报材料：最近两年，除罗世蔚和余成强外，公司董事、高管人员全部发生变化，新增人员来自原股东委派或公司内部培养产生。

请保荐机构、发行人律师结合《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第十二条、《科创板股票发行上市审核问答》第 6 项要求，分析董事、高管人员变动是否实际对发行人生产经营产生重大不利影响，是否符合“董事、高级管理人员没有发生重大不利变化”及管理团队稳定的要求。

回复：

#### 【发行人说明】

根据《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》第十二条第二款的要求：发行人管理团队和核心技术人员稳定，最近 2 年内董事、高级管理人员及核心技术人员均没有发生重大不利变化。

根据《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》第 6 项的要求：变动后新增的发行人的董事、高级管理人员及核心技术人员来自原股东委派或发行人内部培养产生的，原则上不构成重大不利变化。发行人管理层因退休、调任等原因发生岗位变化的，原则上不构成重大不利变化，但发行人应当披露相关人员变动对公司生产经营的影响。

2020 年 1 月至今，发行人董事的具体变动情况如下：

时间	人员	变动原因
2020 年 1 月至 2020 年 8 月	王家恒、米鹏、游敦成、 吴非艰、罗世蔚、黄颢、 王友军	-
2020 年 9 月至 2021 年 7 月	张莹、王友军、罗世蔚、 黄颢、游敦成、米鹏	董事会构成调整。新任董事张莹为股东合肥颀中控股委派；离任董事王家恒、吴非艰分别为股东芯动能基金、颀中控股（香港）委派。上述董事均未在公司担任除董事外的其他职务
2021 年 7 月至	张莹、王友军、罗世蔚、	股东委派人员变化。新任董事王辉和离任

2021年10月	黄颢、游敦成、王辉	董事米鹏均为股东合肥颀中控股委派，均未在公司担任除董事外的其他职务
2021年10月至 2021年11月	张莹、王友军、罗世蔚、 许靖、游敦成、王辉	股东提名人员变化。新任董事许靖和离任董事黄颢均为股东合肥颀中控股提名，均未在公司担任除董事外的其他职务
2021年12月至 今	张莹、余卫珍、罗世蔚、 许靖、杨宗铭、余成强、 胡晓林、王新、崔也光	股份公司成立，选聘股份公司第一届董事会董事。董事会成员均系发起人股东提名并选举产生。新任董事余卫珍和离任董事王友军均为芯屏基金提名，杨宗铭、余成强为公司管理团队，胡晓林、王新、崔也光为独立董事

2020年1月至今，发行人高管的具体变动情况如下：

时间	人员	变动原因
2020年1月至 2020年4月	游敦成（总经理）、李晓军（副总经理）、余成强（财务总监）	-
2020年4月至 2020年9月	杨宗铭（总经理）、李晓军（副总经理）、余成强（财务总监）、刘为（董事会秘书）	公司原总经理游敦成退休，其退休未对公司经营造成不利影响；新任总经理杨宗铭系发行人内部培养，且已在发行人任职超过10年
2020年9月至 2021年12月	杨宗铭（总经理）、余成强（副总经理、财务总监、董事会秘书）	董事会同意更换副总经理及董事会秘书，由公司财务总监担任；李晓军和刘为因个人原因离职，未对公司经营造成不利影响
2021年12月 至今	杨宗铭（总经理）、余成强（副总经理、财务总监、董事会秘书）、李良松（副总经理）、周小青（副总经理）、张玲玲（副总经理）	股份公司成立，董事会选聘高级管理人员，新任高级管理人员均系发行人内部培养，且均已在发行人任职超过10年

如上所示，发行人最近2年内董事及高管变动新增人员均系由原股东根据相应人员的专业知识及从业背景委派或由发行人内部培养的核心骨干人员，以其各自所具备的专业能力和勤勉尽责的职业道德保障了发行人公司治理和经营决策的准确性及有效性。最近2年董事、高管变动没有对发行人的生产经营造成重大不利影响。此外，最近2年发行人核心技术人员未发生变化。

综上，发行人最近2年的董事、高管变动符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》的相关发行条件，符合“董事、高级管理人员没有发生重大不利变化”及管理团队稳定的要求。

## 【核查情况】

### 一、核查程序

针对上述事项，本所律师履行了以下核查程序：

1、查阅发行人历史沿革相应的工商资料，结合前述资料了解发行人历史沿革中董事、高级管理人员更换背景；

2、查阅报告期内发行人的股东（大）会、董事会资料，了解发行人历次董事、高级管理人员任免的内部决策情况；

3、查阅发行人现任董事、高级管理人员及核心技术人员简历；

4、查阅发行人董事、高管任命文件；

5、取得并查阅发行人董事、高管填写的调查问卷；

6、查阅《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》的相关规定。

## 二、核查意见

经核查，本所认为：发行人最近 2 年的董事、高管变动符合《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》和《上海证券交易所科创板股票发行上市审核问答》的相关规定，符合“董事、高级管理人员没有发生重大不利变化”及管理团队稳定的要求。

本补充法律意见书之一正本三份，无副本。

（以下无正文）

（此页无正文，为《北京市竞天公诚律师事务所关于合肥顾中科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在科创板上市的补充法律意见书（一）》  
签字盖章页）



北京市竞天公诚律师事务所（盖章）

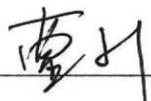
律师事务所负责人（签字）：

  
赵洋

经办律师（签字）：

  
范瑞林

经办律师（签字）：

  
曹子腾

2022年8月12日